

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2003 年 9 月 12 日 (12.09.2003)

PCT

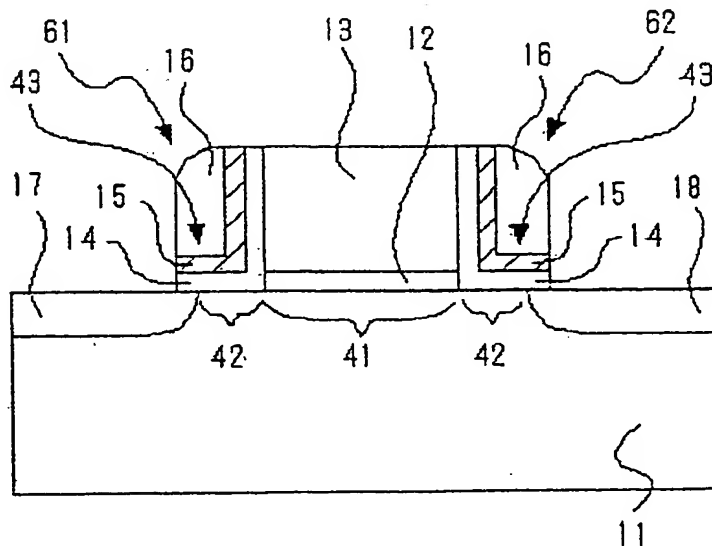
(10) 国際公開番号  
WO 03/075359 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 29/792 (72) 発明者; および  
(21) 国際出願番号: PCT/JP03/02421 (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 岩田 浩 (IWATA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒636-0813 奈良県 生駒郡 三郷町信貴ヶ丘 2-4-1 3 Nara (JP). 柴田 晃秀 (SHIBATA, Akihide) [JP/JP]; 〒631-0803 奈良県 奈良市 山陵町 1 0 4-B 2 0 3 Nara (JP).  
(22) 国際出願日: 2003 年 3 月 3 日 (03.03.2003)  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ: (74) 代理人: 青山 葆, 外 (AOYAMA, Tamotsu et al.); 〒540-0001 大阪府 大阪市 中央区城見 1 丁目 3 番 7 号 I M P ビル 青山特許事務所 Osaka (JP).  
特願2002-56694 2002 年 3 月 4 日 (04.03.2002) JP (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.  
特願2003-33678 2003 年 2 月 12 日 (12.02.2003) JP  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): シャープ株式会社 (SHARP KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒545-8522 大阪府 大阪市 阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 Osaka (JP).

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR STORAGE DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体記憶装置



(57) Abstract: A microminaturized semiconductor while realizing holding of a 2-bit memory in one transistor. Two charge holding sections (61, 62) independent of a gate insulating film (12) are formed on both sides of the side wall of a gate electrode (13). Thus, a memory function carried by the charge keeping sections (61, 62) is separated from a transistor operation function carried by the gate insulating film (12). Since the two charge holding sections (61, 62) formed on both sides of the gate electrode (13) are isolated by the gate electrode (13), the interference during rewrite is effectively suppressed. Therefore, a microminaturized semiconductor storage device while realizing holding of a two-bit memory in one transistor.

[続葉有]

WO 03/075359 A1



(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 1つのトランジスタで2ビットの記憶保持を実現しながら、微細化することができる半導体記憶装置を提供する。ゲート電極13の側壁の両側にゲート絶縁膜12と独立した2つの電荷保持部61、62を形成する。これにより、電荷保持部61、62が担うメモリ機能と、ゲート絶縁膜12が担うトランジスタ動作機能とを分離する。ゲート電極13の両側に形成された2つの電荷保持部61、62はゲート電極13により分離されているので書換え時の干渉が効果的に抑制される。したがって、1つのトランジスタで2ビットの記憶保持を実現しながら、微細化された半導体記憶装置が提供される。

## 明 細 書

## 半導体記憶装置

## 5 技術分野

本発明は、半導体記憶装置に関する。より詳細には、電荷量の変化を電流量に変換する機能を有する電界効果トランジスタからなる半導体記憶装置に関する。

## 背景技術

10 従来から、1つの電界効果トランジスタで2ビットの記憶が可能な不揮発性メモリとして、サイファン・セミコンダクターズ・リミテッド社が開発したメモリがある（特表2001-512290号公報）。

このメモリは、図21に示したように、P型ウェル領域901上にゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極909、P型ウェル領域901表面に形成され  
15 た第1のN型拡散層領域902及び第2のN型拡散層領域903から構成される。ゲート絶縁膜は、シリコン酸化膜904、905の間にシリコン窒化膜906が挟まれた、いわゆるONO(Oxide Nitride Oxide)膜からなる。シリコン窒化膜906中には、第1及び第2のN型拡散層領域902、903の端部付近に、それぞれ記憶保持部907、908が形成されている。

20 これらの記憶保持部907、908のそれぞれの個所での電荷の多寡をトランジスタのドレイン電流として読み出すことにより、1トランジスタで2ビットの情報を記憶させることができる。

しかし、前記のメモリでは、ゲート絶縁膜はONO膜の3層構造であり、薄膜化が困難であるため、素子の微細化が困難であるという問題があった。すなわち、  
25 ゲート絶縁膜の膜厚に関するスケーリングが困難であり、短チャネル効果の増大を招くことにより、素子の微細化が果たせなかった。また、チャネル長が短くなるにつれ、1つのトランジスタの記憶保持部907、908の2箇所を分離することが困難となるため、さらなる素子の微細化が果たせなかった。

## 発明の開示

本発明は前記課題に鑑みなされたものであり、1つのトランジスタで2ビットの記憶保持を実現しながら、更に微細化することができる半導体記憶装置を提供することを目的とする。

5       上記課題を解決するため、本発明の半導体記憶装置は、半導体基板と、上記半導体基板上に形成されたゲート絶縁膜と、上記ゲート絶縁膜上に形成された単一のゲート電極と、上記単一のゲート電極側壁の両側に形成された2つの電荷保持部と、上記2つの電荷保持部のそれぞれに対応する2つの拡散層領域と、上記単一のゲート電極下に配置されたチャネル領域とを備え、上記電荷保持部は、電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁体からなる膜が、第2の絶縁体と第3の絶縁体とに挟まれた構造を有し、上記電荷保持部は、上記第1の絶縁体に保持された電荷の多寡により、上記ゲート電極に電圧を印加した際の上記一方の拡散層領域から他方の拡散層領域に流れる電流量を変化させるように構成されてなることを特徴としている。

15       上記構成の半導体記憶装置によれば、上記ゲート電極側壁の両側に形成された2つの電荷保持部は、上記ゲート絶縁膜とは独立しているので、電荷保持部が担うメモリ機能と、ゲート絶縁膜が担うトランジスタ動作機能とは分離されている。そのため、十分なメモリ機能を有したままゲート絶縁膜を薄膜化して短チャネル効果を抑制するのが容易である。また、ゲート電極の両側に形成された2つの電荷保持部はゲート電極により分離されているので書換え時の干渉が効果的に抑制される。言い換えれば、2つの電荷保持部間の距離を小さくすることができる。したがって、2ビット動作が可能で、かつ微細化が容易な半導体記憶装置が提供される。

25       更には、電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁体からなる膜が、第2の絶縁体と第3の絶縁体とに挟まれた構造を有している。そのため、電荷の注入に際して、短い時間で第1の絶縁体内の電荷密度を上げ、また、電荷密度を均一にすることができる。また、電荷を蓄積する第1の絶縁体は、導電体部（ゲート電極、拡散層領域、半導体基板）とは他の絶縁膜で隔てられているので、電荷の漏れが抑制されて十分な保持時間を得ることができる。したがって、半導体記憶装置の



高速書換え、信頼性の向上、十分な保持時間の確保が可能となる。

一実施形態の半導体記憶装置は、上記第1の絶縁体における真空準位と伝導電子帯の最低準位とのエネルギー差を $\chi_1$ とし、上記第2の絶縁体における真空準位と伝導電子帯の最低準位とのエネルギー差を $\chi_2$ とし、上記第3の絶縁体における真空準位と伝導電子帯の最低準位とのエネルギー差を $\chi_3$ とすると、 $\chi_1 > \chi_2$ かつ $\chi_1 > \chi_3$ である。

上記実施形態の半導体記憶装置によってもまた、上記本発明の半導体記憶装置と同様な作用効果を奏する。

更には、上記第1の絶縁体の電子親和力が、上記第2及び第3の絶縁体の電子親和力よりも大きい。そのため、蓄積する電荷が電子の場合、電荷を蓄積する第1の絶縁体からなる膜からの電荷の散逸が効果的に抑制され、記憶保持時間が長くなる。更には、電荷を蓄積する第1の絶縁体への電荷注入効率が高くなって書換え時間が短縮する。したがって、半導体記憶装置の書換え時間を短縮して、高速動作を実現することができる。

一実施形態の半導体記憶装置は、上記第1の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差を $\phi_1$ とし、上記第2の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差を $\phi_2$ とし、上記第3の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差を $\phi_3$ とすると、 $\phi_1 < \phi_2$ かつ $\phi_1 < \phi_3$ である。

上記実施形態の半導体記憶装置によってもまた、上記本発明の半導体記憶装置と同様な作用効果を奏する。

更には、上記第1の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差が、上記第2及び第3の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差よりも小さい。そのため、蓄積する電荷が正孔の場合、電荷を蓄積する第1の絶縁体からなる膜からの電荷の散逸が効果的に抑制され、記憶保持時間が長くなる。更には、電荷を蓄積する第1の絶縁体への電荷注入効率が高くなって書換え時間が短縮する。したがって、半導体記憶装置の書換え時間を短縮して、高速動作を実現することができる。

一実施形態の半導体記憶装置は、上記第1の絶縁体における真空準位と伝導電

子帯の最低準位とのエネルギー差を  $\chi_1$  とし、上記第 2 の絶縁体における真空準位と伝導電子帯の最低準位とのエネルギー差を  $\chi_2$  とし、上記第 3 の絶縁体における真空準位と伝導電子帯の最低準位とのエネルギー差を  $\chi_3$  とし、上記第 1 の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差を  $\phi_1$  とし、上記第 2 の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差を  $\phi_2$  とし、上記第 3 の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差を  $\phi_3$  とするとき、 $\chi_1 > \chi_2$ 、 $\chi_1 > \chi_3$ 、 $\phi_1 < \phi_2$ 、 $\phi_1 < \phi_3$  のいずれをも満たす。

上記実施形態の半導体記憶装置によってもまた、上記本発明の半導体記憶装置と同様な作用効果を奏する。

更には、上記第 1 の絶縁体の電子親和力が、上記第 2 及び第 3 の絶縁体の電子親和力よりも大きく、かつ、上記第 1 の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差が、上記第 2 及び第 3 の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差よりも小さい。そのため、電子の注入効率と正孔の注入効率の両方が高くなり、例えば書込み時には第 1 の絶縁体に電子を注入し、消去時には正孔を注入して蓄積された電子と再結合させる場合（電子と正孔を入れ替えても同様）、書込み動作と消去動作を共に高速化することができる。

一実施形態の半導体記憶装置は、上記第 1 の絶縁体とはシリコン窒化物であり、上記第 2 及び第 3 の絶縁膜とはシリコン酸化物である。

上記実施形態の半導体記憶装置は、上記本発明の半導体記憶装置において、第 1 ～第 3 の絶縁体を具体的に特定している。電荷を蓄積する機能を有する第 1 の絶縁体はシリコン窒化膜であり、電荷（電子及び正孔）をトラップする準位が多数存在するため大きなヒステリシス特性を得ることができる。また、第 2 及び第 3 の絶縁体はシリコン酸化物であるから、上記第 1 の絶縁体の電子親和力が、上記第 2 及び第 3 の絶縁体の電子親和力よりも大きく、かつ、上記第 1 の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差が、上記第 2 及び第 3 の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差よりも小さい。

したがって、書込み動作と消去動作を共に高速化することができる。更には、シリコン酸化物膜およびシリコン窒化膜は共に L S I プロセスでごく標準的に用いら

れる材料であるから、製造プロセスが簡単になる。

一実施形態の半導体記憶装置では、シリコン酸化物である上記第2の絶縁体は膜状であって、上記半導体基板と上記第1の絶縁体とを隔てており、上記半導体基板上における上記第2の絶縁体からなる膜の厚さは、1.5 nm以上であって  
5 1.5 nm以下である。

上記実施の形態の半導体記憶装置によれば、上記第1の絶縁体に蓄積された電荷の漏れを抑制しつつ、上記第1の絶縁体への電荷の注入を十分に高速に行なうことができる。したがって、高速の書換え動作と十分な保持時間とを両立した半導体記憶装置が提供される。

10 一実施形態の半導体記憶装置では、シリコン窒化物である上記第1の絶縁体からなる膜の厚さは、上記半導体基板上において、2 nm以上であって1.5 nm以下である。

上記実施の形態の半導体記憶装置における閾値変化（あるいは読出し電流変化）を十分として素子間ばらつきを抑え、かつ、記憶保持中のシリコン窒化膜中  
15 での電荷移動による閾値（あるいは読出し電流）の変化を抑制することができる。

一実施形態の半導体記憶装置は、上記第2の絶縁体は膜状であって、上記半導体基板及び上記ゲート電極の側壁と、上記第1の絶縁体とを隔てており、上記ゲート電極の側壁近傍における上記第2の絶縁体からなる膜の厚さは、上記半導体基板上における上記第2の絶縁体からなる膜の厚さよりも厚い。

20 上記実施形態の半導体記憶装置によってもまた、上記本発明の半導体記憶装置と同様な作用効果を奏する。

更には、上記ゲート電極の側壁近傍における上記第2の絶縁体からなる膜の厚さは、上記半導体基板上における上記第2の絶縁体からなる膜の厚さよりも厚いから、ゲート電極から電荷を蓄積する第1の絶縁体への電荷の注入（あるいは第  
25 1の絶縁体からゲート電極への電荷の放出）を効果的に抑制することができる。  
したがって、半導体記憶装置の書換え特性が安定し、信頼性が向上する。

一実施形態の半導体記憶装置は、上記半導体基板上における上記第2の絶縁体からなる膜の厚さが、上記ゲート絶縁膜の厚さよりも薄く、かつ0.8 nm以上である。

上記実施形態の半導体記憶装置によれば、上記半導体基板上における上記第2の絶縁体からなる膜の厚さを、上記ゲート絶縁膜の厚さよりも薄く、かつ0.8 nm以上により、製造プロセスによる均一性や膜質を一定の水準を維持することが可能であり、かつ保持特性が極端に劣化せず、メモリの耐圧性能を低下させることなく、書込み動作及び消去動作の電圧を低下させ、又は書込み動作及び消去動作を高速にし、さらにメモリ効果を増大することが可能となる。

一実施形態の半導体記憶装置は、上記半導体基板上における上記第2の絶縁体からなる膜の厚さが、上記ゲート絶縁膜の厚さよりも厚く、かつ20 nm以下である。

上記実施形態の半導体装置によれば、上記半導体基板上における上記第2の絶縁体からなる膜の厚さを、上記ゲート絶縁膜の厚さよりも厚く、かつ20 nm以下により、書換え速度を大幅に遅くすることなく、かつ、メモリの短チャネル効果を悪化させることなく保持特性を改善することが可能となる。

一実施形態の半導体記憶装置は、上記電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁体からなる膜の少なくとも一部が上記拡散層領域の一部にオーバーラップするように形成されてなる。

上記実施形態の半導体装置によれば、上記電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁体からなる膜の少なくとも一部を上記拡散層領域の一部にオーバーラップするように形成することにより、読出し動作速度を高速にすることができる。

一実施形態の半導体記憶装置は、上記電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁体からなる膜が、ゲート絶縁膜の表面と略平行な表面を有する部分を含む。

上記実施形態の半導体装置によれば、上記電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁体からなる膜が、ゲート絶縁膜の表面と略平行な表面を有する部分を含むので、上記電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁体からなる膜に蓄積された電荷の多寡によるメモリ効果を効果的に制御することができ、ひいてはメモリ効果を大きくすることができる。更に、上記電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁体からなる膜の上部方向への電荷の移動が抑制され、記憶保持中に電荷移動による特性変化が起こるのを抑制することができる。

一実施形態の半導体記憶装置は、上記電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁

体からなる膜が、ゲート電極側面と略並行に延びた部分を含む。

上記実施の形態の半導体装置によれば、上記電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁体からなる膜が、ゲート電極側面と略並行に延びた部分を含むので、書換え動作時に上記電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁体からなる膜に注入される電荷が増加し、書換え速度が増大する。

#### 図面の簡単な説明

図1は本発明の半導体記憶装置の実施の形態を示す要部の概略断面図である。

図2は本発明の半導体記憶装置の実施の形態を一部拡大した概略断面図である。

図3は図2の切断面線A-A'に沿って、エネルギーバンドを示した図である。

図4A、図4Bは本発明の半導体記憶装置の実施の形態の書込み動作を説明するための要部の概略断面図である。

図5は本発明の半導体記憶装置の実施の形態の第1の消去動作を説明するための要部の概略断面図である。

図6は本発明の半導体記憶装置の実施の形態の第2の消去動作を説明するための要部の概略断面図である。

図7A、図7B、図7Cは本発明の半導体記憶装置の実施の形態の製造方法を説明するための要部の概略断面工程図である。

図8は本発明の半導体記憶装置の実施の形態を示す要部の概略断面図である。

図9A、図9B、図9Cは本発明の半導体記憶装置の実施の形態の製造方法を説明するための要部の概略断面工程図である。

図10は本発明の半導体記憶装置の実施の形態を示す要部の概略断面図である。

図11は本発明の半導体記憶装置の実施の形態を一部拡大した概略断面図である。

図12は本発明の半導体記憶装置の実施の形態の一変形例を一部拡大した概略断面図である。

図13は本発明の半導体記憶装置におけるゲート電極と拡散層領域のオフセット量 $W_1$ とドレイン電流 $I_d$ との関係を示すグラフである。

図14は本発明の半導体記憶装置の実施の形態の他の変形例を一部拡大した概略断面図である。

略断面図である。

図 1 5 は本発明の半導体記憶装置の実施の形態の効果を説明する概略断面図である。

図 1 6 は本発明の半導体記憶装置の実施の形態を示す要部の概略断面図である。

5 図 1 7 は本発明の半導体記憶装置の実施の形態を示す要部の概略断面図である。

図 1 8 は本発明の半導体記憶装置の実施の形態を示す要部の概略断面図である。

図 1 9 は本発明の半導体記憶装置の実施の形態を示す要部の概略断面図である。

図 2 0 は本発明の半導体記憶装置の実施の形態を示す要部の概略断面図である。

図 2 1 は従来の半導体記憶装置を示す要部の概略断面図である。

10

#### 発明を実施するための最良の形態

本発明の半導体記憶装置は、主として、ゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜上に形成されたゲート電極と、ゲート電極の両側に形成された電荷保持部と、電荷保持部のゲート電極と反対側のそれぞれに配置されたソース／ドレイン領域（拡散層領域）と、ゲート電極下に配置されたチャネル領域とから構成される。

15

この半導体記憶装置は、1つの電荷保持部に2値又はそれ以上の情報を記憶することにより、4値又はそれ以上の情報を記憶するメモリ素子として機能する。

本発明の半導体記憶装置は、半導体基板上、好ましくは半導体基板内に形成された第1導電型のウェル領域上に形成されることが好ましい。

20

半導体基板としては、半導体装置に使用されるものであれば特に限定されるものではなく、例えば、シリコン、ゲルマニウム等の元素半導体、GaAs、InGaAs、ZnSe等の化合物半導体による基板、SOI基板又は多層SOI基板等の種々の基板を用いることができる。なかでもシリコン基板又は表面半導体層としてシリコン層が形成されたSOI基板が好ましい。この半導体基板上には、素子分離領域が形成されていることが好ましく、更にトランジスタ、キャパシタ、抵抗等の素子、これらによる回路、半導体装置や層間絶縁膜が組み合わせられて、シングル又はマルチレイヤー構造で形成されていてもよい。なお、素子分離領域は、LOCOS膜、トレンチ酸化膜、STI膜等種々の素子分離膜により形成することができる。半導体基板は、P型又はN型の導電型を有していてもよく、半

25

導体基板には、少なくとも1つの第1導電型（P型又はN型）のウェル領域が形成されていることが好ましい。半導体基板及びウェル領域の不純物濃度は、当該分野で公知の範囲のものが使用できる。なお、半導体基板としてSOI基板を用いる場合には、表面半導体層には、ウェル領域が形成されていてもよいが、チャネル領域下にボディ領域を有していてもよい。

ゲート絶縁膜は、通常、半導体装置に使用されるものであれば特に限定されるものではなく、例えば、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜等の絶縁膜；酸化アルミニウム膜、酸化チタニウム膜、酸化タンタル膜、酸化ハフニウム膜などの高誘電体膜の単層膜又は積層膜を使用することができる。なかでも、シリコン酸化膜が好ましい。

ゲート電極は、ゲート絶縁膜上に、通常半導体装置に使用されるような形状で形成されている。ゲート電極は、実施の形態のなかで特に指定がない限り、特に限定されるものではなく、導電膜、例えば、ポリシリコン；銅、アルミニウム等の金属；タングステン、チタン、タンタル等の高融点金属；高融点金属とのシリサイド等の単層膜又は積層膜等が挙げられる。ゲート電極の膜厚は、例えば50～400nm程度の膜厚で形成することが適当である。なお、ゲート電極の下には、チャネル領域が形成されるが、チャネル領域は、ゲート電極下のみならず、ゲート電極とゲート長方向におけるゲート端の外側を含む領域下に形成されていることが好ましい。このように、ゲート電極で覆われていないチャネル領域が存在する場合には、そのチャネル領域は、ゲート絶縁膜又は後述する電荷保持部で覆われていることが好ましい。

電荷保持部は、電荷を蓄積する第1の絶縁体からなる膜が、第2の絶縁体からなる膜と第3の絶縁体からなる膜とで挟まれたサンドウィッチ構造を有するのが好ましい。電荷を蓄積する第1の絶縁体が膜状であるから、電荷の注入により短い時間で第1の絶縁体内の電荷密度を上げ、また、電荷密度を均一にすることができる。電荷を蓄積する第1の絶縁体内の電荷分布が不均一であった場合、保持中に第1の絶縁体内を電荷が移動してメモリ素子の信頼性が低下する恐れがある。また、電荷を蓄積する第1の絶縁体は、導電体部（ゲート電極、拡散層領域、半導体基板）とは他の絶縁膜で隔てられているので、電荷の漏れが抑制されて十分

な保持時間を得ることができる。したがって、上記サンドウィッチ構造を有する場合、半導体記憶装置の高速書換え、信頼性の向上、十分な保持時間の確保が可能となる。

5 更には、蓄積される電荷が電子の場合、上記第1の絶縁体の電子親和力が、上記第2及び第3の絶縁体の電子親和力よりも大きいことが好ましい。ここで、電子親和力とは、真空準位と伝導電子体の最低準位とのエネルギー差である。もしくは、蓄積される電荷がホール（正孔）の場合、上記第1の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差が、上記第2及び第3の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差よりも小さいことが好ましい。  
10 上記条件を満たす場合、電荷を蓄積する第1の絶縁体からなる膜からの電荷の散逸が効果的に抑制され、記憶保持時間が長くなる。更には、電荷を蓄積する第1の絶縁体への電荷注入効率が高くなって書換え時間が短縮する。上記条件を満たす電荷保持部としては、上記第1の絶縁体をシリコン窒化膜とし、第2及び第3の絶縁体をシリコン酸化膜とするのが特に好ましい。シリコン窒化膜は、電荷をトラップする準位が多数存在するため大きなヒステリシス特性を得ることができる。  
15 また、シリコン酸化膜およびシリコン窒化膜は共にLSIプロセスでごく標準的に用いられる材料であるため、好ましい。また、第1の絶縁体として、窒化シリコンのほかに、酸化ハフニウム、タンタルオキシド、イットリウムオキシドなどを用いることができる。更には、第2及び第3の絶縁体として、酸化シリコンのほかに、酸化アルミニウムなどを用いることができる。なお、上記第2及び第3の絶縁体は、異なる物質であってもよいし同一の物質であってもよい。

電荷保持部は、ゲート電極の両側に形成されており、また、半導体基板（ウェル領域、ボディ領域又はソース／ドレイン領域もしくは拡散層領域）上に配置している。

25 ソース／ドレイン領域は、半導体基板又はウェル領域と逆導電型の拡散層領域として、電荷保持部のゲート電極と反対側のそれぞれに配置されている。ソース／ドレイン領域と半導体基板又はウェル領域との接合は、不純物濃度が急峻であることが好ましい。ホットエレクトロンやホットホールが低電圧で効率良く発生し、より低電圧で高速な動作が可能となるからである。ソース／ドレイン領域の



接合深さは、特に限定されるものではなく、得ようとする半導体記憶装置の性能等に応じて、適宜調整することができる。なお、半導体基板としてSOI基板を用いる場合には、ソース／ドレイン領域は、表面半導体層の膜厚よりも小さな接合深さを有していてもよいが、表面半導体層の膜厚とほぼ同程度の接合深さを有していることが好ましい。

ソース／ドレイン領域は、ゲート電極端とオーバーラップするように配置していてもよいし、ゲート電極端に対してオフセットされて配置されていてもよい。特に、オフセットされている場合には、ゲート電極に電圧を印加したときの電荷保持膜下のオフセット領域の反転しやすさが電荷保持部に蓄積された電荷量によって大きく変化し、メモリ効果が増大するとともに、短チャネル効果の低減をもたらすため、好ましい。ただし、あまりオフセットしすぎると、ソース・ドレイン間の駆動電流が著しく小さくなる。したがって、オフセット量はメモリ効果と駆動電流の双方が適切な値となるように決定すればよい。

ソース／ドレイン領域は、その一部が、チャネル領域表面、つまり、ゲート絶縁膜下面よりも高い位置に延設されていてもよい。この場合には、半導体基板内に形成されたソース／ドレイン領域上に、このソース／ドレイン領域と一体化した導電膜が積層されて構成されていることが適当である。導電膜としては、例えば、ポリシリコン、アモルファスシリコン等の半導体、シリサイド、上述した金属、高融点金属等が挙げられる。なかでも、ポリシリコンが好ましい。ポリシリコンは、不純物拡散速度が半導体基板に比べて非常に大きいために、半導体基板内におけるソース／ドレイン領域の接合深さを浅くするのが容易で、短チャネル効果の抑制がしやすいためである。なお、この場合には、このソース／ドレイン領域の一部は、ゲート電極とともに、電荷保持膜の少なくとも一部を挟持するように配置することが好ましい。

本発明の半導体記憶装置は、ゲート絶縁膜上に形成された単一のゲート電極、ソース領域、ドレイン領域及び半導体基板を4個の端子として、この4個の端子のそれぞれに所定の電位を与えることにより、書込み、消去、読出しの各動作を行なう。具体的な動作原理及び動作電圧の例は、後述する。本発明の半導体記憶装置をアレイ状に配置してメモリセルアレイを構成した場合、単一の制御ゲート

で各メモリセルを制御できるので、ワード線の本数を少なくすることができる。

本発明の半導体記憶装置は、通常の半導体プロセスによって、例えば、ゲート電極の側壁に積層構造のサイドウォールスペーサを形成する方法と同様の方法によって形成することができる。具体的には、ゲート電極を形成した後、絶縁膜  
5 (第2の絶縁体) / 電荷蓄積膜 (第1の絶縁体) / 絶縁膜 (第2の絶縁体) の積層膜を形成し、適当な条件下でエッチバックしてこれらの膜をサイドウォールスペーサ状に残す方法が挙げられる。

本発明の半導体記憶装置を配列してメモリセルアレイを構成した場合、半導体記憶装置の最良の形態は、例えば、(1) 複数の半導体記憶装置のゲート電極が  
10 一体となってワード線の機能を有する、(2) 上記ワード線の両側には電荷保持部が形成されている、(3) 電荷保持部内で電荷を保持するのは絶縁体、特にシリコン窒化膜である、(4) 電荷保持部はONO (Oxide Nitride Oxide) 膜で構成されており、シリコン窒化膜はゲート絶縁膜の表面と略平行な表面を有している、(5) 電荷保持部中のシリコン窒化膜はワード線及びチャネル領域とシリ  
15 コン酸化膜で隔てられている、(6) 電荷保持部内のシリコン窒化膜と拡散領域とがオーバーラップしている、(7) ゲート絶縁膜の表面と略平行な表面を有するシリコン窒化膜とチャネル領域又は半導体層とを隔てる絶縁膜の厚さと、ゲート絶縁膜の厚さが異なる、(8) 1 個の半導体記憶装置の書込み及び消去動作は単一のワード線により行なう、(9) 電荷保持部の上には書込み及び消去動作を  
20 補助する機能を有する電極 (ワード線) がない、(10) 電荷保持部の直下で拡散領域と接する部分に拡散領域の導電型と反対導電型の不純物濃度が濃い領域を有する、という要件の全てを満たすものである。ただし、これらの要件の1つでも満たすものであればよい。

上述した要件の特に好ましい組み合わせは、例えば、(3) 電荷保持部内で電荷を保持するのが絶縁体、特にシリコン窒化膜であり、(6) 電荷保持部内の絶縁膜 (シリコン窒化膜) と拡散領域とがオーバーラップしており、(9) 電荷保持部の上には書込み及び消去動作を補助する機能を有する電極 (ワード線) が  
25 ない場合である。

要件 (3) 及び要件 (9) を満たす場合には、以下のように、非常に有用であ

る。

まず、ビット線コンタクトをワード線側壁の電荷保持部と、より接近して配置することができ、又は半導体記憶装置間の距離が接近しても、複数の電荷保持部が干渉せず、記憶情報を保持できる。したがって、半導体記憶装置の微細化が容易となる。なお、電荷保持部内の電荷保持領域が導電体の場合、容量カップリングにより半導体記憶装置間が近づくにつれて電荷保持領域間で干渉が起き、記憶情報を保持できなくなる。

また、電荷保持部内の電荷保持領域が絶縁体（例えば、シリコン窒化膜）である場合、メモリセル毎に電荷保持部を独立させる必要がなくなる。例えば、複数のメモリセルで共有される1本のワード線の両側に形成された電荷保持部は、メモリセル毎に分離する必要が無く、1本のワード線の両側に形成された電荷保持部を、ワード線を共有する複数のメモリセルで共有することが可能となる。そのため、電荷保持部を分離するフォト、エッチング工程が不要となり、製造工程が簡略化される。さらに、フォトリソグラフィ工程の位置合わせマージン、エッチングの膜減りマージンが不要となるため、メモリセル間のマージンを縮小できる。したがって、電荷保持部内の電荷保持領域が導電体（例えば、多結晶シリコン膜）である場合と比較して、同じ微細加工レベルで形成しても、メモリセル占有面積を微細化することができる。なお、電荷保持部内の電荷保持領域が導電体である場合、電荷保持部をメモリセル毎に分離するフォト、エッチング工程が必要となり、フォトの位置合わせマージン、エッチングの膜減りマージンが必要となる。

さらに、電荷保持部の上には書込み及び消去動作を補助する機能を有する電極がなく素子構造が単純であるから工程数が減少し、歩留まりを向上させることができる。したがって、論理回路やアナログ回路を構成するトランジスタとの混載を容易にすることができるとともに、安価な半導体記憶装置を得ることができる。

また、要件（3）及び（9）を満たす場合であって、さらに要件（6）を満たす場合には、より有用である。

つまり、電荷保持部内の電荷保持領域と拡散領域とをオーバーラップさせることにより、非常に低電圧で書込、消去が可能となる。具体的には、5 V以下とい

う低電圧により、書込み及び消去動作を行なうことができる。この作用は、回路設計上においても非常に大きな効果である。フラッシュメモリのような高電圧をチップ内で作る必要がなくなるため、莫大な占有面積が必要となるチャージポンピング回路を省略又は規模を小さくすることが可能となる。特に、小規模容量のメモリを調整用としてロジックLSIに内蔵する場合、メモリ部の占有面積はメモリセルよりも、メモリセルを駆動する周辺回路の占有面積が支配的となるため、メモリセル用電圧昇圧回路を省略又は規模を小さくすることは、チップサイズを縮小させるためには最も効果的となる。

一方、要件（３）を満たさない場合、つまり、電荷保持部内で電荷を保持するのが導電体である場合は、要件（６）を満たさない、つまり、電荷保持部内の導電体と拡散領域がオーバーラップしていない場合でも、書込み動作を行なうことができる。これは、電荷保持部内の導電体がゲート電極との容量カップリングにより書込み補助を行なうからである。

また、要件（９）を満たさない場合、つまり、電荷保持部の上に書込み及び消去動作を補助する機能を有する電極がある場合は、要件（６）を満たさない、つまり、電荷保持部内の絶縁体と拡散領域とがオーバーラップしていない場合でも、書込み動作を行なうことができる。

本発明の半導体記憶装置においては、半導体記憶装置は、その一方又は両方に、トランジスタが直列に接続していてもよいし、ロジックトランジスタと、同一のチップ上に混載されていてもよい。このような場合には、本発明の半導体装置、特に半導体記憶装置を、トランジスタ及びロジックトランジスタなどの通常の標準トランジスタの形成プロセスと非常に親和性が高い工程で形成することができるため、同時に形成することができる。したがって、半導体記憶装置とトランジスタ又はロジックトランジスタとを混載するプロセスは非常に簡便なものとなり、安価な混載装置を得ることができる。

本発明の半導体記憶装置は、半導体記憶装置が、１つの電荷保持部に２値又はそれ以上の情報を記憶させることができ、これにより、４値又はそれ以上の情報を記憶する半導体記憶装置として機能させることができる。なお、半導体記憶装置は、２値の情報を記憶させるのみでもよい。また、半導体記憶装置を、電荷保

持部による可変抵抗効果により、選択トランジスタとメモリトランジスタとの機能を兼ね備えたメモリセルとしても機能させることができる。

本発明の半導体記憶装置は、電池駆動の携帯電子機器、特に携帯情報端末に用いることができる。携帯電子機器としては、携帯情報端末、携帯電話、ゲーム機器等が挙げられる。

以下に、本発明の半導体記憶装置について、図面に基づいて詳細に説明する。

(実施の形態1)

本実施の形態の半導体記憶装置を構成するメモリ素子は、2ビットの記憶が可能な不揮発性メモリセルとして、図1に示したように、半導体基板11上に、ゲート絶縁膜12を介して、通常のトランジスタと同程度のゲート長、例えば0.015 $\mu\text{m}$ ~0.5 $\mu\text{m}$ 程度のゲート電極13が形成されており、ゲート絶縁膜12及びゲート電極13の側壁に、サイドウォールスペーサ形状の電荷保持部61、62が形成されて構成されている。また、電荷保持部61、62のゲート電極13と反対の側には、第1の拡散層領域17及び第2の拡散層領域18（ソース/ドレイン領域）が形成されており、このソース/ドレイン領域17、18は、ゲート電極13端部に対して（ゲート電極13が形成された領域41から）オフセットされている。

このように、メモリトランジスタの電荷保持部61、62は、ゲート絶縁膜12とは独立して形成されている。したがって、電荷保持部61、62が担うメモリ機能と、ゲート絶縁膜12が担うトランジスタ動作機能とは分離されている。また、ゲート電極13の両側に形成された2つの電荷保持部61、62はゲート電極13により分離されているので書換え時の干渉が効果的に抑制される。したがって、このメモリトランジスタは、2ビットの記憶が可能で、かつ微細化が容易である。

また、ソース/ドレイン領域17、18がゲート電極13からオフセットされていることにより、ゲート電極13に電圧を印加したときの電荷保持部61下のオフセット領域42の反転しやすさを、電荷保持部61、62に蓄積された電荷量によって大きく変化させることができ、メモリ効果を増大させることが可能となる。更に、通常のロジックトランジスタと比較して、短チャネル効果を強力に

防止することができ、より一層のゲート長の微細化を図ることができる。また、構造的に短チャネル効果抑制に適しているため、ロジックトランジスタと比較して膜厚の厚いゲート絶縁膜を採用することができ、信頼性を向上させることが可能となる。

5        サイドウォールスペーサ形状の電荷保持部 6 1、6 2 は、第 1 の絶縁体からなる膜の一例としてのシリコン窒化膜 1 5 が、第 2 の絶縁体からなる膜の一例としてのシリコン酸化膜 1 4 と、第 3 の絶縁体からなる膜の一例としてのシリコン酸化膜 1 6 で挟まれた構造を有している。シリコン窒化膜 1 5 は、電荷（電子又は正孔）をトラップして蓄積する機能を有している。主として電荷を蓄積するのは、  
10        シリコン窒化膜 1 5 のうち、オフセット領域 4 2 上に存する部分（領域 4 3）である。このように、電荷保持部 6 1、6 2 はシリコン窒化膜 1 5 がシリコン酸化膜 1 4、1 6 によって挟まれた構造を有するため、電荷保持部 6 1、6 2 への電荷注入効率が上がり、書換え動作（書込み及び消去動作）の高速化が実現する。

15        シリコン窒化膜 1 5 の少なくとも一部が第 1 の拡散層領域 1 7 または第 2 の拡散層領域 1 8 の一部にオーバーラップするように形成されてなることが好ましい。

      また、シリコン窒化膜 1 5 は、ゲート絶縁膜 1 2 の表面と略平行な表面を有する部分を含むのが好ましい。

      また、シリコン窒化膜 1 5 が、ゲート電極 1 2 の側面と略並行に延びた部分を含むのが好ましい。

20        図 2 は、図 1 に記載したメモリ素子の、一方のゲート端付近での拡大図である。主として電荷を蓄積するのは領域 4 3 であるから、オフセット領域 4 2 上におけるシリコン酸化膜 1 4 の厚さ  $T_1$  及びシリコン窒化膜 1 5 の厚さ  $T_2$  が、メモリ特性に大きな影響を与える。

25        オフセット領域 4 2 上におけるシリコン酸化膜 1 4 の厚さ  $T_1$  は、以下のように設定するのが好ましい。シリコン酸化膜 1 4 の厚さ  $T_1$  が 1.5 nm 以下の場合、領域 4 3 に蓄積した電荷がシリコン酸化膜 1 4 を通して逃げやすくなり、保持時間が著しく短くなる。一方、 $T_1$  が 15 nm 以上では、領域 4 3 への電荷注入効率が悪化し、書込み時間の増大が無視できなくなる。したがって、シリコン酸化膜 1 4 の厚さ  $T_1$  は、1.5 nm～15 nm とすれば、十分な保持時間と高

速な書換えが両立するので、好ましい。T1は、5 nm～12 nmとするのが、より好ましい。

オフセット領域42上におけるシリコン窒化膜15の厚さT2は、以下のように設定するのが好ましい。シリコン窒化膜15の厚さT2が2 nm以下の場合、シリコン窒化膜15中に含まれる電荷トラップ密度が十分でなくなるため、メモリ素子の閾値変化（あるいは読出し電流変化）が十分でなくなる。更には、シリコン窒化膜15の膜厚ばらつきが与える素子間ばらつきが無視できなくなる。一方、シリコン窒化膜15の厚さT2が15 nm以上では、書換え時にシリコン窒化膜中に一様に電荷を注入するのが難しく、もしくはより長い時間を要する。また、シリコン窒化膜15に一様に電荷が注入されなかった場合、記憶保持中にシリコン窒化膜15中で電荷が移動し、閾値（あるいは読出し電流）の変化が問題となる。したがって、シリコン窒化膜15の厚さT2は、2 nm～15 nmとすれば、メモリ素子は十分な信頼性を備えるので、好ましい。T2は、3 nm～7 nmとするのが、より好ましい。

図3は、図2の切断面線A-A'における、電子に対するエネルギーダイアグラム（エネルギーバンド図）を示している。なお、簡単のため、バンドは全てフラット（真空準位VLが位置によらず一定）としている。図3中、ECsは半導体（半導体基板11）の伝導電子帯の最低準位、EVsは半導体の価電子帯の最高準位、Efsは半導体のフェルミレベル、EC1は第1の絶縁体（シリコン窒化膜15）の伝導電子帯の最低準位、EV1は第1の絶縁体の価電子帯の最高準位、EC2は第2の絶縁体（シリコン酸化膜14）の伝導電子帯の最低準位、EV2は第2の絶縁体の価電子帯の最高準位、EC3は第3の絶縁体（シリコン酸化膜16）の伝導電子帯の最低準位、EV3は第3の絶縁体の価電子帯の最高準位である。したがって、 $\chi_1$ は第1の絶縁体における真空準位と伝導電子帯の最低準位とのエネルギー差（電子親和力）、 $\phi_1$ は第1の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差、 $\chi_2$ は第2の絶縁体における真空準位と伝導電子帯の最低準位とのエネルギー差（電子親和力）、 $\phi_2$ は第2の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差、 $\chi_3$ は第3の絶縁体における真空準位と伝導電子帯の最低準位とのエネルギー差（電子親和力）、 $\phi$

3は第3の絶縁体における真空準位と価電子帯の最高準位とのエネルギー差を示している。

電荷を蓄積する第1の絶縁体に電子が蓄積する場合、 $x_1 > x_2$ かつ $x_1 > x_3$ であることが好ましい。この場合、第1の絶縁体（シリコン窒化膜15）に電子を注入する際に、第3の絶縁体（シリコン酸化膜16）が障壁となって、電子の注入効率が高くなる。また、第1の絶縁体に蓄積された電子が半導体基板11に漏れるのを効率的に防止することができる。したがって、高速の書込み動作と良好な保持特性が実現する。

電荷を蓄積する第1の絶縁体に正孔が蓄積する場合、 $\phi_1 < \phi_2$ かつ $\phi_1 < \phi_3$ であることが好ましい。この場合、第1の絶縁体（シリコン窒化膜15）に正孔を注入する際に、第3の絶縁体（シリコン酸化膜16）が障壁となって、正孔の注入効率が高くなる。また、第1の絶縁体に蓄積された正孔が半導体基板11に漏れるのを効率的に防止することができる。したがって、高速の書込み動作と良好な保持特性が実現する。

なお、上記4条件（ $x_1 > x_2$ 、 $x_1 > x_3$ 、 $\phi_1 < \phi_2$ 、 $\phi_1 < \phi_3$ ）が全て満たされるのがより好ましい。例えば、電荷を蓄積する第1の絶縁体に電子が蓄積する場合であっても、蓄積された電子を除去するために正孔を注入する場合は、正孔の注入効率が高くなり、消去動作をも高速化することができる。

本実施例では、第1の絶縁体はシリコン窒化膜、第2及び第3の絶縁体はシリコン酸化膜であったが、その限りではない。例えば、第1の絶縁体を酸化ハフニウム、酸化タンタル、酸化イットリウム、酸化ジルコニウムなどの高誘電材料とすることができる。更に、第2及び第3の絶縁体を酸化アルミニウムとすることができる。

このメモリの書込み動作原理を、図4A、図4Bを用いて説明する。

ここで、書込みとは、電荷保持部61、62に電子を注入することを指すこととする。

第2の電荷保持部62に電子を注入する（書込む）ためには、図4Aに示すように、第1の拡散層領域17をソース電極に、第2の拡散層領域18をドレイン電極とする。例えば、第1の拡散層領域17及び半導体基板11に0V、第2の



拡散層領域 18 に +5 V、ゲート電極 13 に +2 V を印加すればよい。このような電圧条件によれば、反転層 31 が、第 1 の拡散層領域 17 (ソース電極) から伸びるが、第 2 の拡散層領域 18 (ドレイン電極) に達することなく、ピンチオフ点が発生する。電子は、ピンチオフ点から第 2 の拡散層領域 18 (ドレイン電極) まで高電界により加速され、いわゆるホットエレクトロン (高エネルギーの伝導電子) となる。このホットエレクトロンが第 2 の電荷保持部 62 (より正確にはシリコン窒化膜 15) に注入されることにより書込みが行なわれる。なお、第 1 の電荷保持部 61 近傍では、ホットエレクトロンが発生しないため、書込みは行なわれない。

このようにして、第 2 の電荷保持部 62 に電子を注入して、書込みを行なうことができる。

一方、第 1 の電荷保持部 61 に電子を注入する (書込む) ためには、図 4 B に示すように、第 2 の拡散層領域 18 をソース電極に、第 1 の拡散層領域 17 をドレイン電極とする。例えば、第 2 の拡散層領域 18 及び半導体基板 11 に 0 V、第 1 の拡散層領域 17 に +5 V、ゲート電極 13 に +2 V を印加すればよい。このように、第 2 の電荷保持部 62 に電子を注入する場合とは、ソース/ドレイン領域を入れ替えることにより、第 1 の電荷保持部 61 に電子を注入して、書込みを行なうことができる。

次に、上記メモリ素子の読み出し動作原理を説明する。

第 1 の電荷保持部 61 に記憶された情報を読み出す場合、第 1 の拡散層領域 17 をソース電極に、第 2 の拡散層領域 18 をドレイン電極とし、トランジスタを飽和領域動作させる。例えば、第 1 の拡散層領域 17 及び半導体基板 11 に 0 V、第 2 の拡散層領域 18 に +2 V、ゲート電極 13 に +1 V を印加すればよい。この際、第 1 の電荷保持部 61 に電子が蓄積していない場合には、ドレイン電流が流れやすい。一方、第 1 の電荷保持部 61 に電子が蓄積している場合は、第 1 の電荷保持部 61 近傍で反転層が形成されにくいので、ドレイン電流は流れにくい。したがって、ドレイン電流を検出することにより、第 1 の電荷保持部 61 の記憶情報を読み出すことができる。このとき、第 2 の電荷保持部 62 における電荷蓄積の有無は、ドレイン近傍がピンチオフしているため、ドレイン電流に影響を与

えない。

第2の電荷保持部62に記憶された情報を読み出す場合、第2の拡散層領域18をソース電極に、第1の拡散層領域17をドレイン電極とし、トランジスタを飽和領域動作させる。例えば、第2の拡散層領域18及び半導体基板11に0V、  
5 第1の拡散層領域17に+2V、ゲート電極13に+1Vを印加すればよい。このように、第1の電荷保持部61に記憶された情報を読み出す場合とは、ソース／ドレイン領域を入れ替えることにより、第2の電荷保持部62に記憶された情報の読出しを行なうことができる。

以上の説明から明らかなように、一方の側の電荷保持部に注目した場合、書込みを行なう場合と、読み出し動作をおこなう場合とでは、ソースとドレインとを入れ替えている。言い換えれば、読み出し動作時と書込み動作時で、第1の拡散層領域と第2の拡散層領域とに印加する電圧の大小関係を反対にしている。そのため、2つの電荷保持部のそれぞれに記憶された情報を感度よく検出することができるのである。

15 なお、ゲート電極13で覆われないチャネル領域（オフセット領域42）が残されている場合、ゲート電極13で覆われないチャネル領域においては、電荷保持部61、62の余剰電子の有無によって反転層が消失又は形成され、その結果、大きなヒステリシス（閾値の変化）が得られる。ただし、オフセット領域42の幅があまり大きいと、ドレイン電流が大きく減少し、読出し速度が大幅に遅くなる。  
20 したがって、十分なヒステリシスと読出し速度が得られるように、オフセット領域42の幅を決定することが好ましい。

第1、第2の拡散層領域17、18がゲート電極13端に達している場合、つまり、第1、第2の拡散層領域17、18とゲート電極13とがオーバーラップしている場合であっても、書込み動作によりトランジスタの閾値はほとんど変わ  
25 らなかったが、ソース／ドレイン端での寄生抵抗が大きく変わり、ドレイン電流は大きく減少（1桁以上）した。したがって、ドレイン電流の検出により読出しが可能であり、メモリとしての機能を得ることができる。ただし、より大きなメモリヒステリシス効果を必要とする場合、第1、第2の拡散層領域17、18とゲート電極13とがオーバーラップしていない（オフセット領域42が存在す

る) ほうが好ましい。

更に、上記半導体記憶装置の消去動作原理を図 5 で説明する。

まず、第 1 の方法として、第 1 の電荷保持部 6 1 に記憶された情報を消去する場合、第 1 の拡散層領域 1 7 に正電圧 (例えば、+ 6 V)、半導体基板 1 1 に 0 V を印加して、第 1 の拡散層領域 1 7 と半導体基板 1 1 との P N 接合に逆バイアスをかけ、更にゲート電極 1 3 に負電圧 (例えば、- 5 V) を印加すればよい。このとき、上記 P N 接合のうちゲート電極 1 3 付近では、負電圧が印加されたゲート電極の影響により、特にポテンシャルの勾配が急になる。そのため、バンド間トンネルにより P N 接合の半導体基板 1 1 側にホットホール (高エネルギーの正孔) が発生する。このホットホールが負の電位をもつゲート電極 1 3 方向に引きこまれ、その結果、第 1 の電荷保持部 6 1 にホール注入が行なわれる。このようにして、第 1 の電荷保持部 6 1 の消去が行なわれる。このとき第 2 の拡散層領域 1 8 には 0 V を印加すればよい。

第 2 の電荷保持部 6 2 に記憶された情報を消去する場合は、上記において第 1 の拡散層領域と第 2 の拡散層領域の電位を入れ替えればよい。

第 2 の方法として、図 6 に示すように第 1 の電荷保持部 6 1 に記憶された情報を消去する場合、第 1 の拡散層領域 1 7 に正電圧 (例えば、+ 5 V)、第 2 の拡散層領域 1 8 に 0 V、ゲート電極 1 3 に負電圧 (例えば、- 4 V)、半導体基板 1 1 に正電圧 (例えば、+ 0. 8 V) を印加すればよい。この際、半導体基板 1 1 と第 2 の拡散層領域 1 8 との間に順方向電圧が印加され、半導体基板 1 1 に電子が注入される。注入された電子は、半導体基板 1 1 と第 1 の拡散層領域 1 7 との P N 接合まで拡散し、そこで強い電界により加速されてホットエレクトロンとなる。このホットエレクトロンは、P N 接合において、電子-ホール対を発生させる。すなわち、半導体基板 1 1 と第 2 の拡散層領域 1 8 との間に順方向電圧を印加することにより、半導体基板 1 1 に注入された電子がトリガーとなって、反対側に位置する P N 接合でホットホールが発生する。P N 接合で発生したホットホールは負の電位をもつゲート電極 1 3 方向に引きこまれ、その結果、第 1 の電荷保持部 6 1 に正孔注入が行なわれる。

この第 2 の方法によれば、半導体基板 1 1 と第 1 の拡散層領域 1 7 との P N 接

合において、バンド間トンネルによりホットホールが発生するに足りない電圧しか印加されない場合においても、第2の拡散層領域18から注入された電子は、PN接合で電子-正孔対が発生するトリガーとなり、ホットホールを発生させることができる。したがって、消去動作時の電圧を低下させることができる。特に、  
5 オフセット領域42が存在する場合は、負の電位が印加されたゲート電極により上記PN接合が急峻となる効果が少ない。そのため、バンド間トンネルによるホットホールの発生が難しいのであるが、第2の方法はその欠点を補い、低電圧で消去動作を実現することができる。

なお、第1の電荷保持部61に記憶された情報を消去する場合、第1の消去方法では、第1の拡散層領域17に+6Vを印加しなければならなかったが、第2  
10 の消去方法では、+5Vで足りた。このように、第2の方法によれば、消去時の電圧を低減することができるので、消費電力が低減され、ホットキャリアによる半導体記憶装置の劣化を抑制することができる。

この第2の方法は、本発明における半導体記憶装置に適用されるのみならず、  
15 例えば、従来技術であるサイファン・セミコンダクターズ・リミテッド社のメモリ素子(図21)においても、適用することができる。この場合も、記憶を消去するための動作電圧を低下することができ、低消費電力化、メモリ素子劣化の抑制を実現することができる。

以上の動作方法により、1トランジスタ当たり選択的に2ビットの書込み及び消去が可能となる。  
20

また、上記動作方法では、ソース電極とドレイン電極を入れ替えることによって1トランジスタ当たり2ビットの書込み及び消去をさせているが、ソース電極とドレイン電極を固定して1ビットメモリとして動作させてもよい。この場合ソース/ドレイン領域の一方を共通固定電圧とすることが可能となり、ソース/ドレイン領域に接続されるビット線の本数を半減できる。  
25

このメモリ素子は、通常のロジックトランジスタとは、ほぼ同様の工程を経て形成することができる。まず、図7Aに示すように、半導体基板11上に、膜厚1~6nm程度のシリコン酸窒化膜からなるゲート絶縁膜12及び膜厚50~400nm程度のポリシリコン、ポリシリコンと高融点金属シリサイドの積層膜又

はポリシリコンと金属との積層膜からなるゲート電極材料膜を形成し、所望の形状にパターニングすることによりゲート電極13を形成した。なお、ゲート絶縁膜及びゲート電極の材料は、上述したように、その時代のスケーリング則に則ったロジックプロセスにおいて使われる材料を用いればよく、上記材料に限定されるものではない。

続いて、図7Bに示すように、得られた半導体基板11上全面に、膜厚1.5～15nm、より好ましくは膜厚5～12nmのシリコン酸化膜51をCVD (Chemical Vapor Deposition)法により堆積した。なお、シリコン酸化膜51は熱酸化によって形成してもよい。次に、シリコン酸化膜51上全面に、膜厚2～15nm、より好ましくは3～7nmのシリコン窒化膜52をCVD法により堆積した。更に、シリコン窒化膜52上全面に、20～70nmのシリコン酸化膜53をCVD法により堆積した。

続いて、図7Cに示すように、異方性エッチングによりシリコン酸化膜53、51及びシリコン窒化膜52をエッチバックすることにより、記憶に最適な電荷保持部を、ゲート電極の側壁にサイドウォールスペーサ状に形成した。その後、ゲート電極13及びサイドウォールスペーサ状の電荷保持部をマスクとしてイオン注入することにより、ソース/ドレイン領域17、18を形成した。

本実施の形態1の半導体記憶装置によれば、メモリトランジスタの電荷保持部は、ゲート絶縁膜とは独立して形成され、ゲート電極の両側に形成されている。そのため、2ビット動作が可能である。更には、各電荷保持部はゲート電極により分離されているので書換え時の干渉が効果的に抑制される。また、電荷保持部が担うメモリ機能と、ゲート絶縁膜が担うトランジスタ動作機能とは分離されているので、ゲート絶縁膜圧を薄膜化して短チャネル効果を抑制することができる。したがって素子の微細化が容易となる。

また、電荷保持部としてメモリ機能に適した材料膜を選択して形成することができる。本実施例では、シリコン酸化膜とシリコン窒化膜との積層膜（シリコン酸化膜／シリコン窒化膜／シリコン酸化膜）からなる電荷保持部を用いているので、電荷の注入効率が上がり、かつ、電荷の漏れを軽減することができる。したがって、高速な書換え動作特性と優れた保持特性を併せ持つ半導体記憶装置が提

供される。

(実施の形態 2)

本実施の形態 2 の半導体記憶装置であるメモリ素子は、上記実施の形態 1 の半導体記憶装置において、ゲート電極から電荷保持部への電荷の注入を抑制したものである。

本実施の形態のメモリ素子を、図 8 を用いて説明する。本実施の形態のメモリ素子は、ゲート電極 1 3 の側壁でのシリコン酸化膜 1 4 の厚さ  $T_{1B}$  が、半導体基板上 1 1 上でのシリコン酸化膜 1 4 の厚さ  $T_{1A}$  よりも厚いことを特徴としている。そのため、ゲート電極 1 3 からシリコン窒化膜 1 5 への電荷の注入（あるいはシリコン窒化膜 1 5 からゲート電極 1 3 への電荷の放出）を効果的に抑制することができる。したがって、メモリ素子の書換え特性が安定し、信頼性が向上する。

本実施の形態 2 のメモリ素子を形成する手順を、図 9 A、図 9 B、図 9 C により説明する。以下、半導体基板はシリコン基板であり、ゲート電極は多結晶シリコンからなる場合を説明する。図 9 A に示すように、半導体（シリコン）基板 1 1 上にゲート絶縁膜 1 2 およびゲート電極を形成した。この時、ゲート電極 1 3 は、多結晶シリコンからなるのが好ましい。次に、図 9 B に示すように、熱酸化によりシリコン基板 1 1 及びゲート電極 1 3 の表面にシリコン酸化膜 5 1 を形成した。この時、シリコン酸化膜 5 1 の膜厚は、シリコン基板 1 1 上（領域 7 1）よりも、ゲート電極 1 3 の側壁（領域 7 2）の方が厚くなった。これは、単結晶シリコンよりも多結晶シリコンの熱酸化レートが大きいからである。その後、図 9 C に示すように、実施の形態 1 と同様な手順でメモリ素子を完成した。

上記手順によれば、結晶性の違いによる酸化レートの違いを利用することにより、特に工程を増やすことなくゲート電極側壁の酸化膜厚を選択的に厚くすることができる。したがって、安定した書換え特性が有し、信頼性が高いメモリ素子を簡単な工程で形成することが可能となる。

(実施の形態 3)

本実施の形態 3 の半導体記憶装置は、図 1 0 に示すように、電荷保持部 1 6 1、1 6 2 が電荷を保持する領域（電荷を蓄える領域であって、電荷を保持する機能

を有する膜であってもよい)と電荷を逃げにくくする領域(電荷を逃げにくくする機能を有する膜であってもよい)から構成される。例えば、上記半導体記憶装置はONO構造を有している。すなわち、第2の絶縁体からなる膜の一例としてのシリコン酸化膜141と、第3の絶縁体からなる膜の一例としてのシリコン酸化膜143との間に、第1の絶縁体からなる膜の一例としてのシリコン窒化膜142が挟まれ、電荷保持部161、162を構成している。ここで、シリコン窒化膜142は電荷を保持する機能を果たす。また、シリコン酸化膜141、143はシリコン窒化膜142中に蓄えられた電荷を逃げにくくする機能を有する膜の役割を果たす。

また、電荷保持部161、162における電荷を保持する領域(シリコン窒化膜142)は、拡散層領域112、113とそれぞれオーバーラップしている。ここで、オーバーラップするとは、拡散層領域112、113の少なくとも一部の領域上に、電荷を保持する領域(シリコン窒化膜142)の少なくとも一部が存在することを意味する。なお、111は半導体基板、114はゲート絶縁膜、117はゲート絶縁膜114上に形成された単一のゲート電極、171は(ゲート電極と拡散層領域との)オフセット領域である。図示しないが、ゲート絶縁膜114下であって半導体基板111最表面部はチャネル領域となる。

電荷保持部161、162における電荷を保持する領域(シリコン窒化膜142)と拡散層領域112、113とがオーバーラップすることによる効果を説明する。

図11は、図10の右側の電荷保持部162周辺部の拡大図である。W1はゲート電極117と拡散層領域113とのオフセット量を示す。また、W2はゲート電極117のチャネル長方向の切断面における電荷保持部162の幅を示しているが、電荷保持部162のうちシリコン窒化膜142のゲート電極117と離れた側の端が、ゲート電極117から離れた側の電荷保持部162の端と一致しているため、電荷保持部162の幅をW2として定義した。電荷保持部162と拡散層領域113とのオーバーラップ量は $W2 - W1$ で表される。特に重要なことは、電荷保持部162のうちシリコン窒化膜142が、拡散層領域113とオーバーラップする、つまり、 $W2 > W1$ なる関係を満たすことである。

なお、図12に示すように、電荷保持部162aのうち電荷保持膜142aのゲート電極117と離れた側の端が、ゲート電極117から離れた側の電荷保持部162aの端と一致していない場合は、W2をゲート電極117のシリコン酸化膜141a側の端から電荷保持膜142aのゲート電極117と遠い側の端までと定義すればよい。

図13は、図11の構造において、電荷保持部162の幅W2を100nmに固定し、オフセット量W1を変化させたときのドレイン電流 $I_d$ を示している。ここで、ドレイン電流は、電荷保持部162を消去状態（ホールが蓄積されている）とし、拡散層領域112、113をそれぞれソース電極、ドレイン電極として、デバイスシミュレーションにより求めた。

図13から明らかなように、W1が100nm以上（すなわち、シリコン窒化膜142と拡散層領域113とがオーバーラップしない）では、ドレイン電流が急速に減少している。ドレイン電流値は、読み出し動作速度にほぼ比例するので、W1が100nm以上ではメモリの性能は急速に劣化する。一方、シリコン窒化膜142と拡散層領域113とがオーバーラップする範囲においては、ドレイン電流の減少は緩やかである。したがって、電荷を保持する機能を有する膜であるシリコン窒化膜142の少なくとも一部とソース／ドレイン領域（拡散層領域113）とがオーバーラップすることが好ましい。これと同様に、電荷保持部161においても、電荷を保持する機能を有する膜であるシリコン窒化膜142の少なくとも一部とソース／ドレイン領域（拡散層領域112）とがオーバーラップすることが好ましい。

上述したデバイスシミュレーションの結果を踏まえて、W2を100nm固定とし、W1を設計値として60nm及び100nmとして、メモリセルアレイを作製した。W1が60nmの場合、シリコン窒化膜142と拡散層領域112、113とは設計値として40nmオーバーラップし、W1が100nmの場合、設計値としてオーバーラップしない。これらのメモリセルアレイの読み出し時間を測定した結果、ばらつきを考慮したワーストケースで比較して、W1を設計値として60nmとした場合の方が、読み出しアクセス時間で100倍高速であった。実用上、読み出しアクセス時間は1ビットあたり100ナノ秒以下であることが



好ましいが、 $W1 = W2$ では、この条件を到底達成できないことが分かった。また、製造ばらつきまで考慮した場合、 $W2 - W1 > 10 \text{ nm}$ であることがより好ましいことが判明した。

5 電荷保持部161（領域181）に記憶された情報の読み出しは、実施の形態1と同様に、拡散層領域112をソース電極とし、拡散層領域113をドレイン領域としてチャンネル領域中のドレイン領域に近い側にピンチオフ点を形成するのが好ましい。すなわち、2つの電荷保持部のうち一方に記憶された情報を読み出す時に、ピンチオフ点をチャンネル領域内であって、他方の電荷保持部に近い領域に形成させるのが好ましい。これにより、電荷保持部162の記憶状況の如何にかかわらず、電荷保持部161の記憶情報を感度よく検出することができ、2ビット動作を可能にする大きな要因となる。

10 一方、2つの電荷保持部の片側のみに情報を記憶させる場合又は2つの電荷保持部を同じ記憶状態にして使用する場合には、読出し時に必ずしもピンチオフ点を形成しなくてもよい。

15 なお、図10には図示していないが、半導体基板111の表面にウェル領域（Nチャンネル素子の場合はP型ウェル）を形成することが好ましい。ウェル領域を形成することにより、チャンネル領域の不純物濃度をメモリ動作（書換え動作及び読出し動作）に最適にしつつ、その他の電気特性（耐圧、接合容量、短チャンネル効果）を制御するのが容易になる。

20 電荷保持部161、162は、メモリの保持特性を向上させる観点から、電荷を保持する機能を有する電荷保持膜と絶縁膜とを含んでいるのが好ましい。この実施の形態では、電荷保持膜として電荷をトラップする準位を有するシリコン窒化膜142、絶縁膜として電荷保持膜に蓄積された電荷の散逸を防ぐ働きのあるシリコン酸化膜141、143を用いている。電荷保持部が電荷保持膜と絶縁膜とを含むことにより電荷の散逸を防いで保持特性を向上させることができる。さらに、電荷保持部が電荷保持膜のみで構成される場合に比べて電荷保持膜の体積を適度に小さくすることができる。電荷保持膜の体積を適度に小さくすることにより電荷保持膜内での電荷の移動を制限し、記憶保持中に電荷移動による特性変化が起こるのを抑制することができる。

また、電荷保持部 161、162 は、ゲート絶縁膜 114 の表面と略平行に配置される電荷保持膜を含むこと、言い換えると、電荷保持部 161、162 における電荷保持膜の上面が、ゲート絶縁膜 114 の上面から等しい距離に位置するように配置されることが好ましい。具体的には、図 14 に示したように、電荷保持部 162 の電荷保持膜 142a が、ゲート絶縁膜 114 の表面と略平行な面を有している。言い換えると、電荷保持膜 142a は、ゲート絶縁膜 114 の表面に対応する高さから、均一な高さに形成されることが好ましい。電荷保持部 162 中に、ゲート絶縁膜 114 表面と略平行な電荷保持膜 142a があることにより、電荷保持膜 142a に蓄積された電荷の多寡によりオフセット領域 171 での反転層の形成されやすさを効果的に制御することができ、ひいてはメモリ効果を大きくすることができる。また、電荷保持膜 142a をゲート絶縁膜 114 の表面と略平行とすることにより、オフセット量 (W1) がばらついた場合でもメモリ効果の変化を比較的小さく保つことができ、メモリ効果のばらつきを抑制することができる。しかも、電荷保持膜 142a 上部方向への電荷の移動が抑制され、記憶保持中に電荷移動による特性変化が起こるのを抑制することができる。

さらに、電荷保持部 162 は、ゲート絶縁膜 114 の表面と略平行な電荷保持膜 142a とチャネル領域 (又はウェル領域) とを隔てる絶縁膜 (例えば、シリコン酸化膜 144 のうちオフセット領域 171 上の部分) を含むことが好ましい。この絶縁膜により、電荷保持膜に蓄積された電荷の散逸が抑制され、さらに保持特性の良い半導体記憶装置を得ることができる。

なお、電荷保持膜 142a の膜厚を制御すると共に、電荷保持膜 142a 下の絶縁膜 (シリコン酸化膜 144 のうちオフセット領域 171 上の部分) の膜厚を一定に制御することにより、半導体基板 111 の表面から電荷保持膜中に蓄えられる電荷までの距離を概ね一定に保つことが可能となる。つまり、半導体基板表面から電荷保持膜中に蓄えられる電荷までの距離を、電荷保持膜 142a 下の絶縁膜の最小膜厚値から、電荷保持膜 142a 下の絶縁膜の最大膜厚値と電荷保持膜 142a の最大膜厚値との和までの間に制御することができる。これにより、電荷保持膜 142a に蓄えられた電荷により発生する電気力線の密度を概ね制御することが可能となり、メモリ素子のメモリ効果の大きさばらつきを非常に小さく

くすることが可能となる。

(実施の形態4)

本実施の形態4は、電荷保持部162の電荷保持膜142が、図15に示すように、略均一な膜厚で、ゲート絶縁膜114の表面と略平行に配置され（矢印181）、さらに、ゲート電極117側面と略平行に配置された（矢印182）形状を有している。

ゲート電極117に正電圧が印加された場合には、電荷保持部162中での電気力線は矢印183のように、シリコン窒化膜142を2回（矢印182及び矢印181が示す部分）通過する。なお、ゲート電極117に負電圧が印加された時は電気力線の向きは反対側となる。ここで、シリコン窒化膜142の比誘電率は約6であり、シリコン酸化膜141、143の比誘電率は約4である。したがって、矢印181で示す電荷保持膜のみが存在する場合よりも、矢印181および矢印182で示す電荷保持膜が存在する場合の方が、電気力線183方向における電荷保持部162の実効的な比誘電率が大きくなり、電気力線の両端での電位差をより小さくすることができる。すなわち、ゲート電極117に印加された電圧の多くの部分が、オフセット領域171における電界を強くするために使われることになる。

書換え動作時に電荷がシリコン窒化膜142に注入されるのは、発生した電荷がオフセット領域171における電界により引き込まれるためである。したがって、矢印182で示される電荷保持膜を含むことにより、書換え動作時に電荷保持部162に注入される電荷が増加し、書換え速度が増大する。

なお、シリコン酸化膜143の部分もシリコン窒化膜であった場合、つまり、電荷保持膜がゲート絶縁膜114の表面に対応する高さに対して均一でない場合、シリコン窒化膜の上方向への電荷の移動が顕著になって、保持特性が悪化する。

電荷保持膜は、シリコン窒化膜に代えて、比誘電率が非常に大きい酸化ハフニウムなどの高誘電体により形成されることがより好ましい。

さらに、電荷保持部161、162は、ゲート絶縁膜114の表面と略平行な電荷保持膜とチャネル領域（又はウェル領域）とを隔てる絶縁膜（シリコン酸化膜141のうちオフセット領域171上の部分）をさらに含むことが好ましい。

この絶縁膜により、電荷保持膜に蓄積された電荷の散逸が抑制され、さらに保持特性を向上させることができる。

5 また、電荷保持部は、ゲート電極と、ゲート電極側面と略平行な向きに延びた電荷保持膜とを隔てる絶縁膜（シリコン酸化膜 141 のうちゲート電極 117 に接した部分）をさらに含むことが好ましい。この絶縁膜により、ゲート電極から電荷保持膜へ電荷が注入されて電気的特性が変化することを防止し、半導体記憶装置の信頼性を向上させることができる。

10 さらに、実施の形態 3 と同様に、シリコン窒化膜 142 下の絶縁膜（シリコン酸化膜 141 のうちオフセット領域 171 上の部分）の膜厚を一定に制御すること、さらにゲート電極側面上に配置する絶縁膜（シリコン酸化膜 141 のうちゲート電極 117 に接した部分）の膜厚を一定に制御することが好ましい。これにより、シリコン窒化膜 142 に蓄えられた電荷により発生する電気力線の密度を概ね制御することができるとともに、電荷リークを防止することができる。

（実施の形態 5）

15 本実施の形態 5 は、ゲート電極、電荷保持部及びソース／ドレイン領域間距離の最適化に関する。

図 16 に示したように、A はチャネル長方向の切断面におけるゲート電極長、B はソース／ドレイン領域間の距離（チャネル長）、C は一方の電荷保持部の端から他方の電荷保持部の端までの距離、つまり、チャネル長方向の切断面における一方の電荷保持部内の電荷を保持する機能を有する膜の端（ゲート電極と離れている側）から他方の電荷保持部内の電荷を保持する機能を有する膜の端（ゲート電極と離れている側）までの距離を示す。

20 まず、 $B < C$  であることが好ましい。チャネル領域のうちゲート電極 117 下の部分とソース／ドレイン領域 112、113 との間にはオフセット領域 171 が存する。 $B < C$  により、電荷保持部 161、162（シリコン窒化膜 142）に蓄積された電荷により、オフセット領域 171 の全領域において、反転の容易性が効果的に変動する。したがって、メモリ効果が増大し、特に読出し動作の高速化が実現する。

また、ゲート電極 117 とソース／ドレイン領域 112、113 がオフセット

している場合、つまり、 $A < B$ が成立する場合には、ゲート電極に電圧を印加したときのオフセット領域の反転のしやすさが電荷保持部に蓄積された電荷量によって大きく変化し、メモリ効果が増大するとともに、短チャネル効果を低減することができる。ただし、メモリ効果が発現する限りにおいては、オフセット領域

5      が必ずしも存在する必要はない。オフセット領域171がない場合においても、ソース/ドレイン領域112、113の不純物濃度が十分に薄ければ、電荷保持部161、162（シリコン窒化膜142）においてメモリ効果が発現し得る。

したがって、 $A < B < C$ であるのが最も好ましい。

#### （実施の形態6）

10      この実施の形態の半導体記憶装置は、図17に示すように、実施の形態3における半導体基板をSOI基板とする以外は、実質的に同様の構成を有する。

この半導体記憶装置は、半導体基板186上に埋め込み酸化膜188が形成され、さらにその上にSOI層が形成されている。SOI層内には拡散層領域112、113が形成され、それ以外の領域はボディ領域（半導体層）187となっ

15      ている。

この半導体記憶装置によっても、実施の形態3の半導体記憶装置と同様の作用効果を奏する。さらに、拡散層領域112、113とボディ領域187との接合容量を著しく小さくすることができるので、素子の高速化や低消費電力化が可能となる。

#### （実施の形態7）

20      この実施の形態の半導体記憶装置は、図18に示すように、実施の形態3において、N型のソース/ドレイン領域112、113のチャネル側に隣接して、P型高濃度領域191を追加した以外は、実質的に同様の構成を有する。

すなわち、P型高濃度領域191におけるP型を与える不純物（例えばボロン）濃度が、領域192におけるP型を与える不純物濃度より高い。P型高濃度領域191におけるP型の不純物濃度は、例えば、 $5 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 程度が適当である。また、領域192のP型の不純物濃度は、例えば、 $5 \times 10^{16} \sim 1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ とすることができる。

25     

このように、P型高濃度領域191を設けることにより、拡散層領域112、

113と半導体基板111との接合が、電荷保持部161、162の直下で急峻となる。そのため、書込み及び消去動作時にホットキャリアが発生し易くなり、書込み動作及び消去動作の電圧を低下させ、あるいは書込み動作及び消去動作を高速にすることが可能となる。さらに、領域192の不純物濃度は比較的薄いので、メモリが消去状態にあるときの閾値が低く、ドレイン電流は大きくなる。そのため、読出し速度が向上する。したがって、書換え電圧が低く又は書換え速度が高速で、かつ、読出し速度が高速な半導体記憶装置を得ることができる。

また、図18において、ソース/ドレイン領域近傍であって電荷保持部161、162の下（すなわち、ゲート電極117の直下ではない）において、P型高濃度領域191を設けることにより、トランジスタ全体としての閾値は著しく上昇する。この上昇の程度は、P型高濃度領域191がゲート電極117の直下にある場合に比べて著しく大きい。電荷保持部161、162に書込み電荷（トランジスタがNチャネル型の場合は電子）が蓄積した場合は、この差がいっそう大きくなる。一方、電荷保持部161、162に十分な消去電荷（トランジスタがNチャネル型の場合は正孔）が蓄積された場合は、トランジスタ全体としての閾値は、ゲート電極117下のチャネル領域（領域192）の不純物濃度で決まる閾値まで低下する。すなわち、消去時の閾値は、P型高濃度領域191の不純物濃度には依存せず、一方で、書込み時の閾値は非常に大きな影響を受ける。よって、P型高濃度領域191を電荷保持部の下であってソース/ドレイン領域近傍に配置することにより、書込み時の閾値のみが非常に大きく変動し、メモリ効果（書込時と消去時での閾値の差）を著しく増大させることができる。

#### （実施の形態8）

本実施の形態の半導体記憶装置は、図19に示すように、実施の形態3において、電荷保持膜（シリコン窒化膜142）とチャネル領域又はウェル領域とを隔てる絶縁膜の厚さ（T3）が、ゲート絶縁膜114の厚さ（T4）よりも薄いこと以外は、実質的に同様の構成を有する。

ゲート絶縁膜114は、メモリの書換え動作時における耐圧の要請から、その厚さT4には下限値が存在する。しかし、絶縁膜の厚さT3は、耐圧の要請にかかわらず、T4よりも薄くすることが可能である。T3を薄くすることにより、

電荷保持部 161, 162 への電荷の注入が容易になり、書込み動作及び消去動作の電圧を低下させ、又は書込み動作及び消去動作を高速にすることが可能となり、また、シリコン窒化膜 142 に電荷が蓄積された時にチャネル領域又はウェル領域に誘起される電荷量が増えるため、メモリ効果を増大させることができる。

したがって、 $T3 < T4$  とすることにより、メモリの耐圧性能を低下させることなく、書込み動作及び消去動作の電圧を低下させ、又は書込み動作及び消去動作を高速にし、さらにメモリ効果を増大することが可能となる。

なお、絶縁膜の厚さ  $T3$  は、製造プロセスによる均一性や膜質が一定の水準を維持することが可能であり、かつ保持特性が極端に劣化しない限界となる 0.8 nm 以上であることがより好ましい。

#### (実施の形態 9)

この実施の形態の半導体記憶装置は、図 20 に示すように、実施の形態 3 において、電荷保持膜（シリコン窒化膜 142）とチャネル領域又はウェル領域とを隔てる絶縁膜（シリコン酸化膜 141）の厚さ（ $T3$ ）が、ゲート絶縁膜 114 の厚さ（ $T4$ ）よりも厚いこと以外は、実質的に同様の構成を有する。

ゲート絶縁膜 114 は、素子の短チャネル効果防止の要請から、その厚さ  $T4$  には上限値が存在する。しかし、絶縁膜の厚さ  $T3$  は、短チャネル効果防止の要請にかかわらず、 $T4$  よりも厚くすることが可能である。 $T3$  を厚くすることにより、電荷保持部に蓄積された電荷が散逸するのを防ぎ、メモリの保持特性を改善することが可能となる。

したがって、 $T3 > T4$  とすることにより、メモリの短チャネル効果を悪化させることなく保持特性を改善することが可能となる。

なお、絶縁膜の厚さ  $T3$  は、書換え速度の低下を考慮して、20 nm 以下であることが好ましい。

## 請求の範囲

1. 半導体基板（1, 111, 187）と、

上記半導体基板（1, 111, 187）上に形成されたゲート絶縁膜（12, 114）と、

上記ゲート絶縁膜（12, 114）上に形成された単一のゲート電極（13, 117）と、

上記単一のゲート電極（13, 117）側壁の両側に形成された2つの電荷保持部（61, 62, 161, 162, 162a）と、

上記2つの電荷保持部（61, 62, 161, 162, 162a）のそれぞれに対応する2つの拡散層領域（17, 18, 112, 113）と、

上記単一のゲート電極（13, 117）下に配置されたチャネル領域とを備え、

上記電荷保持部（61, 62, 161, 162, 162a）は、電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁体（15, 142, 142a）からなる膜が、第2の絶縁体（14, 141, 141a）と第3の絶縁体（16, 143）とに挟まれた構造を有し、

上記電荷保持部（61, 62, 161, 162, 162a）は、上記第1の絶縁体（15, 142, 142a）に保持された電荷の多寡により、上記ゲート電極（13, 117）に電圧を印加した際の上記一方の拡散層領域（17, 18, 112, 113）から他方の拡散層領域（17, 18, 112, 113）に流れる電流量を変化させるように構成されてなることを特徴とする半導体記憶装置。

2. 請求項1に記載の半導体記憶装置において、

上記第1の絶縁体（15, 142, 142a）における真空準位と伝導電子帯の最低準位とのエネルギー差を $\chi_1$ とし、

上記第2の絶縁体（14, 141, 141a）における真空準位と伝導電子帯の最低準位とのエネルギー差を $\chi_2$ とし、

上記第3の絶縁体（16, 143）における真空準位と伝導電子帯の最低準位とのエネルギー差を $\chi_3$ とするととき、



$x_1 > x_2$  かつ  $x_1 > x_3$ であることを特徴とする半導体記憶装置。

3. 請求項1に記載の半導体記憶装置において、

上記第1の絶縁体(15, 142, 142a)における真空準位と価電子帯の  
5 最高準位とのエネルギー差を $\phi_1$ とし、

上記第2の絶縁体(14, 141, 141a)における真空準位と価電子帯の  
最高準位とのエネルギー差を $\phi_2$ とし、

上記第3の絶縁体(16, 143)における真空準位と価電子帯の最高準位と  
のエネルギー差を $\phi_3$ とするとき、

10  $\phi_1 < \phi_2$  かつ  $\phi_1 < \phi_3$ であることを特徴とする半導体記憶装置。

4. 請求項1に記載の半導体記憶装置において、

上記第1の絶縁体(15, 142, 142a)における真空準位と伝導電子帯  
の最低準位とのエネルギー差を $x_1$ とし、

15 上記第2の絶縁体(14, 141, 141a)における真空準位と伝導電子帯  
の最低準位とのエネルギー差を $x_2$ とし、

上記第3の絶縁体(16, 143)における真空準位と伝導電子帯の最低準位と  
のエネルギー差を $x_3$ とし、

上記第1の絶縁体(15, 142, 142a)における真空準位と価電子帯の  
20 最高準位とのエネルギー差を $\phi_1$ とし、

上記第2の絶縁体(14, 141, 141a)における真空準位と価電子帯の  
最高準位とのエネルギー差を $\phi_2$ とし、

上記第3の絶縁体(16, 143)における真空準位と価電子帯の最高準位と  
のエネルギー差を $\phi_3$ とするとき、

25  $x_1 > x_2$ 、 $x_1 > x_3$ 、 $\phi_1 < \phi_2$ 、 $\phi_1 < \phi_3$ のいずれをも満たすことを  
特徴とする半導体記憶装置。

5. 請求項1に記載の半導体記憶装置において、

上記第1の絶縁体(15, 142, 142a)とはシリコン窒化物であり、

上記第2及び第3の絶縁膜(14, 16, 141, 141a, 143)とはシリコン酸化物であることを特徴とする半導体記憶装置。

6. 請求項5に記載の半導体記憶装置において、

5 シリコン酸化物である上記第2の絶縁体(14, 141, 141a)は膜状であって、上記半導体基板(1, 111, 187)と上記第1の絶縁体(15, 142, 142a)とを隔てており、

10 上記半導体基板(1, 111, 187)上における上記第2の絶縁体(14, 141, 141a)からなる膜の厚さは、1.5nm以上であって15nm以下であることを特徴とする半導体記憶装置。

7. 請求項5に記載の半導体記憶装置において、

15 シリコン窒化物である上記第1の絶縁体(15, 142, 142a)からなる膜の厚さは、上記半導体基板(1, 111, 187)上において、2nm以上であって15nm以下であることを特徴とする半導体記憶装置。

8. 請求項1に記載の半導体記憶装置において、

20 上記第2の絶縁体(14, 141, 141a)は膜状であって、上記半導体基板(1, 111, 187)及び上記ゲート電極(13, 117)の側壁と、上記第1の絶縁体(15, 142, 142a)とを隔てており、

上記ゲート電極(13, 117)の側壁近傍における上記第2の絶縁体(14, 141, 141a)からなる膜の厚さは、上記半導体基板(1, 111, 187)上における上記第2の絶縁体(14, 141, 141a)からなる膜の厚さよりも厚いことを特徴とする半導体記憶装置。

25

9. 請求項5に記載の半導体記憶装置において、

上記半導体基板(1, 111, 187)上における上記第2の絶縁体(14, 141, 141a)からなる膜の厚さが、上記ゲート絶縁膜(12, 114)の厚さよりも薄く、かつ0.8nm以上であることを特徴とする半導体記憶装置。

10. 請求項5に記載の半導体記憶装置において、

上記半導体基板（1， 111， 187）上における上記第2の絶縁体（14，  
141， 141a）からなる膜の厚さが、上記ゲート絶縁膜（12， 114）の  
5 厚さよりも厚く、かつ20nm以下であることを特徴とする半導体記憶装置。

11. 請求項1に記載の半導体記憶装置において、

上記電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁体（15， 142， 142a）から  
なる膜の少なくとも一部が上記拡散層領域（17， 18， 112， 113）の一  
10 部にオーバーラップするように形成されてなることを特徴とする半導体記憶装置。

12. 請求項1に記載の半導体記憶装置において、

上記電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁体（15， 142， 142a）か  
らなる膜が、ゲート絶縁膜（12， 114）の表面と略平行な表面を有する部分  
15 を含むことを特徴とする半導体記憶装置。

13. 請求項12に記載の半導体記憶装置において、

上記電荷を蓄積する機能を有する第1の絶縁体（15， 142， 142a）か  
らなる膜が、ゲート電極（13， 117）側面と略並行に延びた部分を含むこと  
20 を特徴とする半導体記憶装置。

Fig. 1

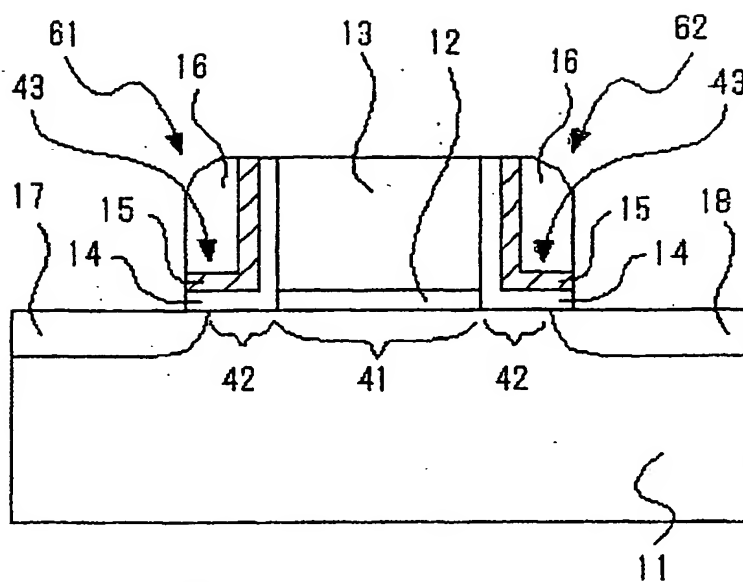
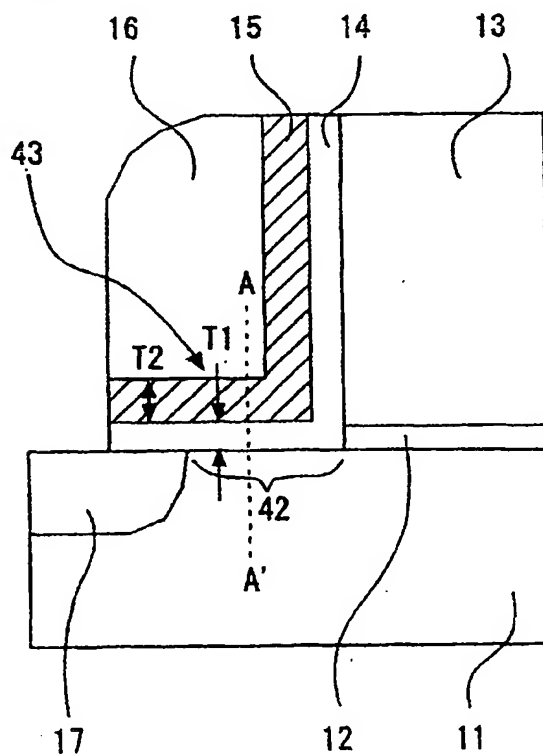
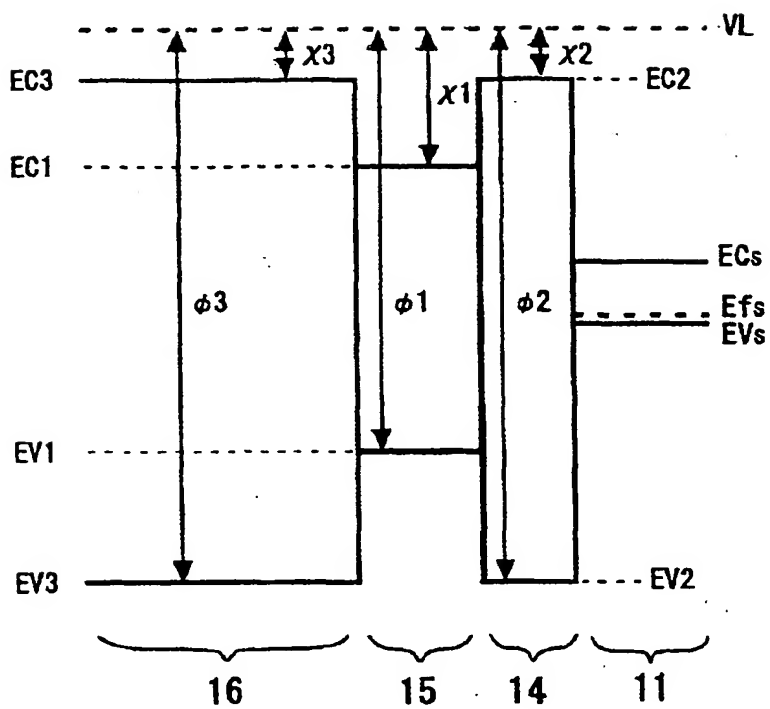
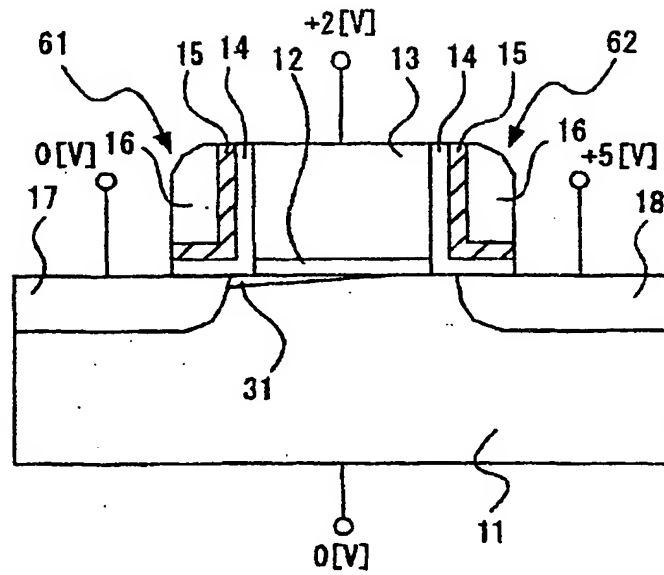
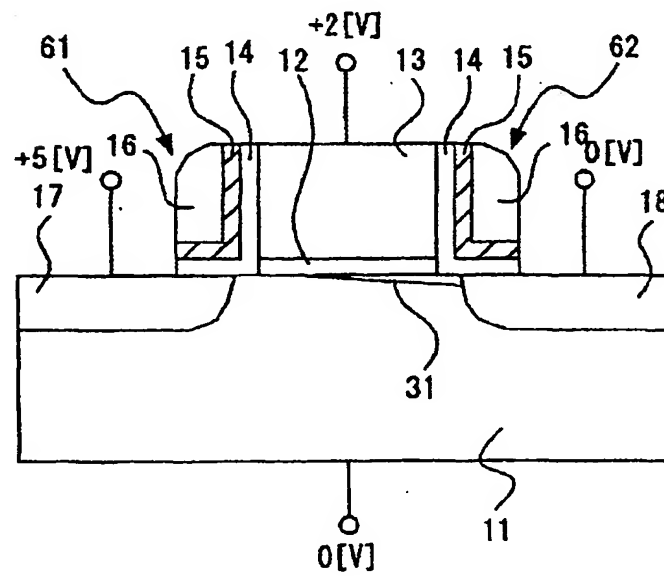


Fig. 2



2 / 1 3

*Fig. 3*

*Fig. 4 A**Fig. 4 B*

4 / 13

Fig. 5

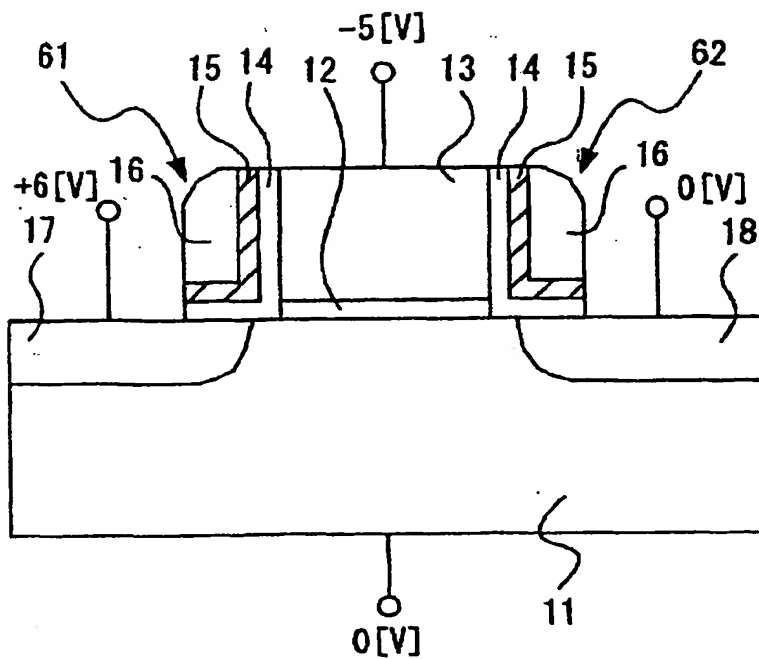


Fig. 6

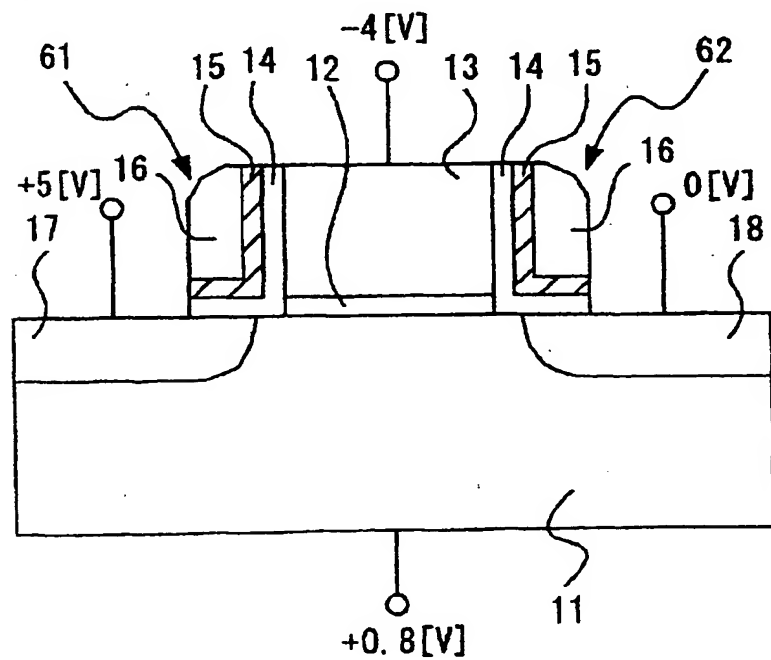


Fig. 7 A

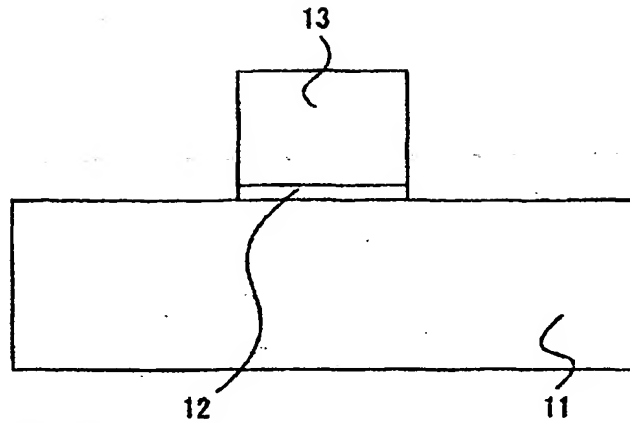


Fig. 7 B

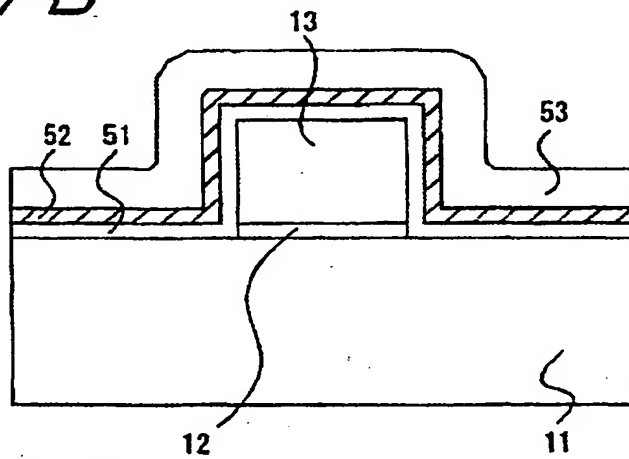
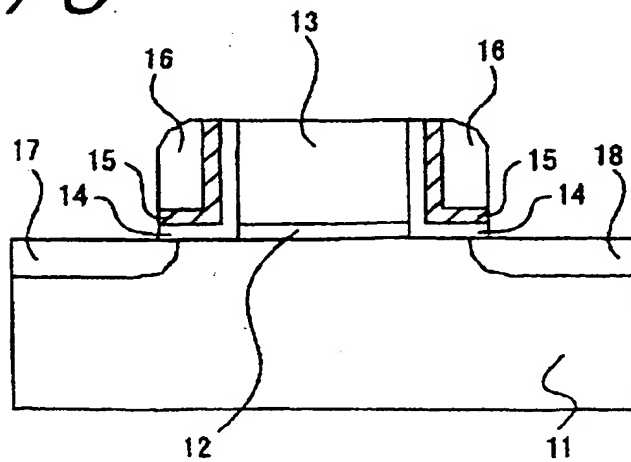
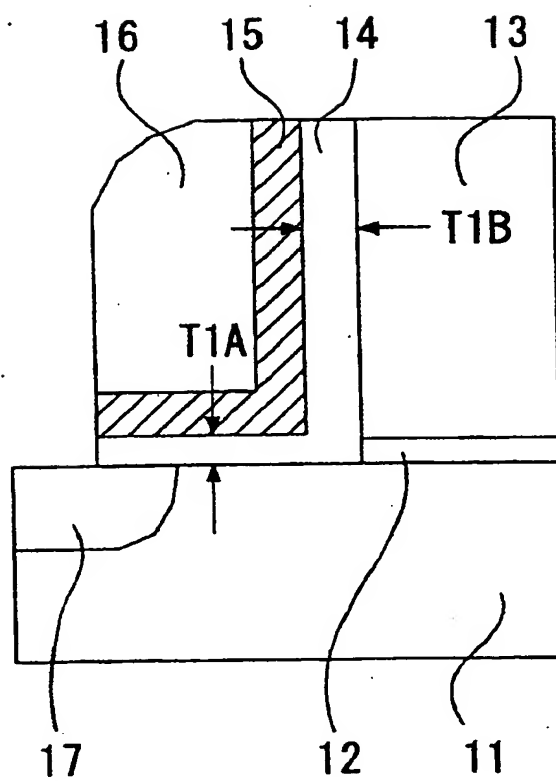


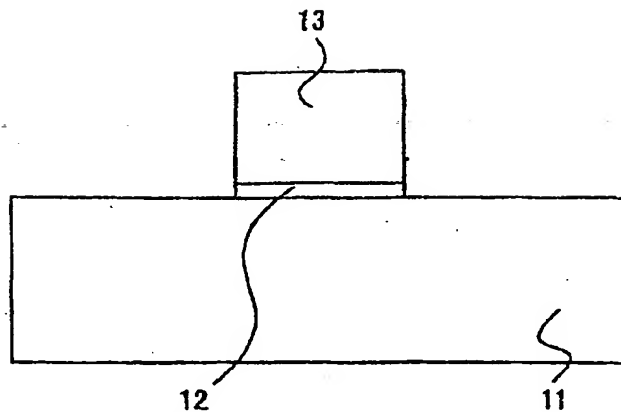
Fig. 7 C



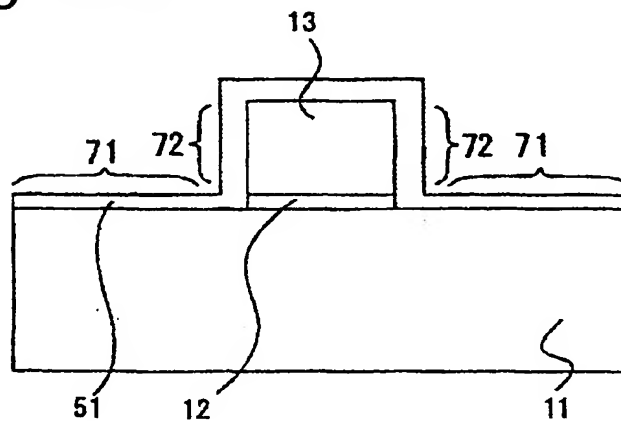


*Fig. 8*

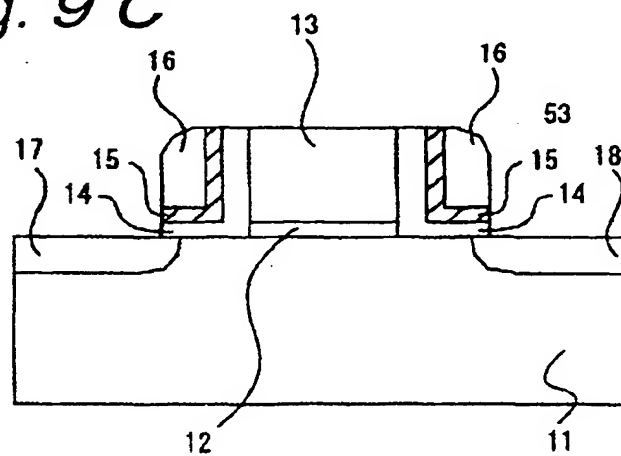
*Fig. 9 A*



*Fig. 9 B*



*Fig. 9 C*



8 / 13

Fig. 1 O

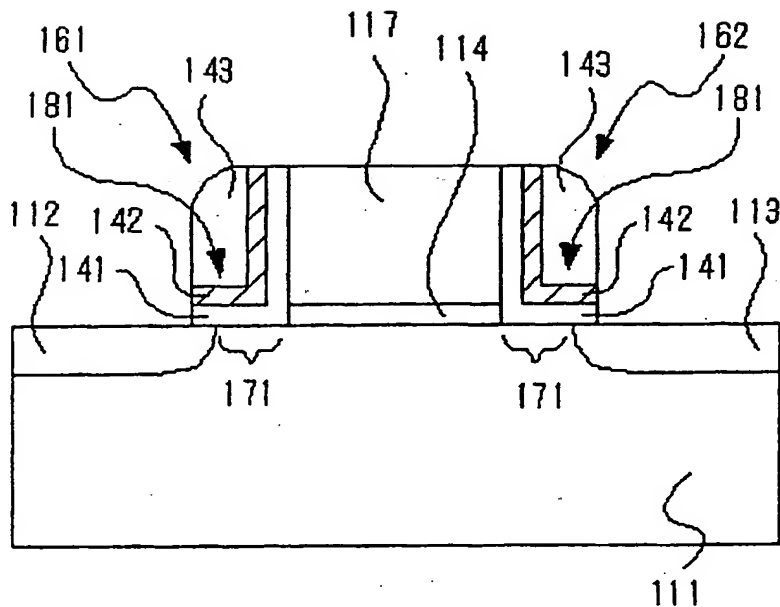


Fig. 1 1

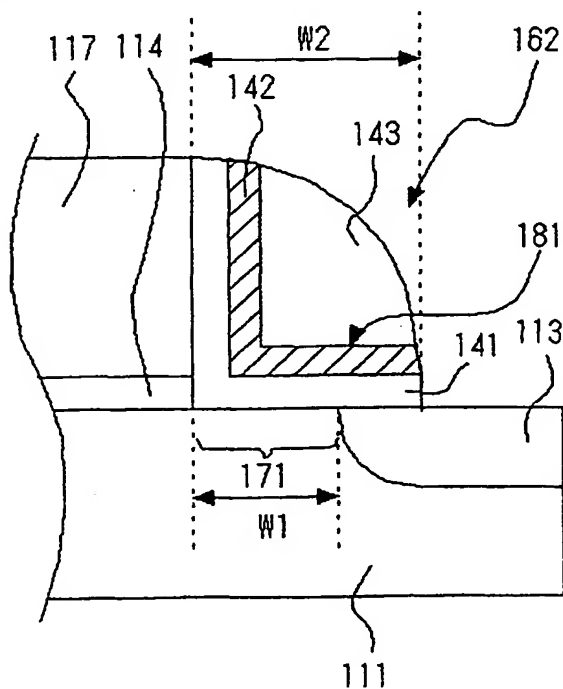


Fig. 1 2

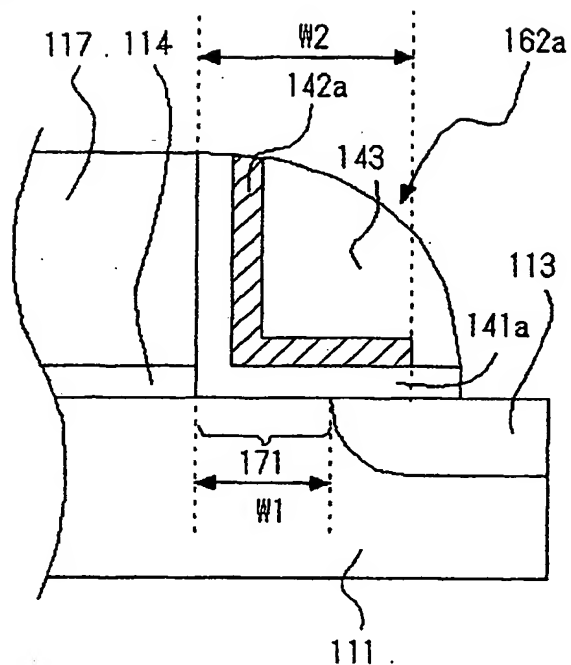
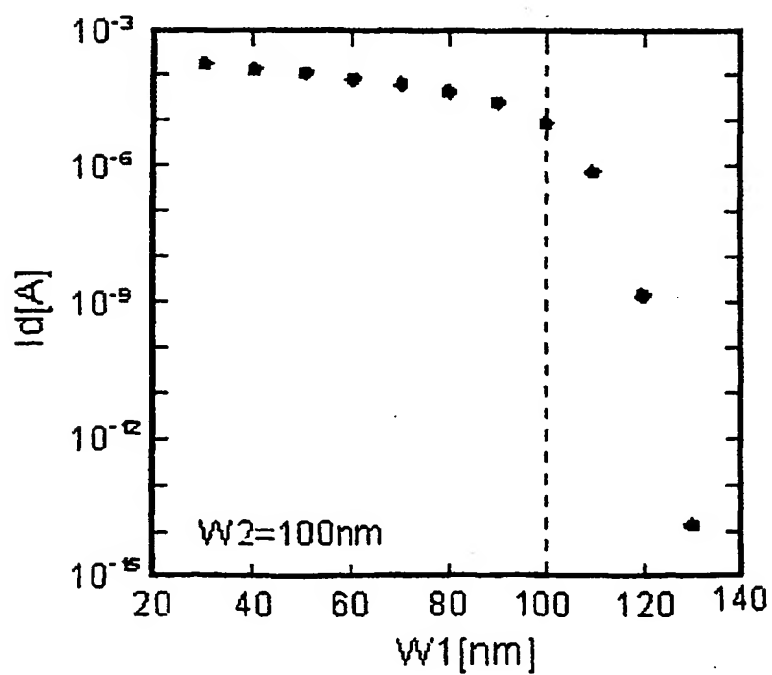
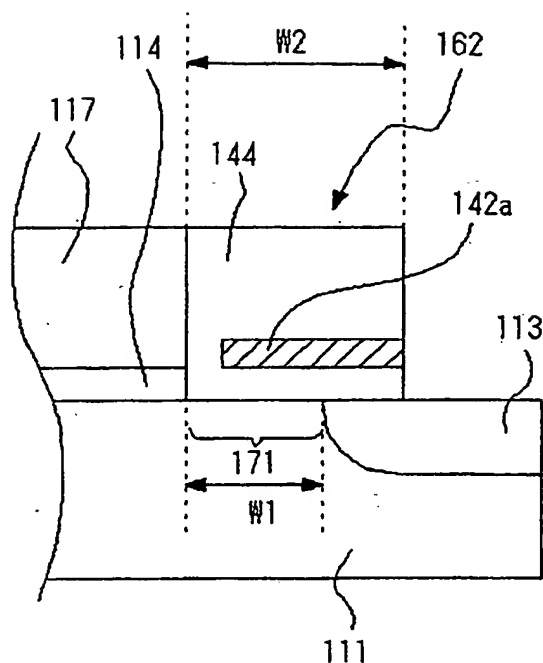


Fig. 1 3

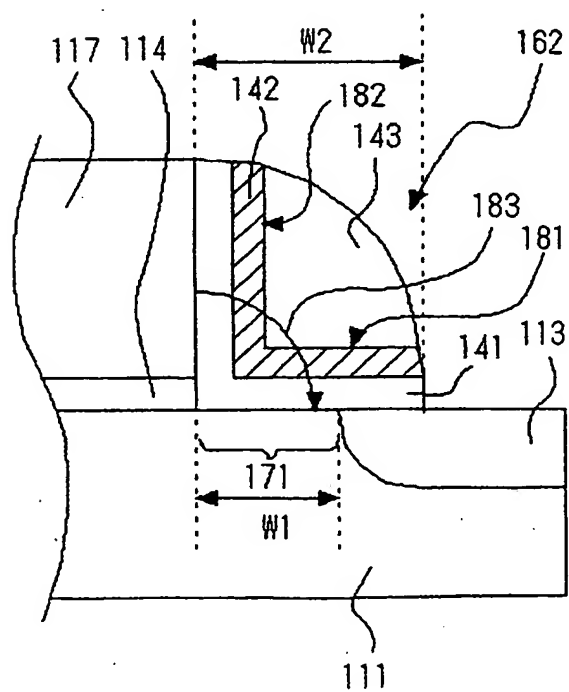


10/13

*Fig. 1 4*



*Fig. 15*

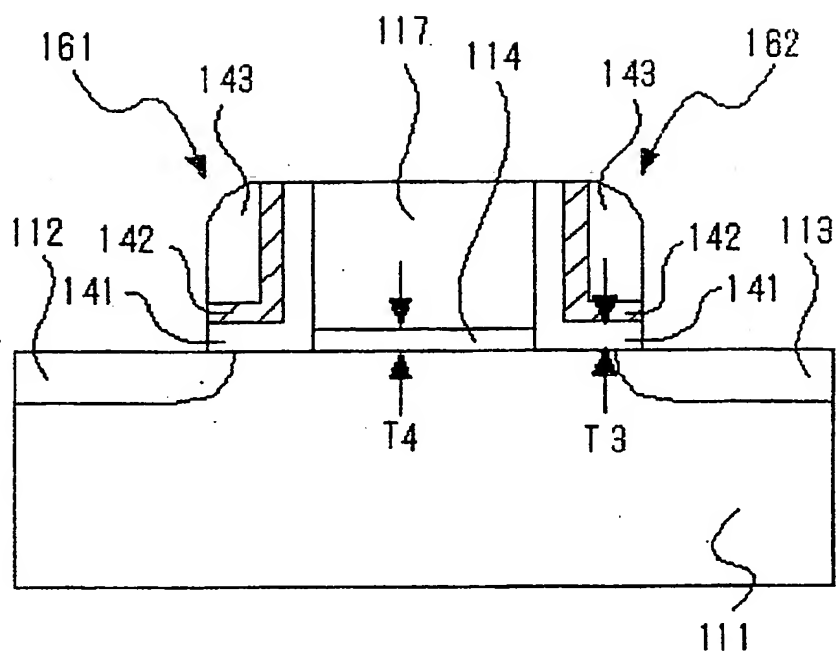




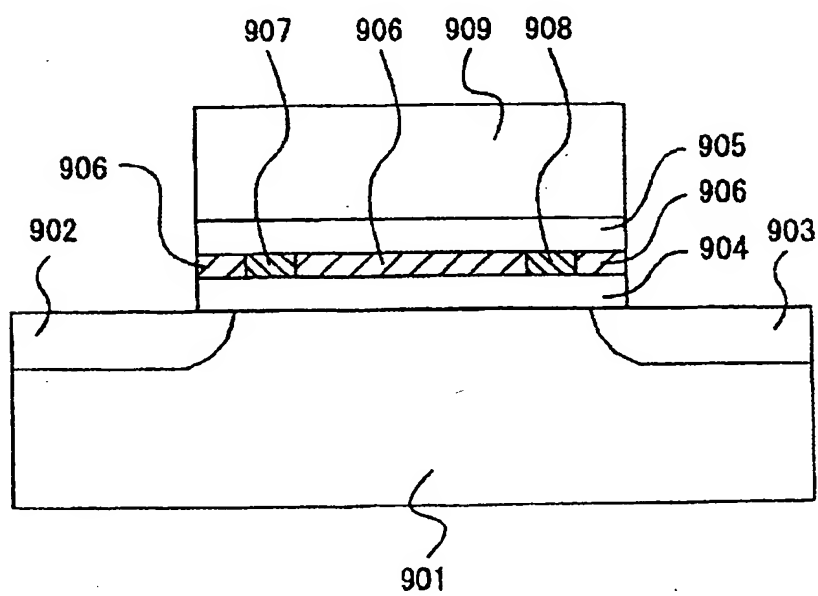


13/13

*Fig. 20*



*Fig. 2 1*





## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/02421

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
Int.Cl<sup>7</sup> H01L29/792

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> H01L21/8247, 29/792

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	US 6335554 B1 (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA), 01 January, 2002 (01.01.02), Columns 6 to 8; Figs. 1 to 3 & JP 2001-156188 A Pages 5 to 7; Figs. 1 to 9	1-9, 11-13 10
X	JP 63-204770 A (Oki Electric Industry Co., Ltd.), 24 August, 1988 (24.08.88), All pages (Family: none).	1-8, 11
X	US 4881108 A (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA), 14 November, 1989 (14.11.89), Full text; Figs. 1 to 6 & JP 63-237580 A Full text; Figs. 1 to 6	1-9, 11-13

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
13 May, 2003 (13.05.03)Date of mailing of the international search report  
27 May, 2003 (27.05.03)Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/02421

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5838041 A (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA), 17 November, 1998 (17.11.98), Full text; Figs. 1 to 17 & JP 9-97849 A Full text; Figs. 1 to 17	1-8, 11-13
Y	US 6329247 B1 (NEC CORP.), 11 December, 2001 (11.12.01), Full text; all drawings & JP 2001-44395 A Full text; all drawings	10
Y	US 6316317 B1 (NEC CORP.), 13 November, 2001 (13.11.01), Full text; all drawings & JP 2000-269361 A Full text; all drawings	10
P,X	JP 2002-164446 A (Sony Corp.), 07 June, 2002 (07.06.02), Pages 13 to 17; Figs. 1 to 7 (Family: none)	1-13

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))  
Int. Cl. H01L29/792

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))  
Int. Cl. H01L21/8247, 29/792

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの  
 日本国実用新案公報 1922-1996年  
 日本国公開実用新案公報 1971-2003年  
 日本国実用新案登録公報 1996-2003年  
 日本国登録実用新案公報 1994-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	US 6335554 B1 (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) 2002. 01. 01, 第6-8欄, 第1-3図 & JP 2001-156188 A, 第5-7頁, 第1-9図	1-9, 11-13 10
Y		
X	JP 63-204770 A (沖電気工業株式会社) 1988. 08. 24, 全頁 (ファミリーなし)	1-8, 11

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

13. 05. 03

国際調査報告の発送日

27.05.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)  
郵便番号 100-8915  
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)  
井原 純



4M 3238

電話番号 03-3581-1101 内線 3462

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	US 4881108 A (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) 1989. 11. 14, 全文, 第1-6図 & JP 63-237580 A, 全文, 第1-6図	1-9, 11-13
X	US 5838041 A (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) 1998. 11. 17, 全文, 第1-17図 & JP 9-97849 A, 全文, 第1-17図	1-8, 11-13
Y	US 6329247 B1 (NEC CORPORATIO N) 2001. 12. 11, 全文, 全図 & JP 2001- 44395 A, 全文, 全図	10
Y	US 6316317 B1 (NEC CORPORATIO N) 2001. 11. 13, 全文, 全図 & JP 2000- 269361 A, 全文, 全図	10
PX	JP 2002-164446 A (ソニー株式会社) 200 2. 06. 07, 第13-17頁, 第1-7図 (ファミリーなし)	1-13

## SEMICONDUCTOR STORAGE DEVICE

## TECHNICAL FIELD

The present invention relates to a semiconductor storage device, in particular, to a semiconductor storage device composed of a field effect transistor having a function to convert the change of an electric charge to the amount of electric current.

## 10 BACKGROUND ART

There is a memory according to a prior art developed by Saifun Semiconductors Ltd. as a non-volatile memory wherein one field effect transistor allows the storage of two bits (Kohyo (Japanese Unexamined Publication) No.2001-512290).

15 This memory is configured of a gate electrode 909 formed above a P type well region 901 via a gate insulating film as well as of first and second N type diffusion layer regions 902 and 903 formed in the surface of P type well region 901. The gate insulating film is a so-called ONO (Oxide Nitride  
20 Oxide) film wherein a silicon nitride film 906 is sandwiched between silicon oxide films 904 and 905. Charge holding portions 907 and 908, respectively, are formed in silicon nitride film 906 in the vicinity of the edge portions first and second N type diffusion layer regions 902 and 903.

25 The quantity of charge in each of these charge

holding portions 907 and 908 can be read out as a drain current of the transistor and, thereby, two bits of data can be stored in one transistor.

In the memory, however, a gate insulating film has a three-layered ONO film structure, which is difficult to form as a thin film, and a problem arises wherein miniaturization of elements is difficult. That is to say, it is difficult to scale down the film thickness of the gate insulating film and, therefore, short channel effects are increased and miniaturization of elements cannot be achieved. In addition, as channel length decreases, it becomes difficult to separate the two charge holding portions 907 and 908 in one transistor and, therefore, further miniaturization of elements cannot be achieved.

#### DISCLOSURE OF THE INVENTION

The present invention is provided in view of the problems and a purpose of the invention is to provide a semiconductor storage device wherein storage of two bits is implemented in one transistor and that can be further miniaturized.

In order to solve the problems, there is provided a semiconductor storage device comprising:

a semiconductor substrate;

a gate insulating film formed on the semiconductor

substrate;

a single gate electrode formed on the gate insulating film;

two charge holding portions formed on the sidewalls  
5 on opposite sides of the single gate electrode;

two diffusion layer regions corresponding to the two charge holding portions, respectively; and

a channel region placed beneath the single gate electrode, wherein

10 the charge holding portions have a structure such that a film made of a first insulator having a function of holding charge is sandwiched between a second insulator and a third insulator, and

the charge holding portions are constituted such  
15 that the amount of current flowing between one of the diffusion layer regions and the other of the diffusion layer regions at the time of application of a voltage to the gate electrode is changed due to the quantity of charge held in the first insulator.

20 According to the semiconductor storage device of the constitution, two charge holding portions, formed on opposite sidewalls of the gate electrode, are independent of the gate insulating film so that the memory function carried out by the charge holding portions and the transistor operation  
25 function carried out by the gate insulating film are separated.

Therefore, it is easy to form the gate insulating film as a thin film so that short channel effects are suppressed while retaining a sufficient memory function. In addition, the two charge holding portions, formed on opposite sides of the gate electrode, are separated by the gate electrode and, therefore, interference at the time of rewriting can be effectively suppressed. In other words, the distance between the two charge holding portions can be reduced. Accordingly, a semiconductor storage device wherein two bit operation is possible and miniaturization is easy can be provided.

Furthermore, the semiconductor storage device has a structure such that the film made of the first insulator having the function of storing a charge is sandwiched between the second and third insulators. Therefore, charge density within the first insulator can be increased and, in addition, the charge density can be made uniform for a short period of time at the time of charge injection. Moreover, the first insulator for storing a charge is separated from conductor parts (gate electrode, diffusion layer regions, semiconductor substrate) by means of other insulating films and, therefore, charge leakage can be restricted so that a sufficient period of time for holding a charge can be obtained. Accordingly, high speed rewriting and increase in reliability become possible, and a sufficient period of time for holding a charge can be secured in the semiconductor storage device.



In one embodiment, expressions  $\chi_1 > \chi_2$  and  $\chi_1 > \chi_3$  are satisfied, where

the  $\chi_1$  represents an energy gap between the vacuum level and the lowest level of a conduction band of the first insulator,

the  $\chi_2$  represents an energy gap between the vacuum level and the lowest level of a conduction band of the second insulator, and

the  $\chi_3$  represents an energy gap between the vacuum level and the lowest level of a conduction band of the third insulator.

The same function and effects of the semiconductor storage device of the present invention can also be obtained according to the semiconductor storage device of the above embodiment.

Furthermore, the electron affinity of the first insulator is greater than the electron affinities of the second and third insulators. Therefore, in the case that the stored charge is of electrons, discharge from the film made of the first insulator for charge storage can be effectively suppressed so that the period of time of storage is increased. Furthermore, the efficiency of charge injection to the first insulator for charge storage is enhanced so that the period of time of rewriting is reduced. Accordingly, the period of time of rewriting of the semiconductor storage device is reduced so that

high speed operation can be realized.

In one embodiment, expressions  $\Phi_1 < \Phi_2$  and  $\Phi_1 < \Phi_3$  are satisfied, where

the  $\Phi_1$  represents an energy gap between the vacuum  
5 level and the highest level of a valence band of the first insulator,

the  $\Phi_2$  represents an energy gap between the vacuum level and the highest level of a valence band of the second insulator, and

10 the  $\Phi_3$  represents an energy gap between the vacuum level and the highest level of a valence band of the third insulator.

The same function and effects of the semiconductor storage device of the present invention can also be obtained  
15 according to the semiconductor storage device of the above embodiment.

Furthermore, the energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band of the first insulator is smaller than the energy gap between the vacuum  
20 level and the highest level of the valence band of the second or third insulator. Therefore, in the case that the stored charge is of positive holes, discharge from the film made of the first insulator for charge storage is effectively suppressed so that the period of time of storage is increased.

25 Furthermore, the efficiency of charge injection to the first

insulator for charge storage is enhanced so that the period of time of rewriting is reduced. Accordingly, the period of time of rewriting of the semiconductor storage device is reduced so that high speed operation can be realized.

5 In one embodiment, all expressions of:  $\chi_1 > \chi_2$ ,  $\chi_1 > \chi_3$ ,  $\phi_1 < \phi_2$  and  $\phi_1 < \phi_3$  are satisfied, where

the  $\chi_1$  represents an energy gap between the vacuum level and the lowest level of the conduction band of the first insulator,

10 the  $\chi_2$  represents an energy gap between the vacuum level and the lowest level of the conduction band of the second insulator,

the  $\chi_3$  represents an energy gap between the vacuum level and the lowest level of the conduction band of the third insulator,

15 the  $\phi_1$  represents an energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band of the first insulator,

the  $\phi_2$  represents an energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band of the second insulator is denoted as  $\phi_2$ , and

the  $\phi_3$  represents an energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band of the third insulator.

25 The same function and effects of the semiconductor

storage device of the present invention can also be obtained according to the semiconductor storage device of the above embodiment.

Furthermore, the electron affinity of the first  
5 insulator is greater than the electron affinity of each of the second and third insulators, and the energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band in the first insulator is smaller than the energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band in the  
10 second or third insulator. Therefore, the electron injection efficiency and the positive hole injection efficiency are both increased and the speeds of both the writing operation and the erasing operation can be increased in the case where, for example, electrons are injected to the first insulator at the  
15 time of writing and where positive holes are injected for recombination with stored electrons at the time of erasure (the same function can be obtained when interchanging holes and electrons).

In one embodiment, the first insulator is of silicon  
20 nitride, and

the second and third insulators are of silicon oxide.

In the semiconductor storage device of the above embodiment, the first to third insulators are concretely  
25 specified in the semiconductor storage device of the present

invention. The first insulator, having the function of charge storage, is a silicon nitride film wherein the hysteresis characteristics are remarkably obtained due to the existence of a great number of levels for trapping charges (electrons and positive holes). In addition, since the second and third insulators are silicon oxide films, the electron affinity of the first insulator is greater than the electron affinity of each of the second and third insulators, and the energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band in the first insulator is smaller than the energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band in each of the second and third insulators. Accordingly, the speeds of both the writing operation and the erasing operation can be increased. Furthermore, both silicon oxide films and silicon nitride films are made of materials used in standard LSI manufacturing processes and, therefore, the manufacturing process of the above embodiment is simple.

In one embodiment, the second insulator that is of silicon oxide is in a film form and separates the semiconductor substrate from the first insulator, and

the film formed of the second insulator on the semiconductor substrate has a thickness of no less than 1.5 nm and of no greater than 15 nm.

According to the semiconductor storage device of the above embodiment, charge injection to the first insulator

can be carried out at a sufficiently high speed while leakage of the charge stored in the first insulator is suppressed. Accordingly, a semiconductor storage device can be provided wherein a high speed rewrite operation and a sufficient period of time of storage are both obtained.

In one embodiment, the film formed of the first insulator, which is of silicon nitride, on the semiconductor substrate has a thickness of no less than 2 nm and of no greater than 15 nm.

Difference in the threshold values (or the level of the read-out current) of the semiconductor storage device of the above embodiment is made sufficiently great and, thereby, dispersion among elements is suppressed and, in addition, change in the threshold value due to charge shift in the silicon nitride film in which data is stored can be suppressed.

In one embodiment, the second insulator is in a film form and separates the semiconductor substrate and the sidewalls of the gate electrode from the first insulator, and the thickness of the film made of the second insulator in the vicinity of the sidewalls of the gate electrode is greater than the thickness of the film made of the second insulator on the semiconductor substrate.

The same function and effects of the semiconductor storage device of the present invention can also be obtained according to the semiconductor storage device of the above

embodiment.

Furthermore, the thickness of the film made of the second insulator in the vicinity of the sidewalls of the gate electrode is greater than the thickness of the film made of the second insulator on the semiconductor substrate and, therefore, electron injection from the gate electrode to the first insulator for charge storage (or release of charge from the first insulator to the gate electrode) can be effectively suppressed. Accordingly, the rewrite characteristics of the semiconductor storage device are stable and the reliability is increased.

In one embodiment, the thickness of the film made of the second insulator on the semiconductor substrate is less than the thickness of the gate insulating film and is not less than 0.8 nm.

According to the semiconductor storage device of the above embodiment, the thickness of the film made of the second insulator on the semiconductor substrate is less than the thickness of the gate insulating film and is no less than 0.8 nm and, thereby, it becomes possible to maintain the uniformity of the films and a constant level of film quality in the manufacturing process and, in addition, it becomes possible to lower the voltage for the writing operation and the erasing operation and to increase the speeds of the writing operation and the erasing operation, while preventing the

storage characteristics from deteriorating to a great extent, without lowering the memory performance or resistance to voltage and it also becomes possible to increase the memory performance.

5           In one embodiment, the thickness of the film made of the second insulator on the semiconductor substrate is greater than the thickness of the gate insulating film and is not greater than 20 nm.

10           According to the semiconductor device of the above embodiment, the thickness of the film made of the second insulator on the semiconductor substrate is greater than the thickness of the gate insulating film and is not greater than 20 nm and, thereby, it becomes possible to improve the storage characteristics without slowing the rewrite speed to a great  
15           extent or without deteriorating the short channel effects of the memory.

          In one embodiment, at least a portion of the film made of the first insulator having a function of charge storage overlaps a portion of the diffusion layer regions.

20           According to the semiconductor device of the above embodiment, at least a portion of the film made of the first insulator having the function of charge storage is formed so as to be overlapped with a portion of the diffusion layer regions and, thereby, the speed of the read-out operation can be  
25           increased.



In one embodiment, the film made of the first insulator having a function of charge storage includes a portion having a surface approximately parallel to the surface of the gate insulating film.

5           According to the semiconductor device of the above embodiment, the film made of the first insulator having the function of charge storage includes a portion having a surface approximately parallel to the surface of the gate insulating film and, therefore, the memory performance due to the quantity  
10 of charge stored in the film made of the first insulator having the function of charge storage can be effectively controlled and, thereby, the memory performance can be enhanced. Furthermore, shift of charge in the upward direction can be suppressed in the film made of the first insulator having the  
15 function of charge storage so that change in characteristics due to charge shift can be prevented from occurring while data is stored.

          In one embodiment, the film made of the first insulator having a function of charge storage includes a portion  
20 that extends approximately parallel to sides of the gate electrode.

          According to the semiconductor device of the above embodiment, the film made of the first insulator having the function of charge storage includes a portion extending  
25 approximately parallel to the sides of the gate electrode and,

therefore, the amount of charge injected to the film made of the first insulator having the function of charge storage increases at the time of the rewrite operation and, thereby, the rewrite speed is increased.

5

#### BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Fig 1 is a schematic cross sectional view showing the main portion of a semiconductor storage device according to one embodiment of the present invention;

10

Fig 2 is an enlarged schematic cross sectional view showing a portion of the semiconductor storage device according to the embodiment of the present invention;

Fig 3 is a diagram showing energy bands along the cross section of line A-A' of Fig 2;

15

Figs 4A and 4B are schematic cross sectional views showing the main portion for describing the writing operations of the semiconductor storage device according to the embodiment of the present invention;

20

Fig 5 is a schematic cross sectional view showing the main portion for describing the first erasure operation of the semiconductor storage device according to the embodiment of the present invention;

25

Fig 6 is a schematic cross sectional view showing the main portion for describing the second erasure operation of the semiconductor storage device according to the embodiment

of the present invention;

Figs 7A, 7B and 7C are schematic cross sectional views showing the main portion, according to manufacturing steps, for describing a manufacturing method for the semiconductor storage device according to the embodiment of the present invention;

Fig 8 is a schematic cross sectional view of the main portion showing a semiconductor storage device according to one embodiment of the present invention;

Figs 9A, 9B and 9C are schematic cross sectional views showing the main portion, according to manufacturing steps, for describing a manufacturing method for the semiconductor storage device according to the embodiment of the present invention;

Fig 10 is a schematic cross sectional view showing the main portion showing a semiconductor storage device according to one embodiment of the present invention;

Fig 11 is an enlarged schematic cross sectional view showing a portion of the semiconductor storage device according to the embodiment of the present invention;

Fig 12 is an enlarged schematic cross sectional view showing a portion of a modification of the semiconductor storage device according to the embodiment of the present invention;

Fig 13 is a graph showing the relationship between the offset amount  $W_1$ , between the gate electrode and the

diffusion layer regions, and drain current  $I_d$  in the semiconductor storage device of the present invention;

Fig 14 is an enlarged schematic cross sectional view showing a portion of another modification of the semiconductor storage device according to the embodiment of the present invention;

Fig 15 is a schematic cross sectional view for describing the effects of the semiconductor storage device according to the embodiment of the present invention;

Fig 16 is a schematic cross sectional view showing the main portion of a semiconductor storage device according to one embodiment of the present invention;

Fig 17 is a schematic cross sectional view showing the main portion of a semiconductor storage device according to one embodiment of the present invention;

Fig 18 is a schematic cross sectional view showing the main portion of a semiconductor storage device according to one embodiment of the present invention;

Fig 19 is a schematic cross sectional view showing the main portion of a semiconductor storage device according to one embodiment of the present invention;

Fig 20 is a schematic cross sectional view showing the main portion of a semiconductor storage device according to one embodiment of the present invention; and

Fig 21 is a cross sectional schematic view showing

the main portion of a semiconductor storage device according to a prior art.

#### BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION

5           A semiconductor storage device of the present invention is mainly formed of a gate insulating film, a gate electrode formed on the gate insulating film, charge holding portions formed on both sides of the gate electrode, source/drain regions (diffusion layer regions), respectively,  
10 placed on the each side of the charge holding portions opposite to the gate electrode and a channel region placed beneath the gate electrode.

          This semiconductor storage device functions as a memory element for storage of data of four, or more, values by  
15 storing data of two, or more, values in one charge holding portion.

          It is preferable for the semiconductor storage device of the present invention to be formed in a semiconductor substrate or, in particular, in a well region of a first  
20 conductive type formed within a semiconductor substrate.

          The semiconductor substrate is not particularly limited as long as it can be utilized for manufacturing a semiconductor device and, for example, various types of substrates, such as substrates made of an element semiconductor,  
25 such as of silicon, germanium, or the like, made of a compound

semiconductor, such as of GaAs, InGaAs, ZnSe, or the like, or an SOI substrate or a multi-layer SOI substrate can be used. In particular, a silicon substrate or an SOI substrate having a silicon layer formed as a surface semiconductor layer are preferable. Preferably, element isolation regions are formed in such a semiconductor substrate and, furthermore, a single, or multi-layer, structure may be formed wherein elements such as transistors, capacitors and resistors, circuits made of these elements, semiconductor devices and interlayer insulating films are combined. Here, the element isolation regions can be formed of various types of element isolation films such as LOCOS films, trench oxide films or STI films. The semiconductor substrate may be of a P conductive type or an N conductive type and it is preferable for at least one well region of a first conductive type (P type or N type) to be formed in the semiconductor substrate. The range of impurity concentration known in the field of the art can be utilized in the semiconductor substrate and in the well region. Here, in the case wherein an SOI substrate is used for the semiconductor substrate, a well region may be formed in the surface semiconductor layer and there may be a body region beneath the channel region.

The gate insulating film is not particularly limited, as long as it is utilized in a conventional manner in the semiconductor device and, for example, insulating films

such as a silicon oxide film or a silicon nitride film, single-layer, or multi-layer, high dielectric films such as an aluminum oxide film, a titanium oxide film, a tantalum oxide film or a hafnium oxide film can be utilized for the gate insulating film. In particular, a silicon oxide film is preferable.

The gate electrode is formed in a conventionally utilized form on the gate insulating film in a semiconductor device. The material of the gate electrode is not particularly limited, unless otherwise specified in the embodiment and a conductive film, such as of polysilicon, metal films, such as of copper or of aluminum, high melt point metal films, such as of tungsten, of titanium or of tantalum, a single-layer film, or a multi-layer film, such as of a high melt point metal or of silicide, can be cited. It is appropriate to form the gate electrode so as to have a film thickness of approximately 50 nm to 400 nm. Here, a channel region is formed beneath the gate electrode and it is preferable for the channel region to be formed beneath the region including the regions outside of the edges of the gate in the gate length direction, in addition to the region beneath the gate electrode. In the case wherein there are portions of the channel region that are not covered by the gate electrode as described above, it is preferable for such a channel region to be covered with a gate insulating film or with charge holding portions as described below.

It is preferable for a charge holding portion to have a sandwich structure wherein a film made of a first insulator for charge storage is placed between a film made of a second insulator and a film made of a third insulator. Since the first insulator for charge storage is in a film form, the charge density within the first insulator can be increased for a short period of time by means of charge injection and the charge density can be made uniform. In the case that the charge distribution within the first insulator for charge storage is not uniform, there is a risk that the stored charge may shift within the insulator, lowering the reliability of the memory element. In addition, the first insulator for charge storage is separated from conductive parts (gate electrode, diffusion layer regions, semiconductor substrate) by another insulating film and, therefore, a sufficient period of time of storage can be obtained by suppressing charge leakage. Accordingly, in the case that the semiconductor storage device has the sandwich structure, high speed rewrite and increase in reliability become possible, and a sufficient period of time of storage can be secured in the semiconductor storage device.

Furthermore, in the case that the storage charge is of electrons, it is preferable for the electron affinity of the first insulator to be greater than each of the electron affinities of the second and third insulators. Here, the electron affinity means the energy gap between the vacuum level



and the lowest level of the conduction band. Alternately, in the case that the stored charge is of positive holes, it is preferable for the energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band of the first insulator to be smaller than the energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band of each of the second and third insulators. Discharge from the film made of the first insulator for charge storage can be effectively suppressed and the period of time of storage can be increased in the case that the conditions are satisfied. Furthermore, the charge injection efficiency to the first insulator for charge storage is increased and the period of time for rewriting is reduced. In order to satisfy the conditions for charge holding portions, it is particularly preferable for the first insulator to be a silicon nitride film and for the second and third insulators to be silicon oxide films. A great number of levels for trapping charges exist in a silicon nitride film and, therefore, the hysteresis characteristics are pronounced. In addition, silicon oxide films and silicon nitride films are both used in standard LSI manufacturing processes and, therefore, usage thereof is preferable. In addition, hafnium oxide, tantalum oxide, yttrium oxide, and the like, in addition to silicon nitride, can be used as the first insulator. Furthermore, aluminum oxide, or the like, in addition to silicon oxide, can be used as the second and third insulators. Here, the second

and third insulators may be of different materials or may be of the same material.

Charge holding portions are formed on each side of the gate electrode and are placed above the semiconductor substrate (well region, body region, source/drain regions or diffusion layer regions).

The source/drain regions, respectively, are placed on the side of the charge holding portions opposite to the gate electrode as diffusion layer regions of the conductive type opposite to that of the semiconductor substrate or the well region. It is preferable for the junctions between the source/drain regions and the semiconductor substrate, or the well region, to have a sharp shift in impurity concentration. This is because hot electrons or hot positive holes are efficiently generated at a low voltage, allowing high speed operation at a low voltage. The depth of the junctions of the source/drain regions are not particularly limited but, rather, can be appropriately adjusted in accordance with the performance, and the like, of the semiconductor storage device to be obtained. Here, in the case that an SOI substrate is used as the semiconductor substrate, the depth of the junctions of the source/drain regions may be less than the film thickness of the surface semiconductor layer and is preferably approximately the same as the film thickness of the surface semiconductor layer.

The source/drain regions may be placed so as to overlap the edges of the gate electrode or may be placed so as to be offset relative to the edges of the gate electrode. In particular, in the case of being offset, the ease of inversion of the offset regions beneath the charge holding portions at the time of application of a voltage to the gate electrode varies greatly due to the amount of charge stored in the charge holding portions and, thereby, the memory effects are increased and the short channel effects are reduced, which is preferable. Here, in the case that the amount of offset is too great, a drive current between the source and drain is significantly reduced. Accordingly, the amount of offset should be determined so that the memory effects and the drive current both have appropriate values.

Portions of the source/drain regions may extend to the surface of the channel region, that is to say, to positions higher than the lower surface of the gate insulating film. In this case, a conductive film is integrally layered on the source/drain regions formed within the semiconductor substrate in an appropriate configuration. As for the material of the conductive film, semiconductors such as polysilicon or amorphous silicon, a silicide, metals or high melt point metals as described above can be cited. In particular, polysilicon is preferable. This is because the impurity diffusion rate in polysilicon is much greater than that of a semiconductor

substrate and, therefore, it is easy to make the depth of the junctions of the source/drain regions shallow within the semiconductor substrate so that the short channel effects can easily be suppressed. Here, in this case, it is preferable to place these portions of the source/drain regions so that at least some portions of the charge storage film are sandwiched between these portions of the source/drain regions and the gate electrode.

The semiconductor storage device of the present invention has four terminals: a single gate electrode formed on the gate insulating film, the source region, the drain region and the semiconductor substrate, and carries out write-in, erasure and read-out operations, respectively, by providing predetermined potentials to the four terminals, respectively. Concrete principles of operation and examples of operational voltages are described below. In the case that a memory cell array is formed by placing the semiconductor storage devices of the present invention in an array form, a plurality of memory cells can be controlled by a single control gate so that the number of word lines can be reduced.

The semiconductor storage device of the present invention can be formed according to a conventional semiconductor manufacturing process, for example, according to the same method as the method for forming sidewall spacers of a layered structure on the sidewalls of a gate electrode.

Concretely, a method can be cited wherein film layers made up of an insulating film (second insulator)/charge storage film (first insulator)/insulating film (second insulator) after the formation of a gate electrode and, then, etch back is carried out under appropriate conditions so that these films remain in the form of sidewall spacers.

In the case that a memory cell array is formed through arrangement of the semiconductor storage devices of the present invention, the semiconductor storage device according to the best mode of the invention satisfies all of the following requirements: (1) gate electrodes of a plurality of semiconductor storage devices are integrated to have the function of a word line, (2) charge holding portions are formed on each side of the word line, (3) an insulator, in particular a silicon nitride film, holds a charge within a charge holding portion, (4) charge holding portions are formed of an ONO (Oxide Nitride Oxide) film wherein the silicon nitride film has a surface approximately parallel to the surface of the gate insulating film, (5) the silicon nitride film in a charge holding portion is separated from the word line and the channel region by the silicon oxide film, (6) the silicon nitride film within a charge holding portion and a diffusion region overlap each other, (7) the thickness of the insulating film that separates the silicon nitride film, having a surface approximately parallel to the surface of the gate insulating

film, from the channel region, or from the semiconductor layer, differs from the thickness of the gate insulating film, (8) the write-in and erasure operations for one semiconductor storage device are carried out using a single word line, (9) the  
5 electrode (word line), which has a function of assisting the write-in and erasure operations, does not exist above charge holding portions and (10) the semiconductor storage device has regions with a high concentration of an impurity of the conductive type opposite to that of the diffusion regions in  
10 the portions contacting the diffusion regions directly beneath the charge holding portions. Here, a semiconductor storage device that satisfies any one of these requirements is considered to be an embodiment of the present invention.

A particularly preferable combination of the  
15 requirements is, for example, a case wherein (3) an insulator, in particular a silicon nitride film, holds a charge within a charge holding portion, (6) the insulating film (silicon nitride film) within a charge holding portion and a diffusion region overlap each other and (9) the electrode (word line),  
20 which has a function of assisting the write-in and erasure operations, does not exist above charge holding portions.

In the case that requirements (3) and (9) are satisfied, a very advantageous semiconductor storage device is obtained as follows.

25 First, bit line contacts can be placed close to a

charge holding portion on the word line sidewall and charge holding portions, making up a plurality, are prevented from interfering with each other so that data storage can be maintained even in the case that the distance between the semiconductor storage devices is reduced. Accordingly, miniaturization of the semiconductor storage device becomes easy. Here, in the case that charge storage regions within charge holding portions are conductors, interference between charge storage regions occur due to capacitance coupling as the semiconductor storage devices become closer to each other so that storage of data cannot be maintained.

In addition, in the case that the charge storage regions within charge holding portions are insulators (for example, silicon nitride film), it becomes unnecessary to make independent charge holding portions for each memory cell. For example, charge holding portions, formed on each side of one word line shared by a plurality of memory cells, need not be separated according to each memory cell and it becomes possible to share charge holding portions formed on each side of one word line by a plurality of memory cells that share the word line. Therefore, a photographic and etching process for separating the charge holding portions becomes unnecessary and the manufacturing process is simplified. Furthermore, a margin for positioning in the photolithographic process and an over etching margin for films become unnecessary so that the margin

between memory cells can be reduced. Accordingly, the area occupied by the memory cells can be miniaturized even when the memory cells are formed according to the same level of microscopic processing in comparison with the case wherein the charge charge holding portions within charge holding portions are conductors (for example, polycrystal silicon film). Here, in the case that the charge holding portions within charge holding portions are conductors, a photographic and etching process for separating the charge holding portions every memory cells becomes necessary and a margin for positioning the photomask and an over etching margin for films become necessary.

Furthermore, no electrodes having the function of assisting the write-in and erasure operations exist on top of the charge holding portions and, therefore, the structure of the element is simple so that the number of manufacturing steps can be reduced and the yield can be increased. Accordingly, the semiconductor storage devices can easily be formed together with the transistors for forming logic circuits and analog circuits and, at the same time, the cost of the semiconductor storage device can be reduced.

In addition, in the case wherein requirement (6) is satisfied, in addition to requirements (3) and (9), a more advantageous semiconductor storage device can be obtained.

That is to say, charge storage regions within charge holding portions and diffusion regions overlap each other and,



thereby, write-in and erasure at a very low voltage become possible. Concretely, the write-in and erasure operations can be carried out at the low voltage of no greater than 5 V. It is very advantageous to use this property in circuit design.

5 Since it becomes unnecessary to utilize a high voltage within a chip, unlike in the case of a flash memory, it becomes possible to omit or to scale down the charge pumping circuit, which occupies a large area. In particular, in the case that a memory having a small-scale capacity is built into a logic LSI for  
10 adjustment, the area occupied by the memory part is dominated by the periphery circuits for driving the memory cells rather than by the memory cells and, therefore, the omission or scaling down of a booster circuit for memory cells is most effective in order to reduce chip size.

15 On the other hand, in the case wherein requirement (3) is not satisfied, that is to say, in the case wherein a conductor stores a charge within a charge holding portion, the write-in operation can be carried out even when requirement (6) is not satisfied, that is to say, when the conductor within a  
20 charge holding portion and the diffusion region do not overlap. This is because the conductor within the charge holding portion assists write-in due to capacitance coupling vis-à-vis the gate electrode.

In addition, in the case wherein requirement (9)  
25 is not satisfied, that is to say, in the case wherein an electrode

having the function of assisting the write-in and erasure operations exists on top of a charge holding portion, the write-in operation can be carried out even when requirement (6) is not satisfied, that is to say, when the insulator within a charge holding portion and the diffusion region do not overlap.

In semiconductor storage device of the present invention transistors may be connected in series to one side or to both sides of the semiconductor storage device and the semiconductor storage device may be formed on the same chip as are logic transistors. In such a case, the semiconductor device, in particular, the semiconductor storage device, of the present invention, can be formed according to a process having a very high similarity to the manufacturing process for conventional transistors, including standard transistors and logic transistors and, therefore, they can be manufactured at the same time. Accordingly, a process for manufacturing a semiconductor storage device and logic transistors and other types of transistors on the same chip is greatly simplified so that an a device that includes a storage device as well as other semiconductor devices can be obtained at a low cost.

In the semiconductor storage device of the present invention one charge holding portion can store data of two, or more, values and, thereby, the semiconductor storage device can function as a memory cell that stores data of four, or more, values. Here, the semiconductor storage device may be used for

the storage of data of two values. In addition, the semiconductor storage device can function as a memory cell having the functions of both a selection transistor as well as a memory transistor by using the variable resistance effect created by charge holding portions.

The semiconductor storage device of the present invention can be used in a battery operated portable electronic device, in particular a portable data terminal. As for portable electronic devices, a portable data terminal, a cellular phone, a game device, and the like, can be cited.

In the following, the semiconductor storage device of the present invention is described in detail in reference to the drawings.

(Embodiment 1)

In a memory element forming a semiconductor storage device of the present embodiment as shown in Fig 1, a gate electrode 13 having a gate length of approximately the same length as a conventional transistor, for example from approximately 0.015  $\mu\text{m}$  to 0.5  $\mu\text{m}$ , is formed above a semiconductor substrate 11 via a gate insulating film 12 and charge holding portions 61 and 62 in the form of sidewall spacers are formed on the gate insulating film 12 and on the sidewalls of gate electrode 13 so as to form a non-volatile memory cell that allows the storage of two bits. In addition, first and second diffusion layer regions 17 and 18 (source/drain regions)

are formed on the side of charge holding portions 61 and 62 opposite to gate electrode 13 wherein these charge holding portions 17 and 18 are offset relative to the edges of gate electrode 13 (offset from region 41 on which gate electrode 13 is formed).

As described above, charge holding portions 61 and 62 of the memory transistor are formed independently of gate insulating film 12. Accordingly, the memory function carried out by charge holding portions 61 and 62 is separated from the transistor operation function carried out by gate insulating film 12. In addition, two charge holding portions 61 and 62, formed on opposite sides of gate electrode 13, are separated from each other by gate electrode 13 and, thereby, interference at the time of rewriting can be effectively restricted. Accordingly, this memory transistor allows storage of two bits and miniaturization thereof is easy.

In addition, source/drain regions 17 and 18 are offset from gate electrode 13 and, thereby, the ease of inversion in offset regions 42 beneath charge holding portions 61 at the time of the application of a voltage to gate electrode 13 can be greatly altered according to the amounts of the charges stored in charge holding portions 61 and 62 so that it becomes possible to increase the memory effects. Furthermore, the short channel effects can be largely prevented in comparison with a conventional logic transistor so that further reduction

in the gate length can be achieved. In addition, the structure of this memory transistor is appropriate for suppression of short channel effects and a gate insulating film having a great thickness in comparison with that of a logic transistor can be adopted wherein it becomes possible to increase reliability.

Charge holding portions 61 and 62 in the form of sidewall spacers have a structure wherein a silicon nitride film 15, as an example of a film made of a first insulator, is sandwiched between a silicon oxide film 14, as an example of a film made of a second insulator, and a silicon oxide film 16, as an example of a film made of a third insulator. Silicon nitride film 15 has a function of trapping and storing a charge (electrons or positive holes). Charges are primarily stored in portions (regions 43) in silicon nitride film 15 above offset regions 42. As described above, charge holding portions 61 and 62 have a structure wherein silicon nitride film 15 is sandwiched between silicon oxide films 14 and 16 and, therefore, the charge injection efficiency to charge holding portions 61 and 62 is increased so as to achieve a high-speed rewrite operation (write-in and erasure operations).

It is preferable for at least some portions of silicon nitride film 15 to be formed so as to overlap portions of first and second diffusion layer regions 17 and 18.

In addition, it is preferable for silicon nitride film 15 to include a portion having a surface approximately

parallel to the surface of gate insulating film 12.

In addition, it is preferable for silicon nitride film 15 to include a portion that extends approximately parallel to the sides of gate electrode 12.

5                    Fig 2 is an enlarged view of a portion of the memory element shown in Fig 1 in the vicinity of one of the edges of the gate. Since regions 43 primarily store charges, thickness T1 of silicon oxide film 14 and thickness T2 of silicon nitride film 15 above offset region 42 have a great effect on the memory  
10 characteristics.

It is preferable to set thickness T1 of silicon oxide film 14 above offset region 42 as follows. In the case that thickness T1 of silicon oxide film 14 is 1.5 nm, or less, the charge stored in region 43 easily escapes through silicon  
15 oxide film 14 and, therefore, the period of time of storage is significantly shortened. On the other hand, in the case that thickness T1 is 15 nm, or greater, the charge injection efficiency to region 43 is lessened and the period of time of write-in increases to an extent that cannot be ignored.  
20 Accordingly, it is preferable for thickness T1 of silicon oxide film 14 to be in the range of from 1.5 nm to 15 nm in order to provide both a sufficient period of time of storage as well as high-speed rewrite. It is more preferable for T1 to be in the range of from 5 nm to 12 nm.

25                    It is preferable to set thickness T2 of silicon

nitride film 15 above offset region 42 as follows. In the case that thickness  $T_2$  of silicon nitride film 15 is 2 nm, or less, the charge trap density included in silicon nitride film 15 becomes insufficient and, therefore, the change in the threshold value (or change in the read-out current) of the memory element becomes insufficient. Furthermore, dispersion among elements resulting from dispersion in the film thickness of silicon nitride film 15 becomes too great to be ignored. On the other hand, in the case that thickness  $T_2$  of silicon nitride film is 15 nm, or greater, it becomes difficult to uniformly inject charges into the silicon nitride film at the time of rewriting, or a long period of time becomes necessary. In addition, in the case that charges are not uniformly injected into the silicon nitride film 15, charges shift in the silicon nitride film 15 while data is being stored so that the change in the threshold value (or read-out current) becomes problematic. Accordingly, it is preferable for thickness  $T_2$  of silicon nitride film 15 to be in the range of from 2 nm to 15 nm in order to provide a sufficient reliability to the memory element. It is more preferable for  $T_2$  to be in the range of from 3 nm to 7 nm.

Fig 3 shows an energy diagram (energy band diagram) of electrons in the cross section along line A-A' of Fig 2. Here, the bands are all posited as being flat (vacuum level VL is constant regardless of position) for the purpose of simplicity.

In Fig 3, the lowest level of the conductive band of the semiconductor (semiconductor substrate 11) is denoted as ECs, the highest level of the valence band of the semiconductor is denoted as EVs, the Fermi level of the semiconductor is denoted as Efs, the lowest level of the conductive band of the first insulator (silicon nitride film 15) is denoted as EC1, the highest level of the valence band of the first insulator is denoted as EV1, the lowest level of the conductive band of the second insulator (silicon oxide film 14) is denoted as EC2, the highest level of the valence band of the second insulator is denoted as EV2, the lowest level of the conductive band of the third insulator (silicon oxide film 16) is denoted as EC3 and the highest level of the valence band of the third insulator is denoted as EV3. Accordingly, the energy gap (electron affinity force) between the vacuum level and the lowest level of the conductive band of the first insulator is denoted as  $\chi_1$ , the energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band of the first insulator is denoted as  $\phi_1$ , the energy gap (electron affinity force) between the vacuum level and the lowest level of the conductive band of the second insulator is denoted as  $\chi_2$ , the energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band of the second insulator is denoted as  $\phi_2$ , the energy gap (electron affinity force) between the vacuum level and the lowest level of the conductive band of the third insulator is denoted as  $\chi_3$  and the



energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band of the third insulator is denoted as  $\Phi_3$ .

In the case wherein electrons are stored in the first insulator for charge storage,  $\chi_1 > \chi_2$  and  $\chi_1 > \chi_3$  is preferable. In this case, the third insulator (silicon oxide film 16) becomes a barrier increasing the electron injection efficiency at the time of injection of electrons into the first insulator (silicon nitride film 15). In addition, electrons stored in the first insulator can be efficiently prevented from leaking to semiconductor substrate 11. Accordingly, a high-speed write-in operation and good storage characteristics can be obtained.

In the case wherein positive holes are stored in the first insulator for charge storage,  $\Phi_1 < \Phi_2$  and  $\Phi_1 < \Phi_3$  is preferable. In this case, the third insulator (silicon oxide film 16) becomes a barrier increasing the positive hole injection efficiency at the time of injection of positive holes into the first insulator (silicon nitride film 15). In addition, positive holes stored in the first insulator can be efficiently prevented from leaking to semiconductor substrate 11. Accordingly, a high-speed write-in operation and good storage characteristics can be obtained.

Here, it is more preferable for all the four conditions ( $\chi_1 > \chi_2$ ,  $\chi_1 > \chi_3$ ,  $\Phi_1 < \Phi_2$  and  $\Phi_1 < \Phi_3$ ) to be satisfied. In the case wherein electrons are stored in the first insulator

for charge storage, for example, the positive hole injection efficiency becomes high when positive holes are injected in order to remove the stored electrons so that the erasure operation can be carried out at high speed.

5                    Though in the present embodiment the first insulator is a silicon nitride film and the second and third insulators are silicon oxide films, the invention is not limited to this. For example, the first insulator can be made of a high dielectric material such as of hafnium oxide, tantalum oxide,  
10                   yttrium oxide, zirconium oxide, or the like. Furthermore, the second and third insulators can be made of aluminum oxide.

                  The principle of the write-in operation of this memory is described in reference to Figs 4A and 4B.

                  Here, write-in indicates injection of electrons  
15                   into charge holding portion 61 or 62.

                  In order to inject electrons (write-in) into second charge holding portion 62, as shown in Fig 4A, first diffusion layer region 17 is used as the source electrode and the second diffusion layer region 18 is used as the drain electrode. For  
20                   example, 0V is applied to first diffusion layer region 17 and to semiconductor substrate 11, +5V is applied to second diffusion layer region 18 and +2V is applied to gate electrode 13. Under such voltage conditions, inversion layer 31 extends from first diffusion layer region 17 (source electrode) and does  
25                   not reach to second diffusion layer region 18 (drain electrode)

so that a pinch off point occurs. Electrons are accelerated from the pinch off point to second diffusion layer region 18 (drain electrode) by means of a high electrical field so as to become so-called hot electrons (conductive electrons of a high energy). These hot electrons are injected into second charge holding portion 62 (more precisely silicon nitride film 15) and, thereby, write-in is carried out. Here, hot electrons are not generated in the vicinity of first charge holding portion 61 and, therefore, write-in is not therein carried out.

As described above, write-in can be carried out by injecting electrons into second charge holding portion 62.

On the other hand, in order to inject electrons (write-in) into first charge holding portion 61, as shown in Fig 4B, second diffusion layer region 18 is used as the source electrode and first diffusion layer region 17 is used as the drain electrode. For example, 0V is applied to second diffusion layer region 18 and to semiconductor substrate 11, +5V is applied to first diffusion layer region 17 and +2V is applied to gate electrode 13. The source/drain regions are switched vis-à-vis the case wherein electrons are injected into second charge holding portion 62 in the manner and, thereby, electrons are injected into first charge holding portion 61 so that write-in can be carried out.

Next, the principle of the read-out operation of the memory element is described.

In the case that data stored in first charge holding portion 61 is read-out, first diffusion layer region 17 is used as the source electrode and the second diffusion layer region 18 is used as the drain electrode so that the transistor is operated in the saturation region. For example, 0V is applied to first diffusion layer region 17 and to semiconductor substrate 11, +2V is applied to second diffusion layer region 18 and +1V is applied to gate electrode 13. At this time, the drain current easily flows in the case that electrons are not stored in first charge holding portion 61. On the other hand, the drain current does not easily flow because the inversion layer is not easily formed in the vicinity of first charge holding portion 61 in the case wherein electrons are stored in first charge holding portion 61. Accordingly, the data stored in first charge holding portion 61 can be read out by detecting the drain current. At this time, the existence of a charge stored in second charge holding portion 62 does not affect the drain current because the inversion layer is pinched off in the vicinity of the drain.

In the case wherein data stored in second charge holding portion 62 is read out, second diffusion layer region 18 is used as the source electrode and first diffusion layer region 17 is used as the drain electrode so that the transistor operates in the saturation region. For example, 0V is applied to second diffusion layer region 18 and to semiconductor

substrate 11, +2V is applied to first diffusion layer region 17 and +1V is applied to gate electrode 13. The source/drain regions are switched vis-à-vis the case wherein data stored in first charge holding portion 61 is read out in the manner and, thereby, the data stored in second charge holding portion 62 can be read out.

As is clear from the above description, when focusing on a charge holding portion on one side, the source and drain are switched from the cases wherein write-in is carried out and wherein a read-out operation is carried out. In other words, the relationship between the magnitudes of the voltages applied to the first diffusion layer region and to the second diffusion layer region at the time of the read-out operation is reversed vis-à-vis at the time of the write-in operation. Therefore, the data stored in the two charge holding portions, respectively, can be detected in a highly precise manner.

Here, in the case wherein portions of the channel region (offset regions 42) are left uncovered by gate electrode 13, the inversion layer disappears or is formed according to the presence or absence of excess electrons in charge holding portions 61 and 62 resulting in a pronounced hysteresis (great change in the threshold value) in the portions of the channel region not covered by gate electrode 13. Here, in the case that the width of offset regions 42 is too great, the drain current

is greatly decreased so that the speed of read-out is greatly slowed. Accordingly, it is preferable to determine the width of offset regions 42 in order to obtain a sufficient hysteresis and a high read-out speed.

5                    In the case that first and second diffusion layer regions 17 and 18 reach to the edges of gate electrode 13, that is to say, in the case wherein first and second diffusion layer regions 17 and 18 and gate electrode 13 overlap each other, the parasitic resistances at the source/drain edges greatly differ  
10                   from the above case and the drain current is greatly reduced (by one order, or greater) in comparison with the above case although the threshold value of the transistor at the time of the write-in operation does not greatly differ from the above case. Accordingly, read-out is possible through detection of  
15                   the drain current so that the memory function can be obtained. Here, in the case when a greater memory hysteresis effect is required, it is preferable for gate electrode 13 not to overlap first and second diffusion layer regions 17 and 18 (offset regions 42 exist).

20                   Furthermore, the principle of the erasure operation of the above semiconductor storage device is described in reference to Fig 5.

                    First, in the case that data stored in first charge holding portion 61 is erased according to the first method, a  
25                   positive voltage (for example, +6V) is applied to first

diffusion layer region 17 and 0V is applied to semiconductor substrate 11 so that a reverse bias is applied to the PN junction between first diffusion layer region 17 and, in addition, semiconductor substrate 11 and a negative voltage (for example, -5V) is applied to gate electrode 13. At this time, the potential gradient of the portion of the PN junction in the vicinity of gate electrode 13 becomes particularly steep due to the effects of the gate electrode to which the negative voltage is applied. Therefore, hot positive holes (positive holes of high energy) are generated on the semiconductor substrate 11 side of the PN junction due to tunneling between bands. These hot positive holes are attracted in the direction toward gate electrode 13, which has a negative potential and, as a result, positive hole injection is carried out to first charge holding portion 61. As described above, erasure is carried out in first charge holding portion 61. At this time, 0V is applied to second diffusion layer region 18.

In the case wherein data stored in second charge holding portion 62 is erased, the potentials of the first and second diffusion layer regions in the above description may be switched with each other.

In the case wherein data stored in first charge holding portion 61 is erased, as shown in Fig 6, according to the second method, a positive voltage (for example, +5V) is applied to first diffusion layer region 17, 0V is applied to

second diffusion layer region 18, a negative voltage (for example, -4V) is applied to gate electrode 13 and a positive voltage (for example, +0.8V) is applied to semiconductor substrate 11. At this time, a voltage is applied between  
5 semiconductor substrate 11 and second diffusion layer region 18 in the forward direction so that electrons are injected into semiconductor substrate 11. The injected electrons diffuse up to the PN junction between semiconductor substrate 11 and first diffusion layer region 17 and are therein accelerated by a  
10 strong electrical field so as to become hot electrons. These hot electrons generate electron-positive hole pairs in the PN junction. That is to say, a voltage in the forward direction is applied between semiconductor substrate 11 and second diffusion layer region 18 and, thereby, the electrons injected  
15 into semiconductor substrate 11 trigger generation of hot positive holes in the PN junction located on the opposite side. The hot positive holes generated in the PN junction are attracted in the direction toward gate electrode 13, having a negative potential, and, as a result, positive hole injection  
20 is carried out to first charge holding portion 61.

According to this second method, the electrons injected from second diffusion layer region 18 can generate hot positive holes in the PN junction between semiconductor substrate 11 and first diffusion layer region 17 that are  
25 triggered by the generation of electron-positive hole pairs in



the PN junction, even in the case of the application of a low voltage insufficient for generation of hot positive holes due to tunneling between bands. Accordingly, the voltage at the time of the erasure operation can be lowered. In particular, in the case wherein offset regions 42 exist, the gate electrode to which the negative potential is applied does not influence the PN junction enough to create a sufficiently steep gradient. Therefore, hot positive holes due to tunneling between bands are not easily generated. The second method overcomes this defect so that the erasure operation can be implemented at a low voltage.

Here, in the case wherein data stored in first charge holding portion 61 is erased, +6V must be applied to first diffusion layer region 17 according to the first erasure method while +5V is sufficient according to the second erasure method. The voltage at the time of erasure can be reduced according to the second method, as described above, so that power consumption is reduced and deterioration of the semiconductor storage device due to hot carriers can be restricted.

This second method can be applied to the semiconductor storage device according to the present invention and, in addition, can be applied to the memory element (Fig 21) of Saifun Semiconductors Ltd. according to a prior art. In this case, the operational voltage for memory erasure can be lowered so that the power consumption can be lowered and deterioration

of the memory elements can be restricted.

According to the operational methods it becomes possible to selectively write in and erase two bits per transistor.

5           In addition, though according to the operational methods two bits are written in and erased per transistor by switching the source electrode and drain electrode, the device can be operated as a one bit memory by fixing the source electrode and the drain electrode. In this case, it becomes possible to  
10       connect one of the source/drain regions to the common fixed voltage and, thereby, the number of bit lines connected to the source/drain regions can be reduced by half.

          This memory element can be manufactured by means of approximately the same process as that for a conventional  
15       logic transistor. First, as shown in Fig 7A, a gate insulating film 12 made of a silicon oxide nitride film having a film thickness of from approximately 1 nm to 6 nm and a gate electrode  
      film made of polysilicon, a layered film of polysilicon and high melt point metal silicide or a layered film of polysilicon and  
20       metal having a film thickness of from approximately 50 nm to 400 nm are formed on semiconductor substrate 11, and patterning to a desired form is carried out so as to form a gate electrode.  
      13. Here, as for the gate insulating film and the material for the gate electrode, materials used in the process for  
25       manufacturing logic transistors may be selected according to

the scaling rules at the time of manufacture as described above and are not limited to the materials.

Next, as shown in Fig 7B, a silicon oxide film 51 having a film thickness of from 1.5 nm to 15 nm, more preferably from 5 nm to 12 nm, is deposited over the entire surface of the obtained semiconductor substrate 11 according to a CVD (chemical vapor deposition) method. Here, silicon oxide film 51 may be formed by means of thermal oxidation. Then, a silicon nitride film 52 having a film thickness of from 2 nm to 15 nm, more preferably from 3 nm to 7 nm, is deposited over the entire surface of silicon oxide film 51 according to a CVD method. Furthermore, a silicon oxide film 53 having a film thickness of from 20 nm to 70 nm is deposited over the entire surface of silicon nitride film 52 according to a CVD method.

Next, as shown in Fig 7C silicon oxide films 53, 51 and silicon nitride film 52 are etched back by means of anisotropic etching and, thereby, charge holding portions appropriate for data storage are formed in the form of sidewall spacers on the sidewalls of the gate electrode. After that, ions are injected using gate electrode 13 and charge holding portions in the form of sidewall spacers as a mask and, thereby, source/drain regions 17 and 18 are formed.

According to semiconductor storage device of the present Embodiment 1, charge holding portions of the memory transistor are formed so as to be independent of the gate

insulating film and are formed on opposite sides of the gate electrode. Therefore, two bit operation is possible. Furthermore, the charge holding portions are separated from each other by the gate electrode and, therefore, interference at the time of rewriting can be effectively suppressed. In addition, the memory function carried out by charge holding portions and the transistor operation function carried out by the gate insulating film are independent of each other and, therefore, the short channel effects can be suppressed by reducing the thickness of the gate insulating film. Accordingly, miniaturization of elements becomes easy.

In addition, in order to form the element, the type of material for film suitable for the memory function of the charge holding portions can be selected independent of the type of film of the gate insulating film. In the present embodiment, charge holding portions formed of a layered film of silicon oxide films and a silicon nitride film (silicon oxide film/silicon nitride film/silicon oxide film) are used so as to increase the injection efficiency of charges and so as to reduce leakage of charge. Accordingly, a semiconductor storage device having operational characteristics of high-speed rewrite and excellent storage characteristics is provided.

(Embodiment 2)

A memory element, which is a semiconductor storage

device of the present Embodiment 2, is provided by restricting charge injection into charge holding portions from the gate electrode in the semiconductor storage device according to the above Embodiment 1.

5           The memory element of the present embodiment is described in reference to Fig 8 below. The memory element of the present embodiment is characterized in that thickness T1B of silicon oxide film 14 on a sidewall of gate electrode 13 is greater than thickness T1A of silicon oxide film 14 on  
10 semiconductor substrate 11. Therefore, charge injection from gate electrode 13 to silicon nitride film 15 (or charge release from silicon nitride film 15 to gate electrode 13) can be effectively restricted. Accordingly, the rewriting characteristics of the memory element become stable and the  
15 reliability is increased.

          The procedure for the formation of the memory element of the present Embodiment 2 is described in reference to Figs 9A, 9B and 9C. In the following, a case is described wherein the semiconductor substrate is a silicon substrate and  
20 the gate electrode is made of polycrystal silicon. As shown in Fig 9A, a gate insulating film 12 and a gate electrode are formed on semiconductor (silicon) substrate 11. Here, it is preferable for gate electrode 13 to be made of polycrystal silicon. Next, as shown in Fig 9B, silicon oxide film 51 is  
25 formed on the surface of silicon substrate 11 and gate electrode

13 by means of thermal oxidation. Here, the film thickness of silicon oxide film 51 on silicon substrate 11 (regions 71) is greater than the film thickness of silicon oxide film 51 on the sidewalls of gate electrode 13 (regions 72). This is because the thermal oxidation rate of polycrystal silicon is greater than that of single crystal silicon. After that, as shown in Fig 9C, the memory element is completed according to the same procedure as in Embodiment 1.

According to the procedure, the difference in oxidation rates due to the difference in crystallinity is specifically utilized to selectively increase the thickness of the oxide film on the gate electrode sidewalls without increasing the number of steps. Accordingly, stable rewrite characteristics are obtained and it becomes possible to manufacture a memory element of a high reliability by means of a simple process.

(Embodiment 3)

In the semiconductor storage device of the present Embodiment 3, charge holding portions 161 and 162 are formed of regions for charge storage (may be regions for storing charges or films having a function of charge storage) and of regions for preventing charges from escaping (may be films having a function of preventing charges from escaping), as shown in Fig 10. The semiconductor storage device has, for example, ONO structure. That is to say, silicon nitride film 142, as

an example of a film made of a first insulator, is sandwiched between silicon oxide film 141, as an example of a film made of a second insulator, and silicon oxide film 143, as an example of a film made of a third insulator so as to form charge holding portions 161 and 162. Here, silicon nitride film 142 has a function of charge storage. In addition, silicon oxide films 141 and 143 act as films having the function of preventing the escape of charges stored in the silicon nitride film 142.

In addition, regions for charge storage (silicon nitride films 142) in charge holding portions 161 and 162, respectively, overlap diffusion layer regions 112 and 113. Here, overlap means that, at least, portions of regions for charge storage (silicon nitride films 142) exist above the regions of, at least, portions of diffusion layer regions 112 and 113. Here, a semiconductor substrate is denoted as 111, a gate insulating film is denoted as 114, a single gate electrode formed on gate insulating film 114 is denoted as 117 and offset regions (between the gate electrode and the diffusion layer regions) are denoted as 171. The surface portion of semiconductor substrate 111 beneath gate insulating film 114 becomes a channel region, not shown.

The effects resulting from overlap of diffusion layer regions 112 and 113 by the regions (silicon nitride films 142) for charge storage in charge holding portions 161 and 162 are described below.

Fig 11 is an enlarged view of a portion surrounding charge holding portion 162 on the right side of Fig 10. The amount of offset between gate electrode 117 and diffusion layer region 113 is denoted as  $W1$ . In addition, the width of charge holding portion 162 shown in the cross section along the channel length direction of gate electrode 117 is denoted as  $W2$  and, since the edge of silicon nitride film 142 in charge holding portion 162 on the side located away from gate electrode 117 agrees with the edge of charge holding portion 162 on the side away from gate electrode 117, the width of charge holding portion 162 is defined as  $W2$ . The amount of overlap between charge holding portion 162 and diffusion layer region 113 is represented as  $W2 - W1$ . It is particularly important for silicon nitride film 142 in charge holding portion 162 to overlap diffusion layer region 113, that is to say, for the relationship of  $W2 > W1$  to be satisfied.

Here, as shown in Fig 12, in the case wherein the edge of charge storage film 142a in charge holding portion 162a on the side located away from gate electrode 117 does not agree with the edge of charge holding portion 162a on the side located away from gate electrode 117, the distance between the edge of gate electrode 117 on the silicon oxide film 141a side and the edge of charge storage film 142a on the side located away from gate electrode 117 is defined as  $W2$ .

Fig 13 shows drain current  $I_d$  when the amount  $W1$



of offset is changed while width W2 of charge holding portion 162 is fixed at 100 nm. Here, the drain current is calculated according to a device simulation wherein charge holding portion 162 is in the erased state (positive holes are stored) and diffusion layer regions 112 and 113, respectively, are used as the source electrode and the drain electrode.

As is clear from Fig 13, the drain current rapidly decreases to a range wherein W1 is 100 nm, or greater, (that is to say, silicon nitride film 142 and diffusion layer region 113 do not overlap). The value of the drain current is approximately proportional to the rate of the read-out operation and, therefore, the memory performance undergoes a sudden deterioration when W1 is 100 nm, or greater. On the other hand, the drain current decreases gradually in a range wherein silicon nitride film 142 and diffusion layer region 113 overlap. Accordingly, it is preferable for, at least, a portion of silicon nitride film 142, which is a film having a function of charge storage, to overlap the source/drain region (diffusion layer region 113). It is also preferable in charge holding portion 161 for, at least, a portion of silicon nitride film 142, which is a film having a function of charge storage, to overlap the source/drain region (diffusion layer region 112) in the same manner as above.

Taking the result of the device simulation into consideration, memory cell arrays are fabricated wherein W2 is

fixed at 100 nm and W1 is set at 60 nm and 100 nm as design values. In the case that W1 is 60 nm, silicon nitride film 142 and diffusion layer regions 112 and 113 overlap by 40 nm according to the design value while in the case that W1 is 100 nm, they do not overlap according to the design value. The case wherein W1 is set at 60 nm as the design value is 100 times as fast as the other case according to the access time for read-out as a result of measurement, wherein samples of the worst case are compared taking dispersion into consideration, of the period of time of read-out in these memory cell arrays. In practice it is preferable for the access read-out time to be 100 nanoseconds, or less, per bit but it was found that this condition cannot be achieved in the case of  $W1 = W2$ . In addition, it was discovered that  $W2 - W1 > 10$  nm is preferable in the case wherein manufacturing dispersion is taken into consideration.

It is preferable to form a pinch off point on the side close to the drain region in the channel region by using diffusion layer region 112 as a source electrode and by using diffusion layer region 113 as a drain region in the same manner as in Embodiment 1 in order to read out data stored in charge holding portion 161 (region 181). That is to say, it is preferable to form a pinch off point in a region close to one of the two charge holding portions within the channel region at the time of read-out of data stored in the other charge holding portion. Thereby, data stored in charge holding portion 161

can be detected with a high precision regardless of the storage condition of charge holding portion 162, and this is a major factor that makes two bit operation possible.

5 On the other hand, in the case wherein data is stored in only one of the two charge holding portions or wherein the memory cells are utilized so that the two charge holding portions are in the same storage condition, a pinch off point is not necessarily formed at the time of read-out.

10 Here, it is preferable to form a well region (P type well in the case of an N channel element) in the surface of semiconductor substrate 111, though this is not shown in Fig 10. It becomes easy to adjust the impurity concentration in the channel region to the value appropriate for the memory operations (rewrite operation and read-out operation) and, in addition; it becomes easy to control other electrical properties (resistance to voltage, junction capacitance, short channel effects) by forming a well region.

20 It is preferable for charge holding portions 161 and 162 to include charge storage films having a function of charge storage and insulating films from the viewpoint of increasing the storage characteristics of the memory. In this embodiment, silicon nitride films 142 having levels that trap charges are used as the charge storage films and silicon oxide films 141 and 143 that prevent dispersion of the charges stored in the charge storage films are used as the insulating films.

The charge holding portions include charge storage films and insulating films so as to prevent discharge of charges and, thereby, the storage characteristics can be improved. Furthermore, the volume of the charge storage films can be reduced to some extent in comparison with the case wherein charge holding portions are formed solely of charge storage films. Shift of charges within the charge storage films can be restricted by reducing the volume of the charge storage films and, thereby, change in characteristics due to charge shift while data is being stored can be prevented from occurring.

In addition, it is preferable for charge holding portions 161 and 162 to include charge storage films, which are placed approximately parallel to the surface of gate insulating film 114, in other words, it is preferable for the upper surfaces of charge storage films in charge holding portions 161 and 162 to be placed at positions an equal distance away from the top surface of gate insulating film 114. Concretely, as shown in Fig 14, charge storage film 142a of charge holding portion 162 has a surface approximately parallel to the surface of gate insulating film 114. In other words, it is preferable for charge storage film 142a to be formed to have a uniform height relative to the level of the surface of gate insulating film 114. Charge storage film 142a, which is parallel to the surface of gate insulating film 114, is located in charge holding portion 162 and, thereby, ease of formation

of the inversion layer in offset region 171 according to the quantity of stored charge in charge storage film 142a can be effectively controlled and, thereby, the memory effects can be increased. In addition, charge storage film 142a is approximately parallel to the surface gate insulating film 114 and, thereby, change in the memory effects can be restricted to a comparatively small amount even in the case wherein the amount (W1) of offset varies. Furthermore, a shift of the charge in the direction toward the upper portion of charge storage film 142a can be suppressed and change in characteristics due to charge shift while data is being stored can be prevented from occurring.

Moreover, it is preferable for charge holding portion 162 to include an insulating film (for example, a portion of silicon oxide film 144 above offset region 171) that separates charge storage film 142a, which is approximately parallel to the surface of gate insulating film 114, from the channel region (or well region). This insulating film restricts discharge of the charge stored in the charge storage film so that a semiconductor storage device having improved storage characteristics can be obtained.

Here, the film thickness of charge storage film 142a is adjusted and the film thickness of the insulating film (portion of silicon oxide film 144 above offset region 171) beneath charge storage film 142a is adjusted to be constant and,

thereby, it becomes possible to maintain an approximately constant distance between the surface of semiconductor substrate 111 and the charge stored in the charge storage film. That is to say, the distance between the surface of the semiconductor substrate and the charge stored in the charge storage film can be adjusted to be in the range between the minimum film thickness value of the insulating film beneath charge storage film 142a and the sum of the maximum film thickness value of the insulating film beneath charge storage film 142a and the maximum film thickness value of charge storage film 142a. Thereby, it becomes possible to generally control the density of the lines of electric force generated by the charge stored in charge storage film 142a and, thus, it becomes possible to make the dispersion in the magnitude of the memory effects of the memory elements very small.

(Embodiment 4)

In the present Embodiment 4, charge storage film 142 in charge holding portion 162 has a form of a combination of films having approximately uniform thicknesses positioned approximately parallel to the surface of gate insulating film 114 (arrow 181) and positioned approximately parallel to the sides of gate electrode 117 (arrow 182).

In the case that a positive voltage is applied to gate electrode 117, the lines of electric force in charge holding portion 162 pass through silicon nitride film 142 twice

(portions indicated by arrow 182 and arrow 181) as shown by arrow 183. Here, in the case wherein a negative voltage is applied to gate electrode 117, the direction of the lines of electric force is reversed. Here, dielectric constant of silicon nitride film 142 is approximately 6 while the dielectric constant of silicon oxide films 141 and 143 is approximately 4. Accordingly, in the case wherein the charge storage film indicated by arrows 181 and 182 exists, the effective dielectric constant of charge holding portion 162 in the direction of lines of electric force 183 is greater than in the case wherein the charge storage film indicated solely by arrow 181 exists and the voltage gap between both ends of the lines of electric force can be reduced. That is to say, the major portion of the voltage applied to gate electrode 117 is used in order to enhance the magnetic field in offset region 171.

A charge is injected into silicon nitride film 142 at the time of the rewrite operation because the generated charge is attracted by an electrical field in offset region 171. Accordingly, the charge injected to charge holding portion 162 at the time of the rewrite operation increases by providing the charge storage film indicated by arrow 182 so that the rate of rewriting increases.

Here, in the case wherein the silicon oxide film 143 portion is made of a silicon nitride film, that is to say, in the case wherein the charge storage film is not positioned

at a uniform height relative to the level of the surface of gate insulating film 114, shift of charge in the upward direction in the silicon nitride film becomes significant and the storage characteristics deteriorate.

5                   It is more preferable for the charge storage film to be formed of a high dielectric material, such as hafnium oxide, having a relatively great dielectric constant instead of the silicon nitride film.

10                   Furthermore, it is preferable for charge holding portions 161 and 162 to further include an insulating film (portion of silicon oxide film 141 above offset region 171) that separates the charge storage films approximately parallel to the surface of gate insulating film 114 from the channel region (or well region). This insulating film restricts discharge of  
15                   the charge stored in the charge storage film so that the storage characteristics can be improved.

                  In addition, it is preferable for the charge holding portions to further include an insulating film (portion of silicon oxide film 141 contacting gate electrode 117) that  
20                   separates the gate electrode from the charge storage films extending in the direction approximately parallel to the sides of the gate electrode. This insulating film prevents change in the electrical characteristics due to the injection of the charge from the gate electrode to the charge storage films and  
25                   the reliability of the semiconductor storage device can be



improved.

Furthermore, it is preferable in the same manner as in Embodiment 3 for the film thickness of the insulating film (portion of silicon oxide film 141 above offset region 171) beneath charge storage film 142 to be adjusted to be constant and, in addition, for the film thickness of the insulating film (portion of silicon oxide film 141 contacting gate electrode 117) placed on the a side of the gate electrode to be adjusted to be constant. Thereby, it becomes possible to generally control the density of the lines of electric force generated by the charge stored in charge storage film 142 and charge leakage can be prevented.

(Embodiment 5)

The present Embodiment 5 relates to the optimization of the distances between the gate electrode and the charge holding portions and the source/drain regions.

As shown in Fig 16, the length of the gate electrode in the cross section along the channel length direction is denoted as A, the distance (channel length) between the source/drain regions is denoted as B and the distance between the edge of one of the charge holding portions and the edge of the other charge holding portion, that is to say, the distance between the edge (on the side separated from the gate electrode) of the film having the function of charge storage within one of the charge holding portions and the edge (on the side

separated from the gate electrode) of the film having the function of charge storage within the other charge holding portion in the cross sectional view along the channel length direction, is denoted as C.

5                   First,  $B < C$  is preferable. Offset regions 171 exist between the portion beneath gate electrode 117 and source/drain regions 112 and 113 within the channel region. In the case of  $B < C$ , the charges stored in charge holding portions 161 and 162 (silicon nitride film 142) leads to an effective  
10 change in the ease of inversion throughout the entire regions of offset regions 171. Accordingly, the memory effect increases and, in particular, increase in the rate of the read-out operation is implemented.

                  In addition, in the case that gate electrode 117  
15 and source/drain regions 112 and 113 offset each other, that is to say, in the case of  $A < B$ , ease of inversion in the offset regions at the time when a voltage is applied to the gate electrode greatly changes according to the amounts of charges stored in the charge holding portions so that the memory effects  
20 increase and the short channel effects can be reduced. Here, it is not necessary for the offset regions to exist as long as the memory effects appear. Even in the case wherein there are no offset regions 171, the memory effects appear in charge holding portions 161 and 162 (silicon nitride film 142) when  
25 the impurity concentrations in source/drain regions 112 and 113

are sufficiently low.

Accordingly,  $A < B < C$  is most preferable.

(Embodiment 6)

The semiconductor storage device of this  
5 embodiment has essentially the same configuration as in  
Embodiment 3 except that the semiconductor substrate is an SOI  
substrate, as shown in Fig 17.

In this semiconductor storage device a buried oxide  
film 188 is formed on semiconductor substrate 186 and an SOI  
10 layer is formed on top of the buried oxide film. Diffusion layer  
regions 112 and 113 are formed within the SOI layer and the  
remaining portion of the region is used as a body region 187.

This semiconductor storage device has the same  
working effects as the semiconductor storage device of  
15 Embodiment 3. Furthermore, the junction capacitances between  
diffusion layer regions 112 and 113 and body region  
(semiconductor layer) 187 can be made very low and, therefore,  
increase in the operational speed of the elements and the  
lowering of power consumption are made possible.

20 (Embodiment 7)

The semiconductor storage device of this  
embodiment has essentially the same configuration as in  
Embodiment 3 except that P type high concentration regions 191  
are added to adjoin N type source/drain regions 112 and 113 on  
25 the channel side as shown in Fig 18.

That is to say, the concentration of the impurity (for example, boron) that provides the P type in P type high concentration regions 191 is higher than the concentration of the impurity that provides the P type in region 192. It is appropriate for the P type impurity concentration in P type high concentration regions 191 to be, for example, approximately  $5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$  to  $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ . In addition, the P type impurity concentration of region 192 is, for example,  $5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  to  $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ .

As described above, P type high concentration regions 191 are provided and, thereby, the junctions between diffusion layer regions 112 and 113 and semiconductor substrate 111 have steep gradients directly beneath charge holding portions 161 and 162. Therefore, hot carriers do not easily occur at the time of the write-in and erasure operations and, therefore, it becomes possible to lower the voltages for the write-in operation and for the erasure operation or it becomes possible to increase the rates of the write-in operation and of the erasure operation. Furthermore, since the impurity concentration of region 192 is relatively low, the threshold value when the memory is in the erased condition is low and the drain current becomes large. Therefore, the rate of read-out increases. Accordingly, a semiconductor storage device having a low rewrite voltage or having a high rewrite speed and having a high read-out speed can be obtained.

In addition, P type high concentration regions 191 are provided in the vicinity of the source/drain regions and beneath the charge holding portions 161, 162 (that is to say, not directly beneath the gate electrode 117) in Fig 18 and, thereby, the threshold value of the entire transistor significantly increases. The degree of this increase is significantly large in comparison with the case wherein P type high concentration regions 191 are located directly beneath the gate electrode 117. In the case wherein the charges (electrons in the case that the transistor is of the N channel type) are stored for write-in in the charge holding portions 161, 162, this gap becomes even greater. On the other hand, in the case wherein sufficient charges (positive holes in the case that the transistor is of the N channel type) are stored for erasure in the charge holding portions 161, 162, the threshold value of the entire transistor drops to the threshold value determined by the impurity concentration of the channel region (region 192) beneath the gate electrode 117. That is to say, the threshold value at the time of erasure does not depend on the impurity concentration of P type high concentration regions 191 while the threshold value at the time of write-in is very greatly affected by the impurity concentration of P type high concentration regions 191. Accordingly, P type high concentration regions 191 are positioned in the vicinity of the source/drain regions beneath the charge holding portions and,

thereby, the threshold value alone at the time of write-in can be altered to a great extent so that the memory effects (difference in threshold value between the time of write-in and the time of erasure) can be significantly increased.

5 (Embodiment 8)

The semiconductor storage device of the present embodiment has essentially the same configuration as in Embodiment 3 except that the thickness (T3) of the insulating films for separating the charge storage films (silicon nitride  
10 film 142) from the channel region or from the well region is less than the thickness (T4) of gate insulating film 114, as shown in Fig 19.

Thickness T4 of gate insulating film 114 has the lower limit value because resistance to voltage is required for  
15 the gate insulating film at the time of the rewrite operation of memory. However, it is possible to make thickness T3 of the insulating film to be less than T4, regardless of the requirement of resistance to voltage. Injection of charges to charge holding portions 161, 162 is made easy by reducing T3  
20 and it becomes possible to lower the voltage for the write-in operation and for the erasure operation or it becomes possible to increase the rate of the write-in operation and of the erasure operation and, in addition, the amounts of the charges induced in the channel region or in the well region at  
25 the time the charges have been stored in silicon nitride film

142 increase and, therefore, the memory effects can be increased.

Accordingly, when  $T3 < T4$  is satisfied, it becomes possible to lower the voltage for the write-in operation and for the erasure operation or it becomes possible to increase the rate of the write-in operation without lowering the resistance of the memory to voltage and, furthermore, it becomes possible to increase the memory effects.

Here, it is preferable for thickness  $T3$  of the insulating film to be 0.8 nm, or greater, which is the limit wherein the uniformity and quality of the film are maintained at a constant level according the manufacturing process and wherein the storage characteristics do not undergo extreme deterioration.

(Embodiment 9)

The semiconductor storage device of this embodiment has essentially the same structure as in Embodiment 3 except that the thickness ( $T3$ ) of the insulating films (silicon oxide film 141) for separating the charge storage films (silicon nitride film 142) from the channel region or from the well region is greater than the thickness ( $T4$ ) of gate insulating film 114, as shown in Fig 20.

Thickness  $T4$  of gate insulating film 114 has the upper limit value due to the requirement for prevention of short channel effects of the element. However, it is possible to make

thickness  $T_3$  of the insulating film greater than  $T_4$ , regardless of the requirement for prevention of short channel effects. By increasing  $T_3$ , it becomes possible to prevent the charges stored in the charge holding portions from discharging and to improve the storage characteristics of the memory.

Accordingly, when  $T_3 > T_4$  is satisfied, it becomes possible to improve the storage characteristics without negatively affecting the short channel effects of memory.

Here, it is preferable for thickness  $T_3$  of the insulating film to be 20 nm, or less, taking reduction in the rate of the rewrite operation into consideration.



## WHAT IS CLAIMED IS:

1. A semiconductor storage device comprising:
  - a semiconductor substrate;
  - a gate insulating film formed on the semiconductor
  - 5 substrate;
  - a single gate electrode formed on the gate insulating film;
  - two charge holding portions formed on the sidewalls on opposite sides of the single gate electrode;
  - 10 two diffusion layer regions corresponding to the two charge holding portions, respectively; and
  - a channel region placed beneath the single gate electrode, wherein
  - the charge holding portions have a structure such
  - 15 that a film made of a first insulator having a function of holding charge is sandwiched between a second insulator and a third insulator, and
  - the charge holding portions are constituted such that the amount of current flowing between one of the diffusion
  - 20 layer regions and the other of the diffusion layer regions at the time of application of a voltage to the gate electrode is changed due to the quantity of charge held in the first insulator.

- 25 2. The semiconductor storage device according to

Claim 1, wherein expressions  $\chi_1 > \chi_2$  and  $\chi_1 > \chi_3$  are satisfied,  
where

the  $\chi_1$  represents an energy gap between the vacuum  
level and the lowest level of a conduction band of the first  
insulator,

the  $\chi_2$  represents an energy gap between the vacuum  
level and the lowest level of a conduction band of the second  
insulator, and

the  $\chi_3$  represents an energy gap between the vacuum  
level and the lowest level of a conduction band of the third  
insulator.

3. The semiconductor storage device according to  
Claim 1, wherein expressions  $\phi_1 < \phi_2$  and  $\phi_1 < \phi_3$  are satisfied,  
where

the  $\phi_1$  represents an energy gap between the vacuum  
level and the highest level of a valence band of the first  
insulator,

the  $\phi_2$  represents an energy gap between the vacuum  
level and the highest level of a valence band of the second  
insulator, and

the  $\phi_3$  represents an energy gap between the vacuum  
level and the highest level of a valence band of the third  
insulator.

4. The semiconductor storage device according to Claim 1, wherein all expressions of:  $\chi_1 > \chi_2$ ,  $\chi_1 > \chi_3$ ,  $\phi_1 < \phi_2$  and  $\phi_1 < \phi_3$  are satisfied, where

the  $\chi_1$  represents an energy gap between the vacuum level and the lowest level of the conduction band of the first insulator,

the  $\chi_2$  represents an energy gap between the vacuum level and the lowest level of the conduction band of the second insulator,

the  $\chi_3$  represents an energy gap between the vacuum level and the lowest level of the conduction band of the third insulator,

the  $\phi_1$  represents an energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band of the first insulator,

the  $\phi_2$  represents an energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band of the second insulator, and

the  $\phi_3$  represents an energy gap between the vacuum level and the highest level of the valence band of the third insulator.

5. The semiconductor storage device according to Claim 1, wherein

the first insulator is of silicon nitride, and

the second and third insulators are of silicon oxide.

6. The semiconductor storage device according to  
5 Claim 5, wherein

the second insulator that is of silicon oxide is in a film form and separates the semiconductor substrate from the first insulator, and

the film formed of the second insulator on the  
10 semiconductor substrate has a thickness of no less than 1.5 nm and of no greater than 15 nm.

7. The semiconductor storage device according to Claim 5, wherein

15 the film formed of the first insulator, which is of silicon nitride, on the semiconductor substrate has a thickness of no less than 2 nm and of no greater than 15 nm.

8. The semiconductor storage device according to  
20 Claim 1, wherein

the second insulator is in a film form and separates the semiconductor substrate and the sidewalls of the gate electrode from the first insulator, and

the thickness of the film made of the second  
25 insulator in the vicinity of the sidewalls of the gate electrode

is greater than the thickness of the film made of the second insulator on the semiconductor substrate.

9. The semiconductor storage device according to  
5 Claim 5, wherein

the thickness of the film made of the second insulator on the semiconductor substrate is less than the thickness of the gate insulating film and is not less than 0.8 nm.

10

10. The semiconductor storage device according to Claim 5, wherein

15

the thickness of the film made of the second insulator on the semiconductor substrate is greater than the thickness of the gate insulating film and is not greater than 20 nm.

11. The semiconductor storage device according to Claim 1, wherein

20

at least a portion of the film made of the first insulator having a function of charge storage overlaps a portion of the diffusion layer regions.

25

12. The semiconductor storage device according to Claim 1, wherein

the film made of the first insulator having a function of charge storage includes a portion having a surface approximately parallel to the surface of the gate insulating film.

5

13. The semiconductor storage device according to Claim 12, wherein

the film made of the first insulator having a function of charge storage includes a portion that extends  
10 approximately parallel to sides of the gate electrode.

## ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

A semiconductor storage device wherein storage of two bits is implemented in one transistor and that can be further miniaturized is provided. Two charge holding portions, one on each sidewall of the gate electrode, are formed so as to be independent of the gate insulating film. Thereby, the memory function carried out by the charge holding portions and the transistor operation function carried out by the gate insulating film are separated. The two charge holding portions, formed on opposite sides of the gate electrode, are separated by the gate electrode and, therefore, interference at the time of rewriting can be effectively suppressed. Accordingly, a semiconductor storage device wherein storage of two bits is implemented in one transistor and that is miniaturized is provided.

Fig. 1

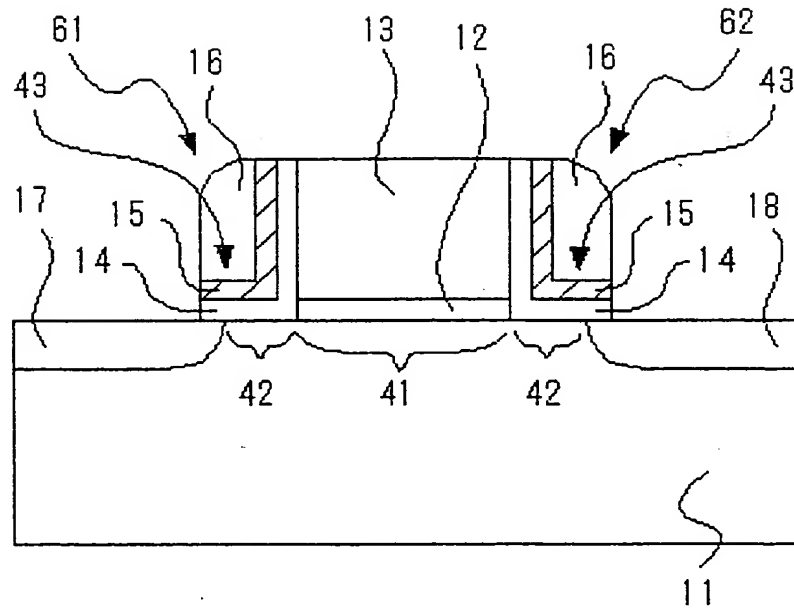
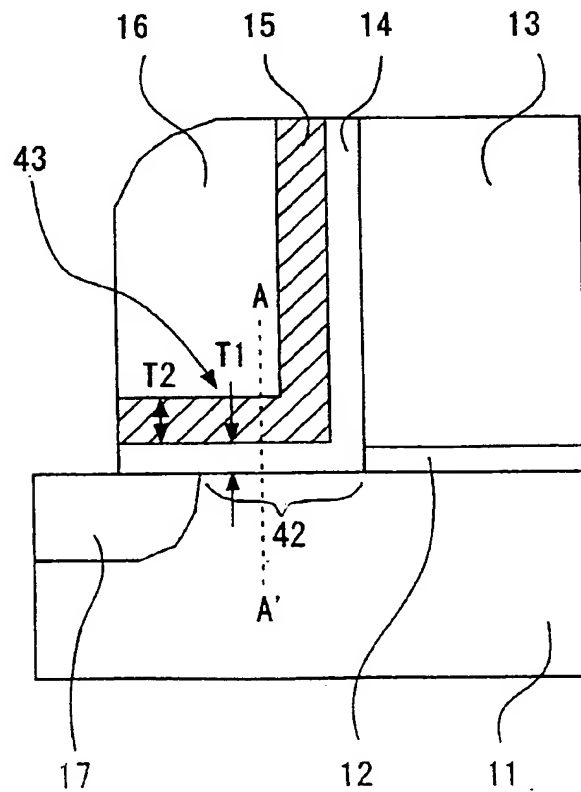


Fig. 2





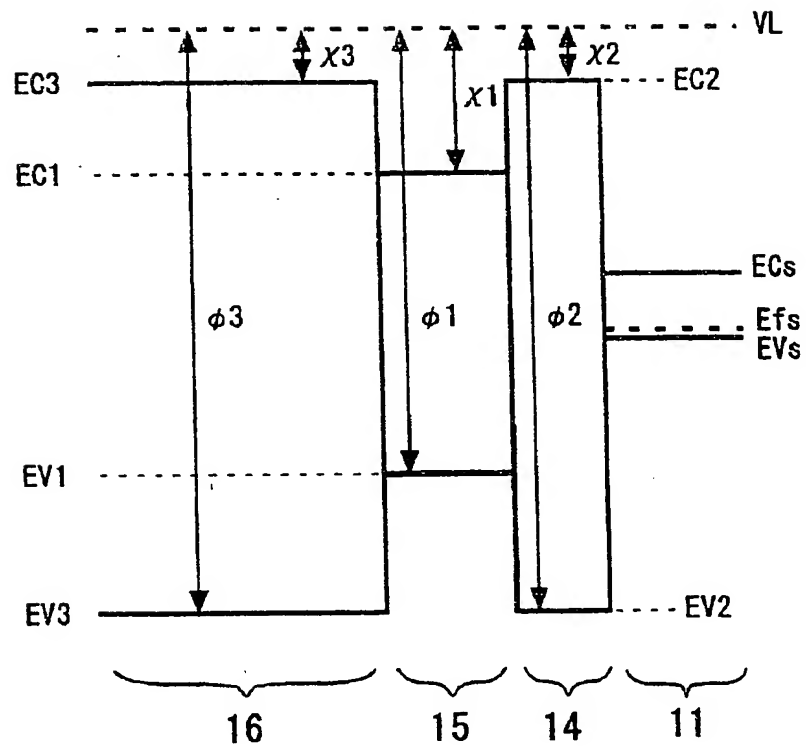
*Fig. 3*



Fig. 5

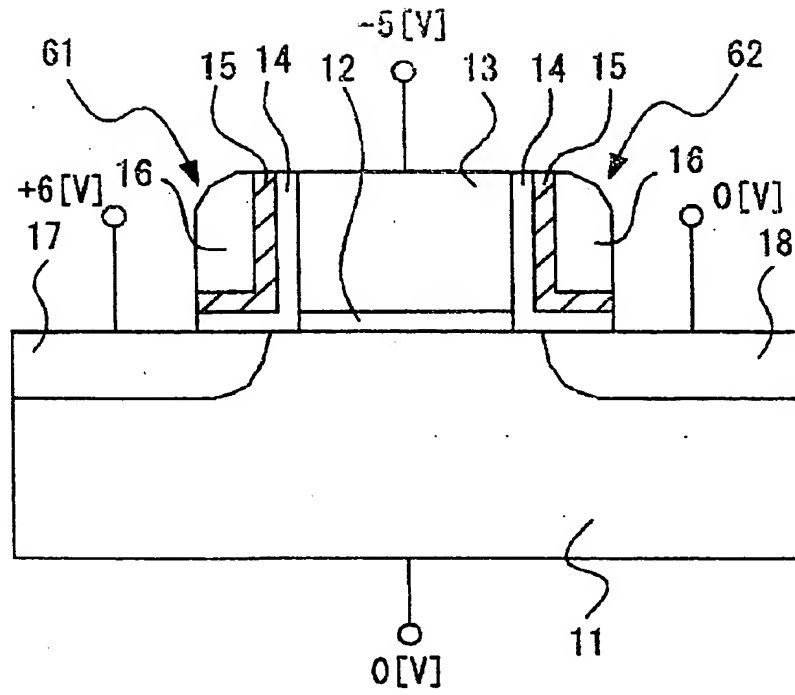


Fig. 6

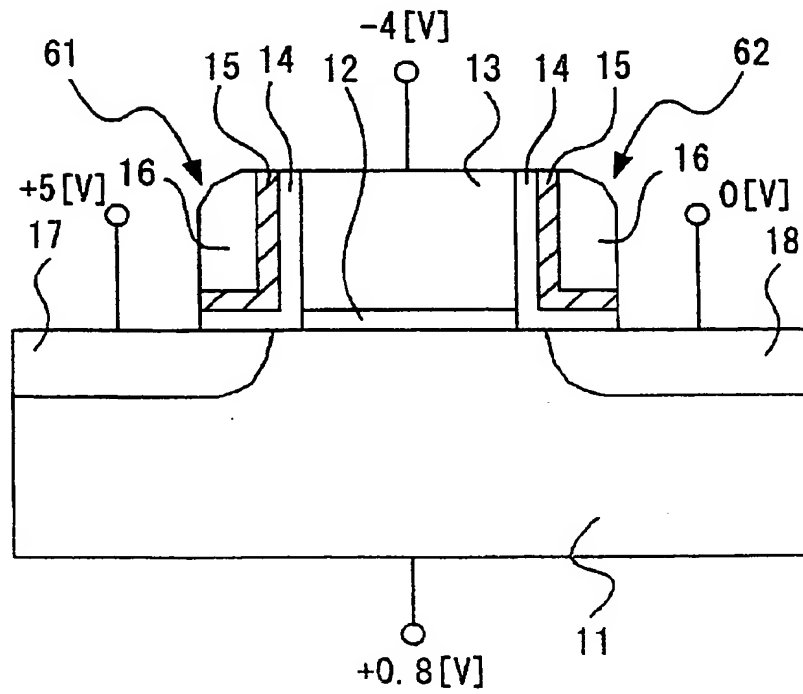


Fig. 7 A

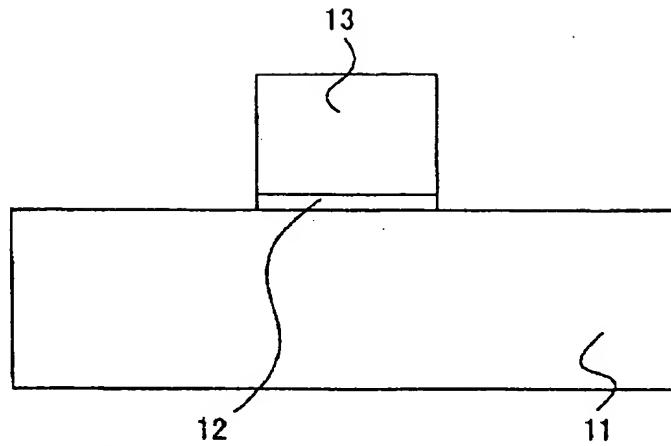


Fig. 7 B

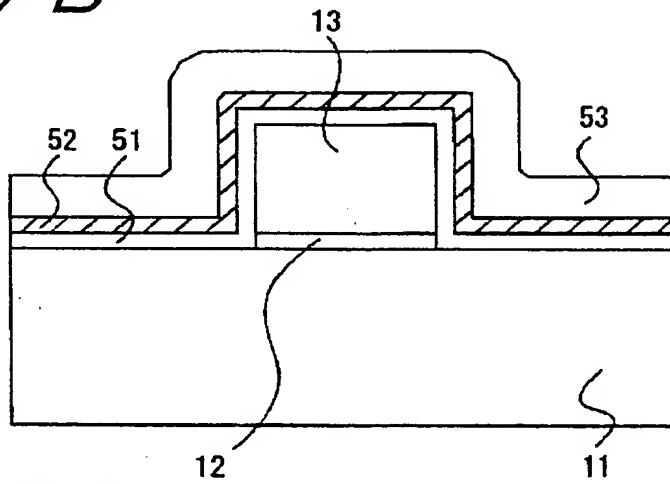
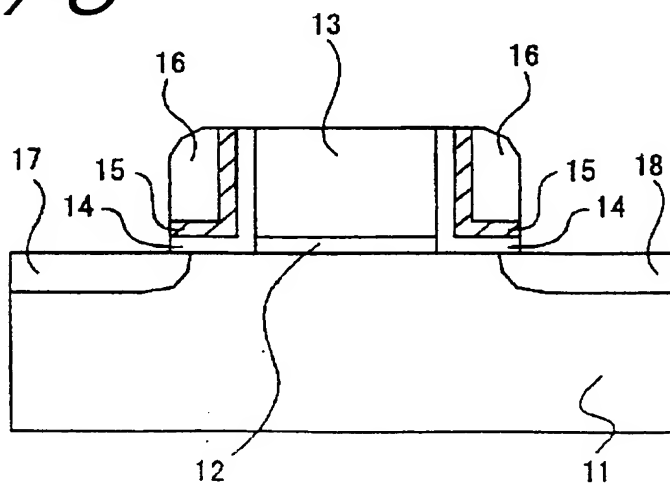
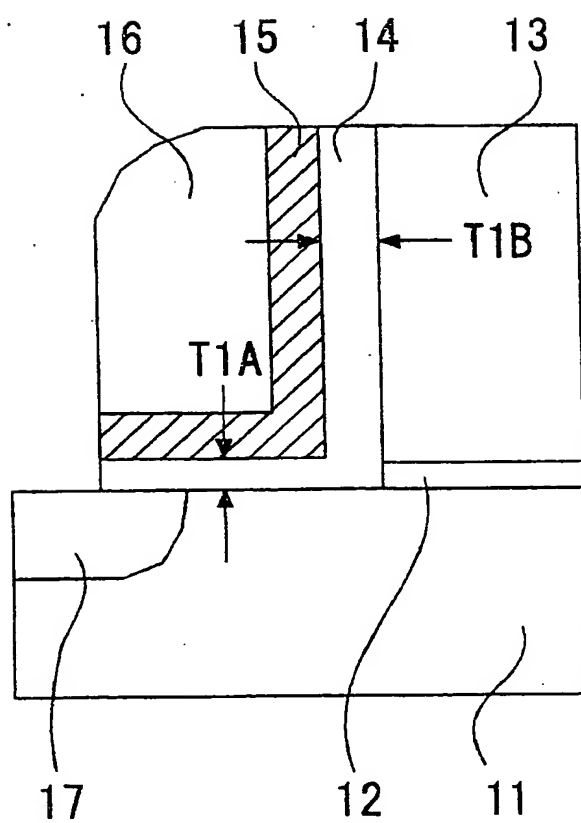
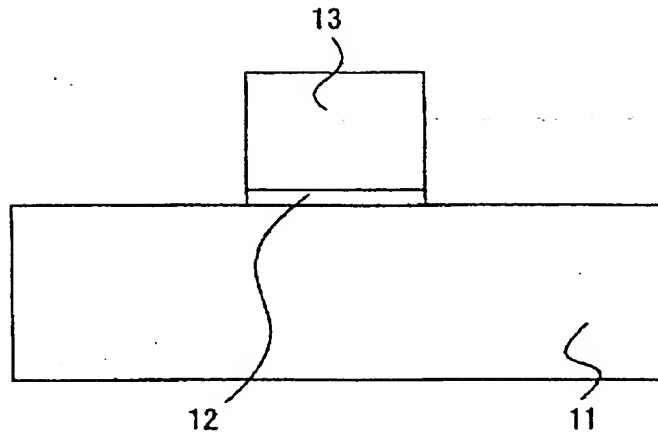
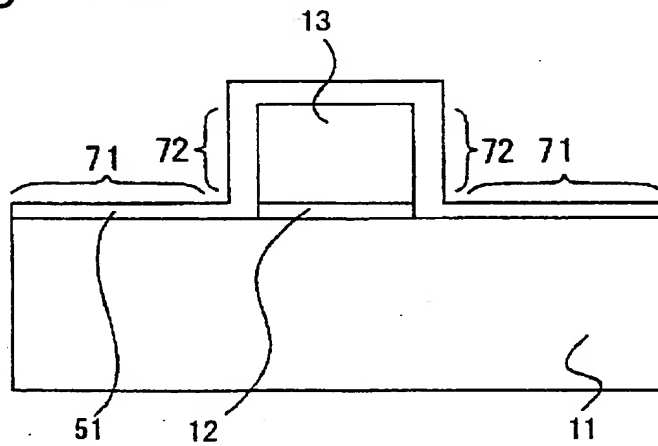
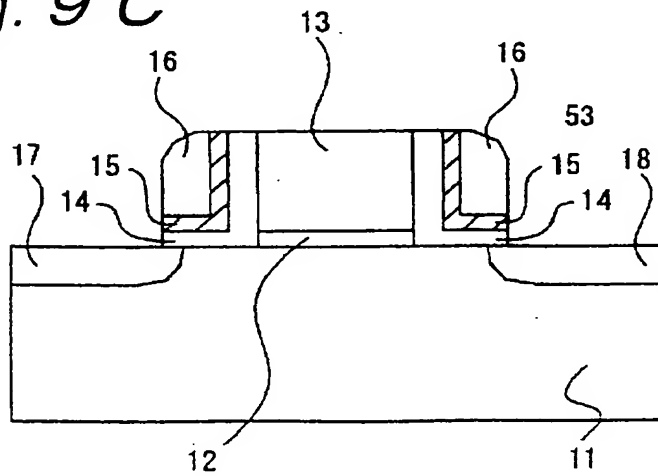


Fig. 7 C



*Fig. 8*

*Fig. 9 A**Fig. 9 B**Fig. 9 C*

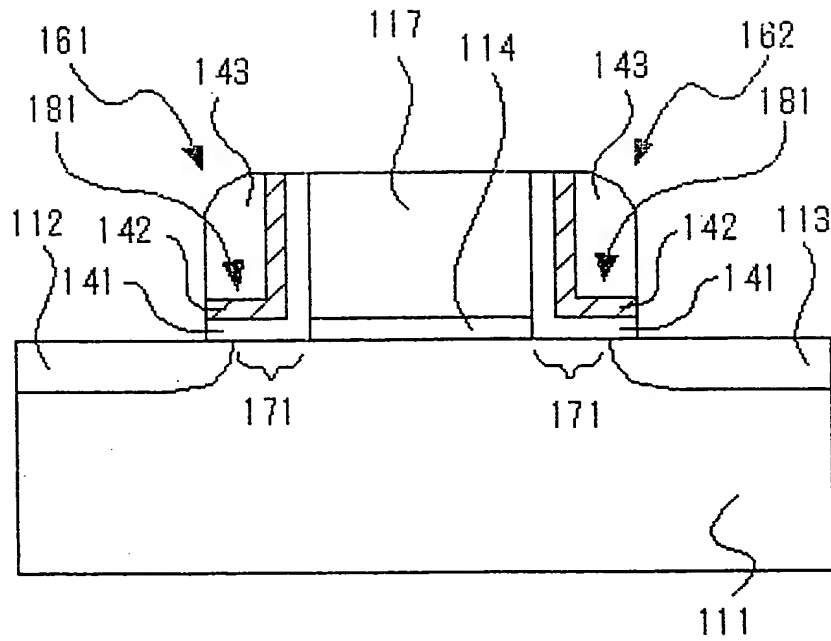
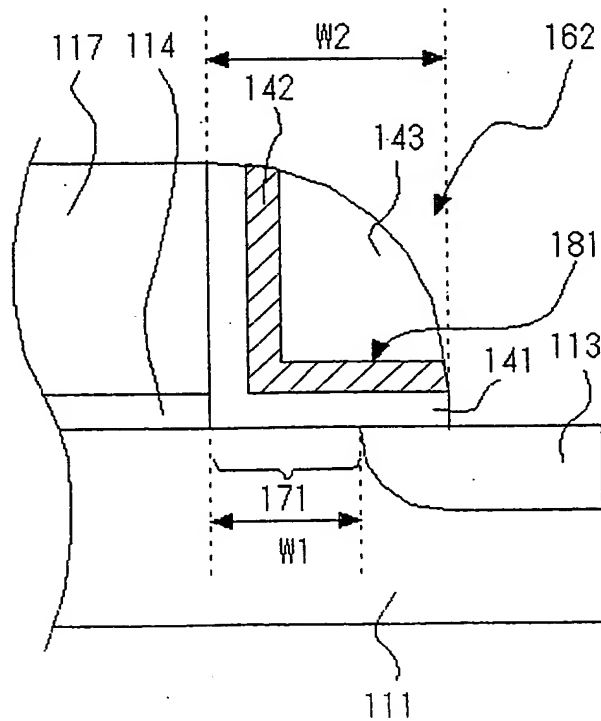
*Fig. 1 0**Fig. 1 1*

Fig. 1 2

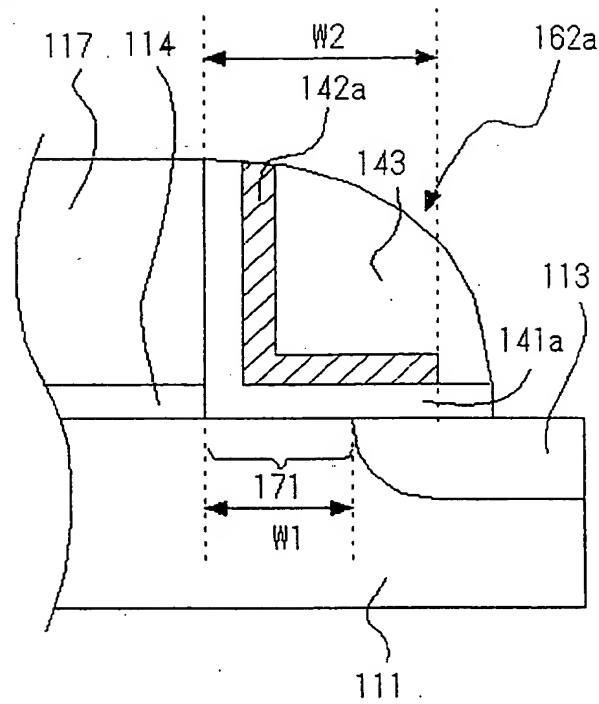


Fig. 1 3

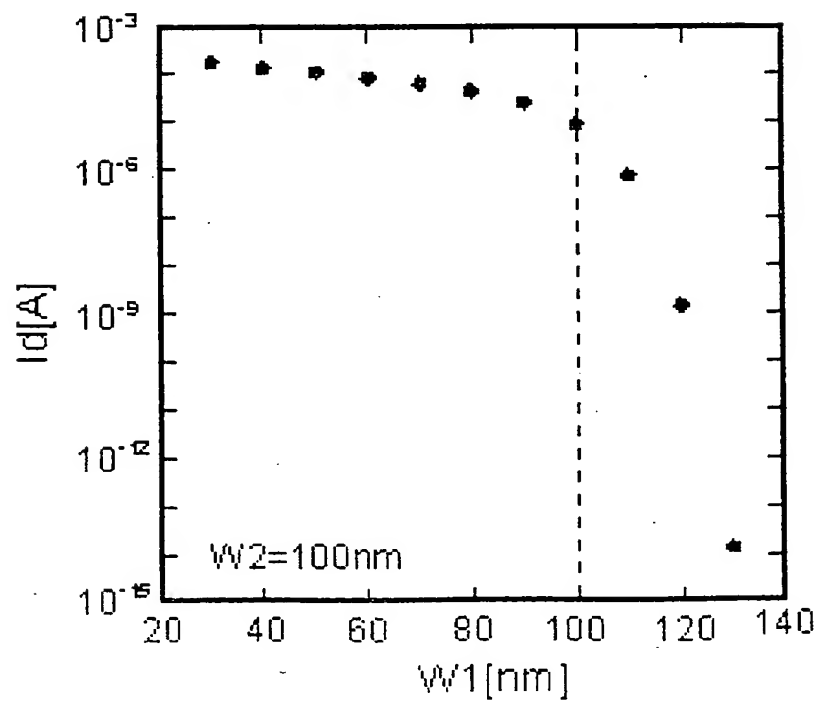
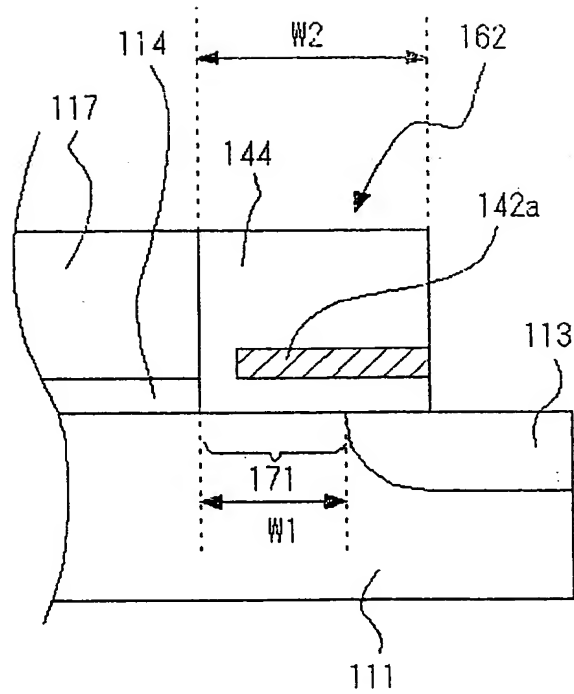




Fig. 14



*Fig. 15*

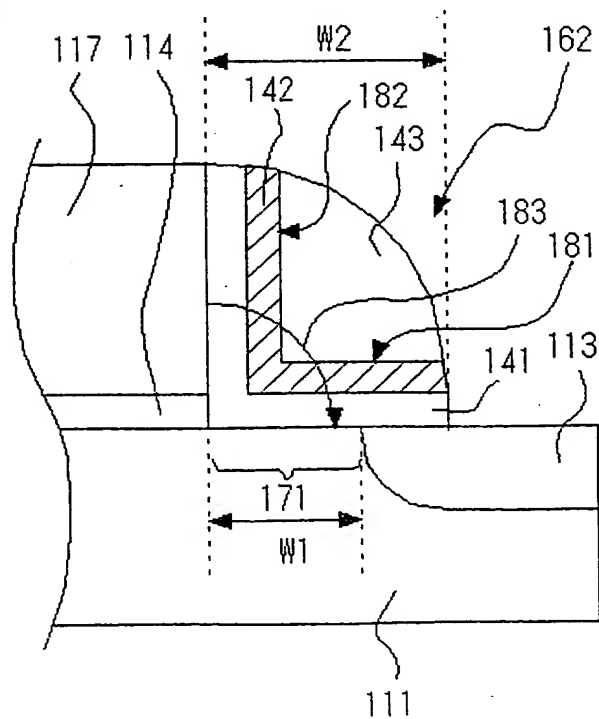


Fig. 1 6

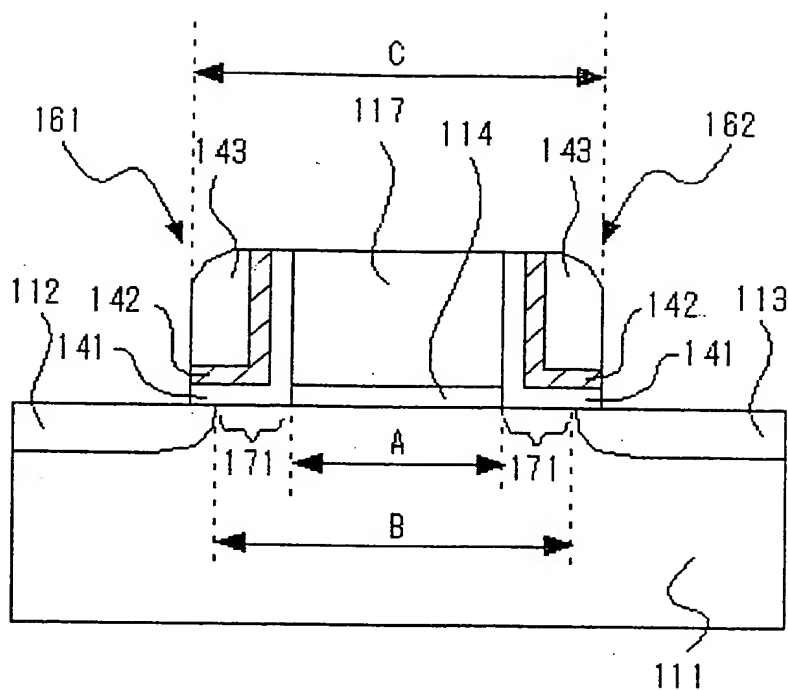
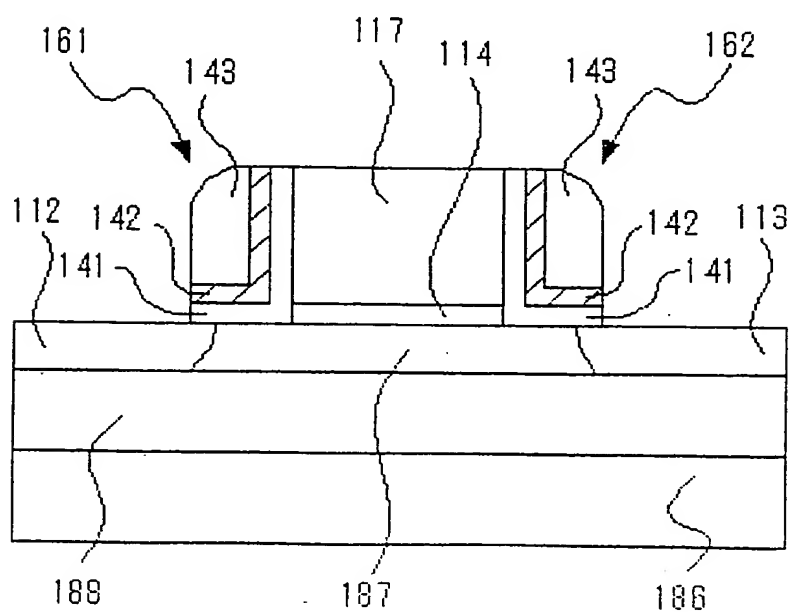


Fig. 1 7



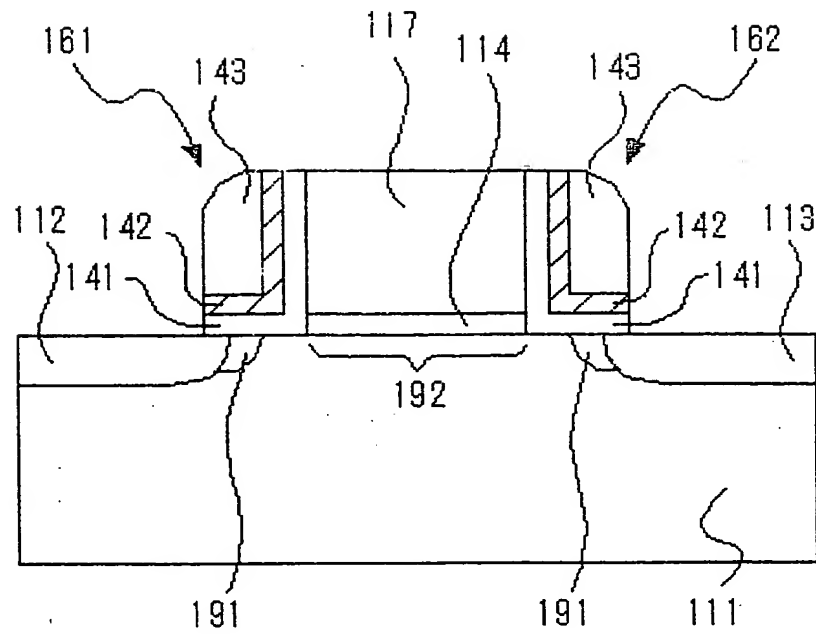
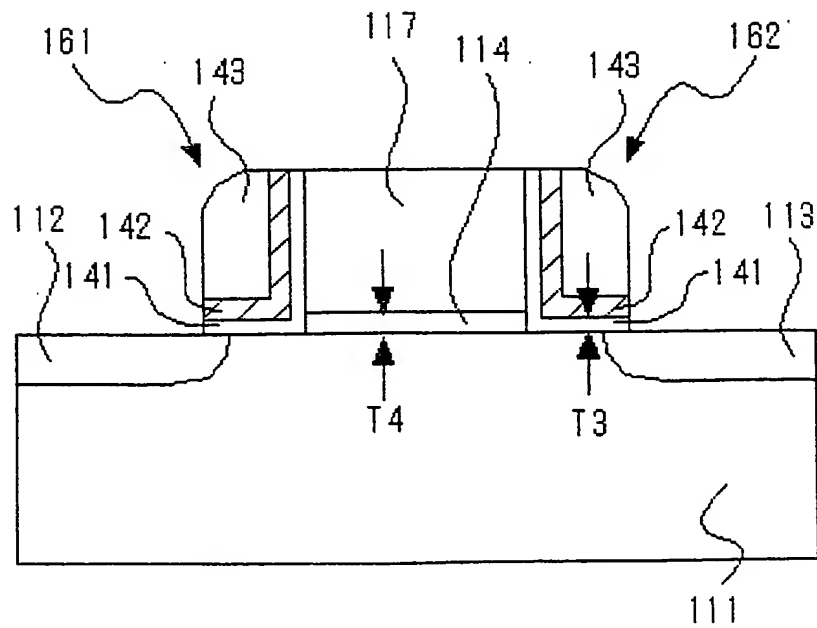
*Fig. 18**Fig. 19*

Fig. 20

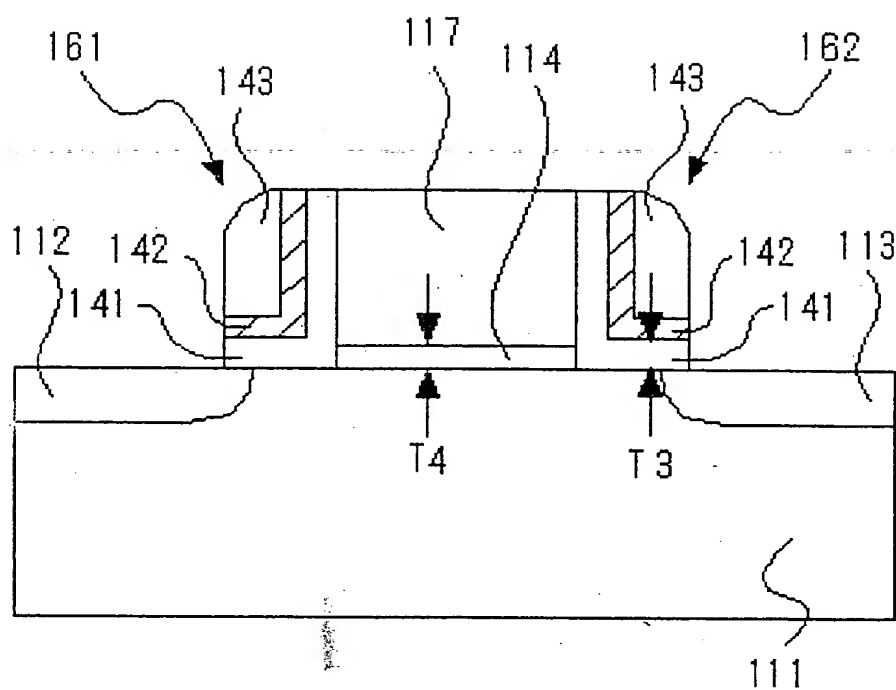


Fig. 21

